

# 목 차

분 기 보 고 서 .....	1
【 대표이사 등의 확인 】 .....	2
I. 회사의 개요.....	3
1. 회사의 개요.....	3
2. 회사의 연혁.....	18
3. 자본금 변동사항.....	25
4. 주식의 총수 등.....	26
5. 의결권 현황.....	27
6. 배당에 관한 사항 등.....	28
II. 사업의 내용 .....	30
III. 재무에 관한 사항 .....	57
1. 요약재무정보 .....	57
2. 연결재무제표 .....	59
3. 연결재무제표 주식 .....	63
4. 재무제표 .....	121
5. 재무제표 주식 .....	125
6. 기타 재무에 관한 사항.....	178
IV. 감사인의 감사의견 등 .....	192
V. 이사의 경영진단 및 분석의견.....	193
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 .....	194
1. 이사회에 관한 사항 .....	194
2. 감사제도에 관한 사항.....	202
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항.....	205
VII. 주주에 관한 사항.....	206
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항.....	213
1. 임원 및 직원의 현황 .....	213
2. 임원의 보수 등 .....	222
IX. 계열회사 등에 관한 사항.....	225
X. 이해관계자와의 거래내용.....	250
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 .....	253
【 전문가의 확인 】 .....	258
1. 전문가의 확인 .....	258
2. 전문가와의 이해관계 .....	258

# 분기보고서

(제 71 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터  
2018년 09월 30일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :

박 성 욱

본 점 소 재 지 :

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-630-4114

(홈페이지) <http://www.skhynix.com>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 경영지원 담당 (성 명) 이 명 영

(전 화) 031-8093-4801~6

## 【 대표이사 등의 확인 】

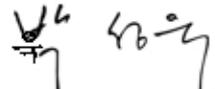
### 확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 내용이 기재 또는 표시사항을 이용하는자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2018. 11. 14

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 박 성   
공시 책임자 이 명 영 

# I. 회사의 개요

## 1. 회사의 개요

### 가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
에스케이하이이엔지㈜	2001.04	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	사업지원	128,339	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
에스케이하이이스텍㈜	2008.03	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	사업지원	59,534	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
행복모아 ㈜	2016.10	충청북도 청주시 흥덕구 화계동 청주테크노폴리스 일반산업단지 예프6-2	사업지원	16,486	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix System ic Inc.	2017.05	충청북도 청주시 흥덕구 대신로 215(향정동)	반도체소재제조	360,254	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix America Inc.	1983.03	3101 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A	반도체판매	2,522,348	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Deutschland GmbH	1989.03	Am Prime Parc 13, Kelsterbacher Str. 16, D-65479 Raunheim, Germany	반도체판매	108,470	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Asia Pte.Ltd.	1991.09	8 Temasek Boulevard #11-03, Suntec City Tower3, Singapore 038988	반도체판매	636,286	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.	1995.04	Suite 4401-02 & 11-12, 44/F, One Island East, 18 Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong	반도체판매	1,043,889	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix U.K. Ltd.	1995.07	243 Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0RH, UK	반도체판매	325,434	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	1996.07	Lite-On Technology Building 11F., No. 392, Ruiguang Road, Neihu Dist., Taipei City 11492 Taiwan, R.O.C	반도체판매	566,155	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Japan Inc.	1996.09	23F SHIROYAMA TRUST TOWER, 4-3-1 Toranomon, Minatoku, Tokyo	반도체판매	632,590	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.	2001.08	19F, ARCH SHANGHAI Tower 2, No.533 Lou Shan Guan Road, Shanghai, 200051 China	반도체판매	414,850	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Semiconductor India Private Limited	2006.11	Unit 10, Level 8, Innovator Building, ITPB (International Technology Park Bangalore), Whitefield Road, Bangalore 560066, India	반도체판매	903	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	2010.08	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in Wuxi New District, Wuxi, Jiangsu Province, China	반도체판매	13,347	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	2005.04	Lot K7, Wuxi High-tech Zone Comprehensive Bonded Zone in New District, Wuxi, Jiangsu Province, China(214028)	웨이퍼생산 및 판매	4,043,100	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	2013.09	Xiyong Comperhensive Bonded Zone B Block v2-4/02, Shapingba strict, Chongqing, China	웨이퍼생산 및 판매	388,033	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Italy S.r.l.	2012.05	V.le Colleoni, 15 20864 Agrate Brianza (MB)	기술센터	3,462	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

SK hynix memory solutions America, Inc.	2012.08	3103 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A	기술센터	97,132	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix memory solutions Taiwan, Inc.	2013.08	6F-1. Mo. 6. Talyuen 1st(Talyuen HI-tech Industrial Park) Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan	기술센터	8,626	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.	2014.06	Kalvaryiskaya, 42 Fifth Floor Minsk, Belarus, 220073	기술센터	5,261	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK APTECH Ltd.	2013.09	Wanchai, Hong Kong	해외투자법인	166,528	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Ventures Hong Kong Limited	2016.03	Suite 4401-02 & 11-12, 44/F, One Island East, 18 Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong	해외투자법인	2,957	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	2018.05	Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, China	해외투자법인	0	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.	2018.07	Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, China	해외병원자산법인	0	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.	2018.07	Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, China	해외병원운영법인	0	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
MMT 특정금전신탁	-	-	특정금전신탁	0	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

\* 주요 종속회사 판단기준: 직전 사업연도말 자산총액 750억원 이상 또는 지배회사 자산총액의 10% 이상

### [연결대상회사의 변동현황]

사업 연도	연결에 포함된 종속회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사	전기대비 연결에서 제외된 사유
제71기 3분기	에스케이하이이엔지(주) 등 25개사	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.	(주)실리콘화일 SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.	흡수합병
제70기	에스케이하이이엔지(주) 등 24개사	에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	-	-
제69기	에스케이하이이엔지(주) 등 23개사	SK hynix Ventures Hong Kong Limited (SKH Ventures) 행복모아(주)	Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc. (HSMA)	청산
제68기	에스케이하이이엔지(주) 등 22개사	-	-	-

\* 연결대상회사의 변동현황은 한국채택국제회계기준임.

\* MMT 특정금전신탁은 연결에 포함된 회사수에서 제외하였음.

구분	자회사	사유
신규 연결	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.	신규설립
	-	-
연결 제외	(주)실리콘화일 SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.	흡수합병
	-	-

## 회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록·지정)여부	주권상장 (또는 등록·지정)일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
상장	1996년 12월 26일	해당사항 없음	해당사항 없음

## 나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 에스케이하이닉스 주식회사이며, 영문으로는 SK hynix Inc.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 SK하이닉스 또는 SK hynix라고 표기합니다.

## 다. 설립일자

당사는 1949년 10월 국도건설 주식회사로 설립되어 1983년 2월 현대전자산업주식회사로 상호를 변경하였으며, 이후 2001년 3월 주식회사 하이닉스반도체로, 2012년 3월 에스케이하이닉스 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있으며, 종목코드는 '000660'입니다.

## 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소: 경기도 이천시 경충대로 2091  
전화번호: 031-630-4114  
홈페이지: <http://www.skhynix.com>

## 마. 주요 사업의 내용

현재 당사의 주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP(Multi-chip Package)와 같은 메모리 반도체 제품이며, 2007년부터는 시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업에 재진출하여 종합반도체 회사로 그 영역을 넓혀가고 있습니다.

당사 정관에 근거하여 현재 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

- 반도체소자 제조 및 판매
- 반도체소자 기타 이와 유사한 부품을 사용하여 전자운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매
- 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업
- 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업
- 기계부분품 제조업 및 금형제조업
- 기술연구 및 용역수탁업
- 전자 전기기계, 기구의 임대업
- 특수통신(위성통신 등) 방송관련 기기 제작, 판매, 임대업 및 서비스업
- 정보서비스업
- 출판업

- 무역업
- 부동산 매매 및 임대업
- 발전업
- 건설업
- 전자관 제조업
- 창고업
- 주차장업
- 위성통신사업
- 전기통신회선설비 임대사업
- 전자상거래 및 인터넷 관련사업
- 전기 각호와 관련되는 사업 및 투자

사업부문별 보다 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

#### 바. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

- (1) 기업집단의 명칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)
- (2) 기업집단에 소속된 회사 (2018. 9. 30 기준 계열사 : 100개사)

상장 여부	회사명	법인등록번호
상장사 (17)	SKC솔믹스(주)	134711-0014631
	SKC(주)	130111-0001585
	SK가스(주)	110111-0413247
	SK네트웍스(주)	130111-0005199
	SK디스커버리(주)	130111-0005727
	SK디앤디(주)	110111-3001685
	SK머티리얼즈(주)	190111-0006971
	SK바이오랜드(주)	110111-1192981
	SK이노베이션(주)	110111-3710385
	SK(주)	110111-0769583
	SK케미칼(주)	131111-0501021
	SK텔레콤(주)	110111-0371346
	SK하이닉스(주)	134411-0001387
	(주)나노엔텍	110111-0550502
	(주)부산도시가스	180111-0039495
	(주)아이리버	110111-1637383
	(주)에스엠코어	110111-0128680
비상장사 (83)	SK E&S(주)	110111-1632979
	SKC인프라서비스(주)	134111-0414065
	SKC하이테크앤마케팅(주)	161511-0225312
	SK건설(주)	110111-0038805

SK네트웍스서비스(주)	135811-0141788
SK더블유(주)	154311-0026200
SK렌터카서비스(주)	160111-0306525
SK루브리컨츠(주)	110111-4191815
SK매직서비스(주)	134811-0039752
SK매직(주)	110111-5125962
SK모바일에너지(주)	161511-0076070
SK바이오사이언스(주)	131111-0523736
SK바이오텍(주)	160111-0395453
SK바이오팜(주)	110111-4570720
SK배터리시스템즈(주)	160111-0337801
SK브로드밴드(주)	110111-1466659
SK쇼와덴코(주)	175611-0018553
SK스토아(주)	110111-6585884
SK신택(주)	131411-0232597
SK실트론(주)	175311-0001348
SK어드밴스드(주)	230111-0227982
SK에너지(주)	110111-4505967
SK에어가스(주)	230111-0134111
SK엠앤서비스(주)	110111-1873432
SK와이번스(주)	120111-0217366
SK인천석유화학(주)	120111-0666464
SK인포섹(주)	110111-2007858
SK임업(주)	134811-0174045
SK종합화학(주)	110111-4505975
SK커뮤니케이션즈(주)	110111-1322885
SK테크엑스(주)	110111-5990547
SK텔레시스(주)	110111-1405897
SK텔링크(주)	110111-1533599
SK트레이딩인터내셔널(주)	110111-5171064
SK트리캠(주)	164711-0060753
SK티엔에스(주)	110111-5833250
SK플라즈마(주)	131111-0401875
SK플래닛(주)	110111-4699794
SK핀크스(주)	224111-0003760
SK하이닉스시스템IC(주)	150111-0235586
SK하이스택(주)	134411-0037746
SK하이이엔지(주)	134411-0017540
SK해운(주)	110111-6364212

강원도시가스(주)	140111-0002010
금호미쓰이화학(주)	110111-0612980
나래에너지서비스(주)	135711-0092181
내트릭(주)	110111-3222570
네트웍오앤에스(주)	110111-4370708
당진에코파워(주)	165011-0035072
대전맑은물(주)	110111-4273960
디앤디인베스트먼트(주)	110111-6618263
목감휴게소서비스(주)	110111-6257954
미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주)	230111-0233880
보령LNG터미널(주)	164511-0021527
비앤엠개발(주)	110111-5848712
서비스에이스(주)	110111-4368688
서비스탑(주)	160111-0281090
에프앤유신용정보(주)	135311-0003300
에프에스케이엘앤에스(주)	131111-0462520
엔티스(주)	130111-0021658
영남에너지서비스(주)	175311-0001570
울산아로마틱스(주)	110111-4499954
원스토어(주)	131111-0439131
위례에너지서비스(주)	110111-4926006
유베이스매뉴팩처링아시아(주)	230111-0168673
이니츠(주)	230111-0212074
전남도시기스(주)	201311-0000503
전북에너지서비스(주)	214911-0004699
제주유나이티드FC(주)	224111-0015012
(주)대한송유관공사	110111-0671522
(주)에이앤티에스	110111-3066861
(주)엔에스오케이	110111-3913187
(주)제이에스아이	124611-0261880
(주)포인트코드	110111-1888548
지허브(주)	230111-0205996
충청에너지서비스(주)	150111-0006200
코원에너지서비스(주)	110111-0235617
파주에너지서비스(주)	110111-4629501
피에스앤마케팅(주)	110111-4072338
한국벅슬렌(유)	230114-0003328
행복나래(주)	110111-2016940
행복모아(주)	150111-0226204

	홈앤서비스(주)	110111-6420460
--	----------	----------------

주1) SK테크엑스(주)는 '18.10.17일자로 계열 제외

주2) '18.10.1일자로 유빈홀딩스(주), 유빈스(주), 에이오티(주), 피아이유엔(주) 계열 편입

(\*) 사명 변경 : SK(주) (舊 SK C&C(주)), 엔티스(주) (舊 SK사이텍(주)), SK인포섹(주) (舊 인포섹(주)), SK배터리시스템즈(주) (舊 SK컨티넨탈이모션코리아(주)), 나래에너지서비스(주) (舊 하남에너지서비스(주)), 비엔엠개발(주) (舊 엠케이에스개런티(유)), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주) (舊 에스엠피씨(주)), SK에어가스(주) (舊 SKC에어가스(주)), SK바이오랜드(주) (舊 (주)바이오랜드), 파주에너지서비스(주) (舊 피엠피(주)), SK엠앤서비스(주) (舊 엠앤서비스(주)), SK매직서비스(주) (舊 매직서비스(주)), (주)엔에스오케이 (舊 (주)네오에스네트웍스), SK디스커버리(주) (舊 SK케미칼(주)), SKC하이테크앤마케팅(주) (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스(주) (舊 카라이프서비스(주))

※ 해외계열사 현황

[2018년 9월 30일 기준]

No.	해외계열사명
1	SK Gas International Pte. Ltd.
2	SK Gas USA Inc.
3	SK Gas Trading LLC
4	Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.
5	SK Holdco PTE. LTD.
6	BT RE Investments, LLC
7	Hi Vico Construction Company Limited
8	Irunex Construction and Management Co., Ltd.
9	Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
10	Mesa Verde RE Ventures, LLC
11	SBC General Trading & Contracting Co. W.L.L.
12	SK E&C BETEK Corp.
13	SK E&C Consultores Ecuador S.A.
14	SK E&C India Private Ltd.
15	SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.
16	SK E&C Saudi Company Limited
17	SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.
18	SK International Investment Singapore Pte. Ltd.
19	SKEC Anadolu LLC
20	SKEC(Thai) Limited
21	Sunlake Co., Ltd.
22	Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd
23	Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI.
24	Dandong Lijiang Estate Management co.,LTD
25	Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd.
26	P.T. SK Networks Indonesia
27	POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.
28	Shenyang SK Bus Terminal Co., Ltd.
29	Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.
30	SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.
31	SK (GZ Freezone) Co.,Ltd.
32	SK BRASIL LTDA
33	SK Networks (China) Holdings Co.,Ltd.
34	SK Networks (Dandong) Energy Co.,Ltd.

35	SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd
36	SK Networks (Shanghai) Co.,Ltd.
37	SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd.
38	SK Networks Deutschland GmbH
39	SK Networks HongKong Ltd.
40	SK Networks Japan Co., Ltd.
41	SK Networks Middle East FZE
42	SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.
43	SK Networks Resources Australia Pty Ltd.
44	SK Networks Resources Pty Ltd.
45	SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd
46	Springvale SK Kores Pty Ltd.
47	SK NETWORKS AMERICA, Inc.
48	SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.
49	Networks Tejarat Pars
50	SK NETWORKS RETAILS MALAYSIA SDN. BHD
51	IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.
52	PT. Patra SK
53	SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
54	SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.
55	SK Lubricants Americas, Inc.
56	SK Lubricants Europe B.V.
57	SK Lubricants Japan Co., Ltd.
58	SK Lubricants Rus Limited Liability Company
59	SK Life Science, Inc.
60	SK Bio-pharm Tech(Shanghai) Co., Ltd
61	Solmics Shanghai International Trading Co., Ltd.
62	Solmics Taiwan Co., Ltd.
63	SKC (Jiangsu) High Tech Plastics
64	SKC Europe GmbH
65	SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.
66	SKC, Inc.
67	SKC PU Specialty Co., Ltd.
68	SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
69	SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
70	SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
71	SKC Hi-Tech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd.
72	SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd.
73	SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z O.O.

74	SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC
75	Asia Bitumen Trading Pte., Ltd.
76	Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.
77	Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.
78	Netruck Franz Co., Ltd.
79	Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd.
80	Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.
81	SK Shanghai Asphalt Co., Ltd.
82	SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
83	SK Energy Road Investment Co., Ltd.
84	SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.
85	SK E&P America, Inc.
86	SK E&P Company
87	SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
88	SK Permian, LLC
89	SK Plymouth, LLC
90	SK USA, Inc.
91	SK Battery Hungary Kft.
92	Blue Dragon Energy Co., Limited
93	SK E&P Operations America, LLC
94	SK Nemaha, LLC
95	CAILIP Gas Marketing, LLC
96	China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.
97	DewBlaine Energy, LLC
98	PT SK E&S Nusantara
99	SK E&S Americas, Inc.
100	SK E&S Australia Pty Ltd.
101	SK E&S Hong Kong Co., Ltd
102	SK E&S LNG, LLC
103	Fajar Energy International Pte., Ltd
104	Prism Energy International Pte., Ltd.
105	Prism Energy International Hong Kong Limited
106	SK E&S Dominicana S.R.L.
107	Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
108	SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.
109	Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd.
110	SK GC Americas, Inc.
111	SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
112	SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

113	SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.
114	SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
115	SK Global Chemical China Ltd.
116	SK Global Chemical Japan Co., Ltd.
117	SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd.
118	SK Golden Tide Plastics (Yantai) Co., Ltd.
119	SK Hualun Specialty Chemical Co., Ltd.
120	SK-SVW (Chongqing) Chemical Co., Ltd.
121	Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.
122	Huizhou SK TCL Taidong Chemical Co.,Ltd.
123	SK Primacor Americas LLC
124	SK Primacor Europe, S.L.U.
125	SK Saran Americas LLC
126	SK S.E. Asia Pte. Ltd.
127	ESSENCORE Limited
128	Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited
129	SK C&C India Pvt., Ltd.
130	SK C&C Beijing Co., Ltd.
131	SK C&C Chengdu Co., Ltd
132	ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd.
133	S&G Technology
134	SK computer and communication L.L.C.
135	SK GI Management
136	Saturn Agriculture Investment Co., Limited
137	SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD.
138	Plutus Capital NY, Inc.
139	Hudson Energy NY, LLC
140	Gemini Partners Pte. Ltd
141	Solaris Partners Pte. Ltd
142	Beijing SK Magellan Capital Advisors Co., Ltd.
143	CFC-SK El Dorado Latam Capital Partners, Ltd.
144	CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd.
145	CFC-SK El Dorado Latam Fund, L.P.
146	Dogus SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.S.
147	Prostar Capital Ltd.
148	Prostar Capital Management Ltd.
149	Solaris GEIF Investment
150	Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.
151	Hermed Capital

152	Hermed Capital Health Care GP Ltd
153	Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited
154	Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
155	Hermed Capital Health Care Fund L.P.
156	Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise
157	Hermeda Industrial Co.
158	Plutus Fashion NY, Inc
159	Wonderland NY, LLC
160	Alchemy Acquisition Corp.
161	Abrasax Investment Inc.
162	CFC-SK Covipaci Colombia SAS
163	CFC-SK Capital S.A.S.
164	CFC-SK Malta Covipacifico Ltd.
165	CFC-SK Spain Covipacifico S.L.
166	EM Holdings (Cayman) L.P.
167	EM Holdings (US) LLC
168	Hermeda Alpha Industrial Co. Ltd
169	Hudson Energy NY II, LLC
170	Prostar APEIF GP Ltd.
171	Prostar APEIF Management Ltd.
172	Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd.
173	SK Investment Management Co., Limited.
174	SK Semiconductor Investments Co., Ltd.
175	SK China Company, Ltd.
176	SK China(Beijing) Co.,Ltd.
177	SK BeiJing Investment Management Limited
178	Sky Yunjian Investment Management Limited
179	SKY Property Mgmt(Beijing) Co.Ltd.
180	SK Auto Service Hong Kong Ltd.
181	SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd
182	SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd
183	SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd
184	SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd
185	SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd
186	SK (Shenzhen) Auto Rental Co.,Ltd
187	SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd
188	Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.
189	SK Financial Leasing Co, Ltd.
190	SK Bio Energy HongKong Co.,Limited

191	SK China Investment Management Company Limited
192	SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.
193	SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.
194	SK Property Investment Management Company Limited
195	SK Industrial Development China Co., Ltd.
196	Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.
197	SKY Property Mgmt. Ltd.
198	SK China Real Estate Co., Limited
199	SK China Creative Industry Development Co., Ltd
200	SKY Investment Co., Ltd
201	FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd.
202	PT Sinar Timur Green Energi
203	SK Chemicals America, Inc.
204	SK Chemicals GmbH
205	SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd
206	SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd.
207	ST Green Energy Pte, Ltd
208	SK Telesys Corp.
209	SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD
210	TechDream Co. Limited
211	Atlas Investment Ltd.
212	Axess II Holdings
213	CYWORLD China Holdings
214	Global Opportunities Breakaway Fund
215	Global opportunities Fund, L.P
216	Immersive Capital, L.P.
217	Magic Tech Network Co., Ltd.
218	SK Global Healthcare Business Group Ltd.
219	SK Healthcare China Holding Co.
220	SK Healthcare Co.,Ltd.
221	SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited
222	SK Latin America Investment S.A.
223	SK MENA Investment B.V.
224	SK Technology Innovation Company
225	SK Telecom Americas, Inc.
226	SK Telecom China Fund 1 L.P.
227	SK Telecom Innovation Fund, L.P.
228	SK Telecom Smart City Management Co., Ltd
229	SK Telecom Venture Capital, LLC

230	SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd.
231	SKCREGC(Sichuan)Smart City Management Co.
232	SKTA Innopartners, LLC
233	ULand Company Limited
234	Westly Capital Partners Fund II
235	YTK Investment Ltd.
236	SK telecom Japan Inc.
237	AI ALLIANCE, LLC
238	ID Quantique S.A.
239	Fitech Global Opportunities Limited
240	Celcom Planet Sdn Bhd
241	Dogus Planet Inc.
242	Shopkick GmbH
243	Shopkick Inc.
244	Shopkick Management Company, Inc.
245	SK Planet Global Holdings Pte. Ltd.
246	SK Planet Inc.
247	SK Planet Japan K.K.
248	SKP America LLC
249	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
250	SK APTECH Ltd.
251	SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
252	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
253	SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.
254	SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd
255	SK hynix America Inc.
256	SK hynix Asia Pte. Ltd.
257	SK hynix Deutschland GmbH
258	SK hynix Flash Solution Taiwan Ltd.
259	SK hynix Italy S.r.l
260	SK hynix Japan Inc.
261	SK hynix Memory Solutions America Inc.
262	SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
263	SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
264	SK hynix Semiconductor India Private Ltd.
265	SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
266	SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
267	SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
268	SK hynix U.K Ltd.

269	SK hynix Ventures Hong Kong Limited
270	SK hynix Memory Solutions Eastern Europe LLC.
271	Great Shale LNG Transport S.A.
272	MILESTONE LNG TRANSPORT S.A.
273	OCEAN MARITIME HONGKONG LIMITED
274	S&Y Shipping S.A.
275	SK B&T PTE. LTD.
276	SK shipping Europe Plc.
277	SK shipping Hongkong Ltd.
278	SK shipping Japan Co., Ltd.
279	SK shipping Singapore Pte. Ltd.
280	Dalian Sea Oil Petroleum Chemicals Co.,Ltd
281	HBNG Logitics Co., Ltd.
282	SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.
283	Chongqing Happynarae Co., Ltd.
284	SK Energy International Pte, Ltd.
285	SK Energy Americas Inc.
286	SK Energy Europe, Ltd.
287	SK Terminal B.V.
288	Iriver Enterprise Ltd.
289	Iriver China Co., Ltd.
290	Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd.
291	Iriver Inc.
292	groovers Japan Co., Ltd.
293	LIFE DESIGN COMPANY JAPAN INC.
294	Bioland Biotec Co.,Ltd
295	SK Bioland Haimen Co.,Ltd
296	Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.
297	Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.
298	MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o.
299	MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd.
300	MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd
301	MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V
302	MCNS Polyurethanes USA Inc.
303	Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.
304	PT. MCNS Polyurethanes Indonesia
305	SMART Technology Polyurethanes P.J.S. Co.
306	Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.
307	Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd.

308	SK Materials (Jiangsu) Co., Ltd.
309	SK Materials (Xian) Co., Ltd.
310	SK Materials Japan Co., Ltd.
311	SK Materials Taiwan Co., Ltd.
312	SMC US, INC
313	SK TNS Myanmar Co.,Ltd
314	SK BIOTEK IRELAND LIMITED
315	SK Biotek USA, Inc.
316	NanoenTek America Inc.
317	NanoEntek Bio-Technology (Beijing) Ltd.
318	SK Siltron America, Inc.
319	SK Siltron Japan, Inc.
320	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd
321	SK Telink Vietnam Co., Ltd.

#### 사. 신용평가에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 당사의 신용등급은 아래와 같습니다.

구분	평가기관	현등급	최종평가일
국내	NICE신용평가	AA	2018.04.26
	한국기업평가	AA	2018.05.31
	한국신용평가	AA	2018.05.16
해 외	Moody's	Baa2	2018.10.23
	S&P	BBB-	2017.11.23

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립 이후의 중요한 변동상황

#### (1) 회사의 주된 변동내용

- 1949. 10      국도건설 주식회사 설립
- 1983. 02      현대전자산업주식회사로 상호 변경
- 1996. 12      기업공개 및 상장
- 1997. 03      대표이사 김영환 외 이사 5인 변경 선임  
이사 5인, 감사 1인 변경 선임
- 1999. 05      LG그룹과 LG반도체 주식 양수도 계약 체결
- 1999. 07      LG반도체 대주주 지분 인수
- 1999. 10      현대반도체(주)(구, (주)LG반도체) 흡수합병

- 2000. 03 박종섭 대표이사 외 이사 1인, 감사위원 2인 변경 선임
- 2000. 05 전장사업부문 (주)현대오토넷으로 분사
- 2000. 08 모니터사업부문 "현대이미지퀘스트(주)"로 분사
- 2001. 03 주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경  
박상호 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임
- 2001. 05 통신단말기 사업부문 "현대큐리텔"로 분사  
통신 ADSL 사업부문 "현대네트웍스"로 분사
- 2001. 07 통신 네트워크 사업부문 "현대시스콤"으로 분사
- 2001. 08 현대그룹으로부터 계열분리
- 2001. 10 채권금융기관 공동관리 시작
- 2001. 12 현대큐리텔, '팬택 컨소시엄'에 지분 매각
- 2002. 01 현대시스콤, '쓰리알'에 지분 매각
- 2002. 05 시러스 로직社와 파운드리 전략적 장기공급 계약체결  
박종섭 대표이사 사임
- 2002. 06 최대주주 변경(현대상선(주) → (주)한국외환은행)
- 2002. 07 우의제 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임
- 2002. 12 현대네트웍스, '엠비엔'에 지분 매각
- 2003. 02 박상호 대표이사 사임
- 2003. 04 STMicro社와 낸드플래시 메모리 공동 개발 및 파운드리 공급 계약 체결
- 2003. 06 환경/안전/보건 기술연구소 설립
- 2004. 06 매그나칩반도체 유한회사와 비메모리 사업부문 영업양도계약 체결
- 2004. 08 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시와 중국 현지공장설립 협력계약 체결
- 2004. 10 비메모리 사업부문 영업양도
- 2004. 11 STMicro社와 중국 현지 합작공장설립을 위한 협력계약 체결
- 2005. 03 황학중, 김덕수, 민형욱, 이준호 사외이사 선임  
박시룡, 장운종 사외이사 임기만료 퇴임
- 2005. 07 채권금융기관 공동관리 조기종료  
현대이미지퀘스트(주), (주)빅터스캐피탈코리아에 지분 매각
- 2005. 10 (주)현대오토넷 지분매각 완료  
출자전환주식 공동관리협의회 1차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일)
- 2006. 03 권오철 이사, 손방길 사외이사 선임, 정형량 이사 임기만료 퇴임
- 2006. 04 중국 현지생산법인(HSMC) 설립
- 2006. 06 출자전환주식 공동관리협의회 2차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일)
- 2006. 09 300mm 연구소(R3 R&D Fab) 개소
- 2007. 03 김종갑 대표이사 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 4인 포함) 선임

- 이사 선임: 김종갑, 최진석
- 사외이사 선임: 박종선, 김경한, 조동성, 김형준
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 황학중, 민형욱, 손방길, 손성호
- 우의제 대표이사 임기만료 퇴임
- 이사 1인(오춘식), 사외이사 4인(김범만, 김수창, 이선, 이준호) 임기만료 퇴임
- 2007. 04 청주 신규 M11(300mm) 공장 착공
- 2007. 07 공정거래 자율준수프로그램 도입
- 2007. 10 환경운동연합과 '환경경영검증위원회' 협약 체결
- 2007. 11 '일하는 이사회'를 위한 신(新)이사회 제도 도입
- 2008. 02 김경한 사외이사 중도 퇴임
- 2008. 03 사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
  - 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 정홍원, 최장봉
  - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈
- 사외이사 3인(황학중, 민형욱, 손방길) 임기만료 퇴임
- 2008. 06 정홍원 사외이사 중도 퇴임
- 2009. 03 권오철 이사 재선임 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
  - 이사 선임: 권오철, 박성욱
  - 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 최장봉, 한부환
  - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈
- 2009. 11 중국 후공정 합작사 HITECH 설립
- 2010. 03 최대주주 변경((주)한국외환은행 → 한국정책금융공사)
- 최대주주 변경(한국정책금융공사 → 미래에셋자산운용투자자문(주))
- 권오철 대표이사외 이사 1인 신규 선임, 김종갑 이사 재선임
- 사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
  - 이사 선임: 김종갑, 권오철, 김민철
  - 사외이사 선임: 박종선, 전인백, 한부환, 최장봉, 정병태, 김형준
  - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑중, 송재용, 김창호
- 2010. 06 중국 후공정 합작공장 HITECH 준공
- 2010. 08 최대주주 변경(미래에셋자산운용투자자문(주) → 한국정책금융공사)
- 2010. 10 최대주주 변경(한국정책금융공사 → 국민연금공단)
- 2011. 03 사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
  - 사외이사 선임: 한부환, 전인백, 정병태, 이달곤, 김갑희, 정상환
  - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑중, 송재용, 조현명
- 2011. 09 정상환 사외이사 중도 퇴임
- 2012. 02 최대주주 변경(국민연금공단 → 에스케이텔레콤(주))
- 사외이사 5인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
  - 이사 선임: 최태원, 하성민, 박성욱
  - 사외이사 선임: 김두경, 박영준, 윤세리, 김대일, 이창양
  - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 김두경, 김대일, 이창양
- 2012. 06 미 컨트롤러 업체 LAMD(Link\_A\_Media Devices) 인수 본계약 체결

- 2012. 09      플래시 솔루션 디자인 센터 설립
- 2013. 03      김준호 사내이사 1인 신규 선임
- 2014. 03      이사 2인(감사위원회 위원 1인 포함) 선임
  - 이사 선임: 임형규
  - 사외이사 선임: 최종원
  - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 최종원
- 2014. 09      중국 충칭 후공정 생산법인 (SKHYCQL) 준공
  - 이사 5인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
- 2015. 03
  - 이사 선임: 박성욱
  - 사외이사 선임: 김두경, 박영준, 김대일, 이창양
  - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 김두경, 김대일, 이창양
- 2016.03      이사 2인(사내이사) 선임
  - 이사 선임: 김준호, 박정호
- 이사 4인(감사위원회 위원 2인 포함) 선임
  - 이사 선임: 이석희
- 2017.03
  - 기타비상무이사 선임: 박정호
  - 사외이사 선임 : 최종원, 신창환
  - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 최종원, 신창환
- 2017.07      에스케이하이닉스 시스템아이씨(주) 공식 출범
  - 이사 4인(감사위원회 위원 1인 포함) 선임
- 2018.03
  - 이사 선임: 박성욱
  - 사외이사 선임 : 송호근, 조현재, 윤태화
  - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 윤태화

(2) 종속회사의 주된 변동내용

- 1983. 03      미국 현지법인(HSA) 설립
- 1989. 03      독일 현지법인(HSD) 설립
- 1991. 08      싱가포르 현지법인(HSS) 설립
- 1995. 04      홍콩 현지법인(HSH) 설립
- 1995. 07      영국 현지법인(HSE) 설립
  - 영국 현지판매법인(HSU) 설립
- 1995. 08      미국 생산법인(HSMA) 설립
- 1996. 07      대만 현지법인(HST) 설립
- 1996. 09      일본 현지법인(HSJ) 설립
- 2001. 05      사업지원 서비스부문 "(주)현대아스텍" 분사
- 2001. 07      LCD 사업부문 "(주)현대디스플레이테크놀로지"로 분사
- 2001. 08      중국 현지판매법인(HSCS) 설립
- 2001. 12      "에스알씨(주)" 분사
- 2002. 11      "(주)현대디스플레이테크놀로지" TFT-LCD 사업부문 매각
- 2005. 04      중국 합작법인(HSSL) 설립

에스알씨(주)→(주)큐알티반도체 사명 변경  
(주)현대아스텍→(주)아스텍 사명 변경

2006. 04 중국 현지생산법인(HSMC) 설립

2006. 10 중국 현지생산법인(HSMC) 준공

2007. 01 인도 현지법인(HSIS) 설립

2008. 03 (주)아스텍에서 (주)하이닉스인재개발원 분할  
(주)아스텍에서 (주)하이텍으로 분할  
(주)아스텍에서 (주)하이로지텍으로 분할  
(주)아스텍에서 (주)하이닉스엔지니어링으로 분할

2010. 01 (주)하이닉스엔지니어링에서 (주)아미파워로 분할

2010. 08 중국 현지판매법인(HSCW) 설립

2011. 09 "(주)현대디스플레이테크놀로지" 청산, 주요종속회사 제외  
"프로모스엔에이치유한회사, 티와이프로주식회사, 외환은행특정금전신탁" 청산, 주요종속회사 제외

2012. 06 낸드플래시 개발업체 아이디어플래시(Ideaflash S.r.l.) 인수,  
이탈리아 기술센터(SK Hynix Italy S.r.l.) 전환 설립

2012. 10 (주)하이닉스엔지니어링, (주)큐알티반도체 흡수합병  
(주)하이텍, (주)하이로지텍/(주)하이닉스인재개발원 흡수합병

2012. 10 (주)하이닉스엔지니어링→에스케이하이이엔지(주) 사명 변경  
(주)하이텍→에스케이하이텍(주) 사명 변경

2013. 09 아미파워(주) 청산, 주요종속회사 제외  
중국 충칭 후공정 생산법인 (SKHYCQL) 설립

2014. 04 에스케이하이이엔지(주) 에서 큐알티(주) 분할 설립  
주식교환으로 실리콘화일(주) 인수

2014. 06 벨라루스 소재 연구개발법인 Softeq Flash Solutions LLC. 인수

2014. 07 SK hynix Europe Holding Ltd.(SKHYE) 청산, 종속기업 제외

2014. 09 큐알티(주) 지분 전량 매각

2016. 03 SK hynix Ventures Hong Kong Ltd. 설립  
Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc. (HSMA) 청산, 종속기업 제외

2016. 10 행복모아(주) 설립

2017. 05 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주) 설립

2018. 03 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 흡수합병

2018. 05 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.가 SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.를 흡수합병

2018. 05 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. 설립

2018. 07 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)가 중국 합작법인 설립

2018. 07 SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. 설립

2018. 07 SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd. 설립

## 나. 상호의 변경

- 1983. 02 현대전자산업주식회사로 상호 변경
- 2001. 03 주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경
- 2012. 03 에스케이하이닉스 주식회사로 상호 변경

## 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환·이전, 중요한 영업의 양수·양도 등

- 1999. 10 현대반도체(주)(구, (주)LG반도체) 흡수합병
- 2004. 10 비메모리 사업부문 영업양도
- 2011. 11 에스케이텔레콤, 하이닉스반도체 지분인수계약
- 2014. 01 (주)실리콘화일과 포괄적 주식교환계약
- 2016. 10 (주)실리콘화일과 CIS영업부문에 대한 영업양수
- 2017. 07 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)에 Foundry사업과 관련된 자산 등 포괄적 양도

## 라. 생산설비의 변동

- 2006. 10 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 C2(300mm), C1(200mm)공장 준공
- 2008. 07 미국 유진 공장 E1(200mm) 가동 중단
- 2008. 08 청주 신규 NAND Flash 전용 M11공장(300mm) 준공
- 2008. 09 이천 M7(200mm) 및 청주 M9(200mm) 공장 가동 중단
- 2008. 12 중국 C1(200mm) 공장 가동 중단
- 2010. 06 중국 후공정 합작공장 HITECH 준공
- 2012. 06 청주 신규 NAND Flash 전용 M12공장(300mm) 준공
- 2014. 09 중국 후공정 생산법인 (SKHYCQL) 준공
- 2015. 08 이천 M14(300mm) 준공
- 2018. 10 청주 M15(300mm) 준공

## 마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 2005. 01 전력 소모 30% 줄인 서버용 메모리 모듈 개발
- 2005. 01 대만 프로모스社와 전략적 제휴를 위한 본계약 체결
- 2005. 07 2GB DDR2-667 노트북용 모듈 업계 최초 인텔社 인증 획득
- 2005. 07 당사 출자전환 주식 공동관리 협의회와 '특별 약정' 체결
- 2005. 11 JEDEC 표준형 8GB DDR2 R-DIMM과 2GB DDR VLP R-DIMM 개발
- 2005. 12 512Mb GDDR4 DRAM 개발
- 2006. 03 80나노 512Mb DDR2 DRAM 인텔社 인증 획득
- 2006. 12 200Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발  
60나노급 1Gb DDR2 기반 1GB DDR2 800Mbps 모듈 개발
- 2007. 03 ECC회로 적용한 185Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발

- 2007. 04     퓨전메모리 제품 DOC(Disk On Chip) H3 양산
- 2007. 05     80나노 DDR3 1Gb DRAM 단품 및 모듈 인텔사 인증 획득  
초박형(25 $\mu$ m) 20단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package) 개발
- 2007. 08     200Mbps 1Gb 모바일 DRAM 개발  
이노베이티브 실리콘사와 신개념 메모리 'ZRAM' 라이선스계약 체결
- 2007. 09     초박형(25 $\mu$ m) 24단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package)개발
- 2007. 10     오보닉스사와 차세대 메모리 'PRAM' 기술 라이선스 계약 체결
- 2007. 11     1Gb GDDR5 개발  
50나노급 1Gb DDR2 DRAM 인텔사 인증 획득  
실리콘화일사와 CMOS 이미지 센서(CIS) 사업 추진을 위한 협력 계약 체결
- 2008. 01     50나노급 1GB/2GB DDR2 모듈 인텔사 인증 획득
- 2008. 03     피델릭스사와 전략적 제휴를 위한 협력계약 체결
- 2008. 04     그란디스사와 'STT-RAM' 라이선스 및 공동개발계약 체결
- 2008. 05     프로모스사와 포괄적 제휴 협력 계약 체결
- 2008. 06     파이슨사와 낸드플래시 응용제품 기술에 대한 사업협력계약 체결  
실리콘화일사 지분취득 결정 및 기존 파운드리 계약범위 확대  
3중셀(X3) 기술 기반 32Gb 낸드플래시 개발
- 2008. 07     씨엔에스테크놀로지사와 시스템반도체 공동개발 및 파운드리 협력계약 체결
- 2008. 08     뉴모닉스사와 낸드플래시 기술 및 제품 공동 개발 협력계약 체결  
16GB 서버용 모듈 개발
- 2008. 12     8단 적층 낸드플래시 개발  
50나노급 2Gb 고용량 모바일 DRAM 개발
- 2009. 01     DDR3 서버용 모듈 4GB ECC UDIMM 인텔사 인증 획득
- 2009. 02     40나노급 DDR3 DRAM 개발
- 2009. 05     뉴모닉스사 및 파이슨사와 낸드플래시 응용제품용 컨트롤러 3자 공동개발 계약 체결  
중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 무석산업발전집단유한공사와 합작 반도체 후공정  
전문회사 설립을 위한 본계약 체결
- 2009. 06     4GB 1333Mbps 노트북용 모듈 외 10건 인텔사 DDR3 전용 플랫폼 인증획득
- 2009. 07     대만 프로모스사와 전략적 제휴 협력계약 종결
- 2009. 08     50나노급 4Gb 모바일 DRAM 인텔사 인증 획득
- 2009. 10     2세대 1Gb DDR3 개발
- 2009. 12     40나노급 2Gb GDDR5 개발
- 2010. 01     40나노급 2Gb 모바일 DRAM 개발
- 2010. 02     20나노급 64Gb 낸드플래시 개발
- 2010. 09     휴렛팩커드(HP)사와 Re램 공동개발 계약 체결
- 2010. 12     30나노급 4Gb DDR3 개발
- 2011. 03     30나노급 2Gb DDR4 개발
- 2011. 07     도시바사와 STT-MRAM 공동개발 및 합작사 설립을 위한 공동생산 계약 체결
- 2012. 03     30나노급 2Gb DDR3 저탄소제품 인증 획득

- 2012. 04 스펀션社와 특허사용 크로스라이선스 및 SLC낸드플래시 공급계약 체결
- 2012. 06 IBM社와 PC램 공동개발 및 기술 라이선스 계약 체결
- 2012. 08 20나노급 64Gb 낸드플래시 저탄소제품 인증 획득
- 2012. 09 20나노급 4Gb 그래픽 DDR3 개발
- 2013. 06 20나노급 8Gb LPDDR3 개발  
램버스社와 포괄적 특허 라이선스 계약 체결
- 2013. 07 삼성전자와 반도체 특허 크로스라이선스 계약 체결
- 2013. 10 20나노급 6Gb LPDDR3 개발
- 2013. 12 20나노급 8Gb LPDDR4 개발
- 2014. 04 20나노급 8Gb DDR4기반 128GB 모듈 개발
- 2014. 05 20나노급 모바일 DRAM 저탄소 제품 인증 획득
- 2014. 09 차세대 와이드 IO2 모바일 DRAM 개발
- 2014. 10 최대용량 비휘발성 하이브리드 DRAM 모듈 개발
- 2015. 02 도시바와 NIL 기술 공동 개발 계약 체결
- 2015. 02 사업연속성경영시스템(ISO22301) 인증 획득
- 2015. 08 샌디스크와 특허 라이선스 연장 및 공급 계약 체결
- 2017. 01 16Gb 기반 8GB LPDDR4X 출시
- 2017. 04 72단 256Gb TLC 3D 낸드플래시 개발
- 2017. 04 20나노급 8Gb 기반 GDDR6 DRAM 개발
- 2017. 07 20나노급 8Gb HBM2 Gen 1 개발
- 2017. 09 도시바 반도체 사업 지분 인수를 위한 타법인 지분 출자 결의
- 2018. 01 20나노급 8Gb HBM2 Gen 2 개발
- 2018. 02 72단 3D 낸드 기반 4TB Enterprise SATA SSD 및 1TB Enterprise PCIe SSD 개발
- 2018. 04 10나노급 16Gb DDR4 개발
- 2018. 11 96단 512Gb TLC 4D 낸드플래시 개발
- 2018. 11 10나노급 2세대 8Gb DDR4 개발

### 3. 자본금 변동사항

#### 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	
2012년 01월 27일	전환권행사	보통주	855	5,000	23,328	2012.01.27~2012.02.13
2012년 02월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	101,850,000	5,000	23,000	

2012년 02월 15일	전환권행사	보통주	4,159	5,000	23,328	2012.02.15~2012.02.23
2012년 04월 06일	전환권행사	보통주	3,000	5,000	23,328	
2012년 05월 02일	주식매수선택권행사	보통주	93,500	5,000	22,800	우리사주매수선택권행사
2012년 05월 04일	전환권행사	보통주	428	5,000	23,328	
2012년 08월 20일	전환권행사	보통주	21	5,000	23,328	
2012년 10월 30일	주식매수선택권행사	보통주	30,300	5,000	22,800	우리사주매수선택권행사
2012년 12월 07일	전환권행사	보통주	3,016	5,000	23,328	2012.12.07~2012.12.18
2013년 02월 13일	전환권행사	보통주	9,527	5,000	23,328	2013.02.13~2013.03.28
2013년 04월 01일	전환권행사	보통주	551,689	5,000	23,328	2013.04.01~2013.06.27
2013년 07월 02일	전환권행사	보통주	15,483,908	5,000	23,328	2013.07.02~2013.08.05
2014년 04월 22일	-	보통주	1,358,537	5,000	-	주식교환
2014년 05월 27일	전환권행사	보통주	4,562,354	5,000	34,394	2014.05.27~2014.06.26
2014년 07월 01일	전환권행사	보통주	10,285,078	5,000	34,394	2014.07.01~2014.09.29
2014년 10월 01일	전환권행사	보통주	1,595,505	5,000	34,394	2014.10.01~2014.10.06

## 4. 주식의 총수 등

### 가. 주식의 총수

2018년 9월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 9,000,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 5,721,980,209주입니다. 보통주 이외에 발행한 다른 종류의 주식은 없습니다. 당기말 현재의 유통주식수는 보통주 684,001,795주 입니다.

당사는 지난 7월 27일에 22,000,000주의 자기주식 취득 계획을 발표하였으며, 동년 9월 28일에 취득을 완료하였습니다. 이로써, 현재 보유 중인 자기주식은 총 44,000,570주 입니다.

※ 관련 공시 2018년 7월 27일 주요사항보고서(자기주식취득결정) 및 2018년 10월 2일 자기주식취득결과보고서 참고

### 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고
-----	--------	----

		보통주	우선주	합계	
I. 발행할 주식의 총수		9,000,000,000	-	9,000,000,000	-
II. 현재까지 발행한 주식의 총수		5,721,980,209	-	5,721,980,209	-
III. 현재까지 감소한 주식의 총수		4,993,977,844	-	4,993,977,844	-
	1. 감자	4,990,449,799	-	4,990,449,799	2003.03.31, 주식병합(21:1)
	2. 이익소각	3,528,045	-	3,528,045	2000.03.31, 이익소각
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)		728,002,365	-	728,002,365	-
V. 자기주식수		44,000,570	-	44,000,570	2014.04.22 주식교환 및 2015.07.23~10.01 장내취득 2018.07.30~09.28 장내취득
VI. 유통주식수 (IV-V)		684,001,795	-	684,001,795	-

## 나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)		
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내	보통주	22,000,000	22,000,000	-	-	44,000,000	-
		직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		장외	보통주	-	-	-	-	-	-
		직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	우선주	-	-	-	-	-	-
	소계(a)	보통주	22,000,000	22,000,000	-	-	44,000,000	-	
		우선주	-	-	-	-	-	-	
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유수량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유수량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주	570	-	-	570	주식교환	
			우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주	22,000,570	22,000,000	-	-	44,000,570	-
			우선주	-	-	-	-	-	-

## 5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	728,002,365	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	44,000,570	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	684,001,795	-
	우선주	-	-

## 6. 배당에 관한 사항 등

### 가. 배당에 관한 정책

정관에 의거한 배당에 관한 당사의 중요한 정책은 다음과 같습니다.

#### (1) 제52조(이익배당)

- ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 배당 할 수 있다.

#### (2) 제54조(중간배당)

- ① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.
- ③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식 배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
- ④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

⑤ 제53조(배당금 지급청구권의 소멸시효)는 중간배당의 경우에 준용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제71기 3분기	제70기	제69기
주당액면가액(원)		5,000	5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		12,143,821	10,641,512	2,953,774
(별도)당기순이익(백만원)		12,011,626	10,110,797	2,655,022
(연결)주당순이익(원)		17,272	15,073	4,184
현금배당금총액(백만원)		-	706,002	423,601
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	6.6	14.3
현금배당수익률(%)	-	-	1.3	1.3
	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	1,000	600
	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-
	-	-	-	-

※ 상기 금액은 연결 재무제표 기준이며, 연결 당기순이익 및 연결 현금배당성향은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익을 사용함.

## II. 사업의 내용

### 1. 사업의 개요

#### 가. 업계의 현황

##### (1) 산업의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신 시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용분야가 매우 광범위 합니다. 시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2018년 10월, 금액기준)에 따르면, 지난 2017년도 세계 반도체 시장규모는 US\$4,204억에 이르렀으며, 이 중 메모리 제품은 US\$1,303억의 시장규모로 전체 반도체 시장의 약 31% 수준에 달하였습니다. 메모리 제품 중 DRAM은 전체 메모리 반도체 시장의 55%를 차지하는 US\$721억을 기록하였으며, 그 뒤를 이어 낸드플래시가 US\$537억으로 41%, 기타 메모리가 US\$44억으로 3%의 비중을 차지하였습니다.

아래 표에 나타낸 바와 같이 반도체 산업은 우리 나라 수출에 있어서 17.1%의 비중을 차지하는 매우 중요한 기간 산업 중 하나입니다. 2017년 반도체 수출은 DRAM 시장 가격 상승 등으로 인해 전년 대비 57.4% 성장하였습니다.

[전체 수출 중 반도체 비중]

(단위: 백만USD,%)

구분	2017	2016	2015	2014	2013	2012
총수출	573,694	495,426	526,757	572,665	559,632	547,870
반도체	97,937	62,228	62,917	62,647	57,144	50,431
전년비 증감률	57.4%	-1.1%	0.4%	9.6%	13.3%	0.6%
비중	17.1%	12.6%	11.9%	10.9%	10.2%	9.2%

※ 출처 : 한국무역협회, 2018년 10월

이러한 반도체는 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 구분됩니다.

##### (가) 메모리 반도체

정보를 저장하고 기억하는 기능을 하는 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)' 과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 플래시메모리를 생산하고 있습니다.

메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM(Integrated

Device Manufacturer)업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다.

#### [DRAM(Dynamic Random Access Memory)]

DRAM은 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(Volatile) 메모리로 주로 컴퓨터의 메인 메모리(Main Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(Graphics Memory)로 사용되고 있으며, 가전제품의 디지털화에 따라 스마트 TV, 스마트 냉장고 그리고 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다. 또한 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿 PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있습니다.

#### [플래시메모리(Flash Memory)]

플래시메모리는 전원이 공급되지 않아도 저장된 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR)형(Code저장형)과 낸드(NAND)형(Data저장형)으로 나눌 수 있습니다. 이 중 당사가 생산하는 낸드플래시는 순차적(Sequential) 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 비디오나 디지털 사진과 같은 대용량 정보를 저장하는데 매우 적합합니다. 낸드플래시 제품이 적용되는 분야는 디지털 카메라, USB드라이브, MP3플레이어, 차량용 내비게이션, SSD(Solid State Drive), Flash Array 그리고 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 모바일 기기 등입니다. 한편, 최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품개발 및 철저한 고객 대응의 중요성이 커지고 있습니다.

#### (나) 비메모리 반도체

비메모리 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로 특성에 따라, 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분류가 되며, 자사는 이중 CIS를 생산하고 있습니다.

#### [CIS(CMOS Image Sensor)]

계산과 추론 등 정보처리기능을 담당하는 비메모리 반도체 중에서도, 이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다. 이미지 센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD(Charge Coupled Device)와 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 두 가지 타입으로 나뉩니다. 최근 CMOS 이미지 센서의 기술이 크게 향상되고 디지털 촬영 기기가 소형화됨에 따라, 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서의 활용 범위가 점차 확대되고 있으며, 특히, CIS의 사용 분야 중 스마트폰과 태블릿 PC향의 출하량과 매출 비중이 각각 50%를 넘어 고성장 추세입니다.

#### (2) 산업의 성장성

반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업 기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다.

2015년 전체 반도체는 -2.2%, 메모리 반도체 분야는 -1.4% 성장하였으나, 2016년은 전체 반도체 시장이 3.3%의 성장을 보였으며 NAND Flash 매출 증가로 인해 메모리 반도체 시장도 1.6% 성장하였습니다. 2017년에도 전체 반도체 시장은 21.6%의 높은 성장을 기록하였으며, 메모리 반도체 분야 역시 61.8%의 높은 성장을 달성하였습니다. (Gartner, 2018년 10월, 금액기준).

메모리 반도체 시장의 생산(공급) 측면은 점진적 둔화가 예상됩니다. 공정 미세화 기술은 한계에 다다르고 있으며, 생산 및 연구 개발을 위한 투자 비용이 급증하고 있는 반면, 고객들의 요구 성능과 품질 수준은 더욱 다양화, 고도화되고 있습니다. 이에 기존과 같은 외형 경쟁을

위한 무리한 공급 확대는 제한적일 것으로 전망됨에 따라, 향후 메모리 반도체 산업은 안정적인 수요와 제한적인 공급으로 인해 메모리 시장 성장의 기회가 더욱 증대할 것으로 예상됩니다.

#### [DRAM]

시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2018년 10월, 금액기준)에 따르면, DRAM 시장은 세계 경제의 점진적 회복 및 모바일 시장 확대, 공급 안정 등의 요인으로 2014년 \$461억(+32%), 2015년 \$446억(-3.3%)의 매출을 기록하였습니다. 이어서 2016년에는 과잉공급으로 인한 평균 판매 가격(ASP: Average Selling Price) 하락으로, \$414억(-7.1%)의 매출을 기록하였습니다. 그러나 DRAM 평균 판매 가격 상승으로 인해 2017년 매출은 큰 폭으로 성장하여 \$721억(+74.1%)을 기록하였습니다. 분야별로 살펴 보면, PC 시장은 수요 정체로 인한 저장장 기조가 유지되어 DRAM 수요를 견인하는데 어려움을 겪고 있으나, 개인용 컴퓨터의 이동성(Mobility)에 대한 요구가 증가함에 따라 울트라북 등 노트북 컴퓨터로의 교체 및 신규 수요가 확대될 전망입니다. 한편, 수요가 지속적으로 증가하고 있는 모바일 기기는 DRAM 수요를 견인하는 주요 분야로서, 스마트폰과 태블릿 PC에서 채용하는 DRAM 용량은 2018년 각각 3.0GB와 2.4GB에서 2022년에는 5.3GB와 3.1GB으로 증가될 것(Gartner, 2018년 10월)으로 예상됩니다. 또한, 고화질 콘텐츠 유통 증가와 주요 게임 콘솔의 출시에 따라 이를 빠르게 처리할 수 있는 그래픽 메모리의 수요도 증가할 전망입니다. 이와 더불어 가상화, Big Data 등 기술고도화로 인해 고용량 Server 중심의 메모리 수요 확대가 이어지고 있습니다. 상기와 같이 디지털 기기의 증가에 따른 DRAM 수요 증가뿐만 아니라, 대용량 콘텐츠 처리를 위한 기기당 탑재량 증가에 따라 DRAM 수요는 앞으로도 지속 증가할 것으로 예상됩니다.

#### [낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 디지털 미디어의 성장과 더불어 스마트폰, 태블릿 PC, 디지털 카메라, MP3 플레이어 그리고 기타 멀티미디어 가전에 사용되는 플래시카드와 USB 드라이브, SSD와 같은 정보저장장치(Storage Devices)등에 널리 사용되고 있습니다.

가트너(Gartner, 2018년 10월 금액기준)의 전망에 따르면 낸드플래시 시장은, 모바일 및 SSD 등 스토리지 분야 적용 확대를 통해 2015년 3.5%(\$308억), 2016년 14.9%(\$354억)의 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. 또한, 평균 가격 상승으로 인하여 2017년은 51.9%(\$537억)의 높은 성장을 기록하였습니다. 이는 스마트폰, 태블릿 PC를 포함한 휴대용 기기 및 PC용 SSD, 기타 응용복합 제품 등 향후 낸드플래시의 수요를 견인할 제품 시장의 지속적 성장 전망에 기반한 것입니다.

향후에는 Cloud Computing 및 IoT 시대가 전개되며 Data Center의 Storage 용량 확대와 실시간 정보처리의 필요성이 높아질 것이며, 이에 따라 Enterprise용 SSD가 일부 HDD를 대체하고 NAND 시장은 또 다른 도약을 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

#### [CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지센서는 1990년대 중반 디지털 카메라에 장착되어 일반 소비자에게 선보인 이후 PC 카메라, 자동차 블랙박스, 휴대폰카메라, 감시카메라 등 다양한 분야에 활용되어 시장 규모도 크게 증가하는 추세입니다. 특히 스마트폰, 태블릿 PC의 카메라 시장의 수요 증가로 시장이 지속 성장할 것으로 보입니다. 가트너(Gartner, 2018년 10월, 금액기준)의 전망에 따르면 이미지센서 시장은 2018년 US\$128억에서 2022년 US\$185억 규모로 연평균 9.6%의 성장이 예상되며, 특히 당사가 생산 중인 CMOS 이미지센서 시장은 다양한 응용기기로의 확대 적용과 수요 증가로 전체 이미지 센서 시장에서의 비중이 2018년 95%에서 2022년 99%까지 확대되며 연평균 10.5%의 성장이 전망됩니다.

### (3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄었습니다.

#### [DRAM]

DRAM은 PC 수요에 상당 부분 의존하여 기업의 PC교체 사이클의 영향을 크게 받아왔습니다. 그러나 최근에는 스마트폰 및 태블릿 PC 등 모바일 기기의 폭발적 성장에 따라 DRAM의 주요 수요처가 PC에서 서버와 모바일로 분산되고 있어, 경기 변동성이 과거에 비해 약화되는 모습을 보이고 있습니다.

한편, 수요의 계절성으로서는 미구주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 등 하반기 수요 증가가 뚜렷했으나, 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산으로 인한 판매시장의 다변화로 이 같은 전통적인 수요의 계절성이 일부 약화되는 모습도 나타나고 있습니다.

#### [낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 과거 MP3 플레이어, 메모리카드 등의 수요증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다. 또한 최근에는 IT 기기가 스마트화되고 고성능화 됨에 따라 낸드플래시의 주 소비형태가 Controller와 Raw NAND가 결합되는 eMMC와 SSD 등으로 바뀌고 있으며 보다 높은 부가가치를 가지게 되었습니다. 아울러, 이들 eMMC와 SSD제품도 DRAM과 같이 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북/PC/Server/Storage/Flash Array 등의 다양한 제품에 장착되기 시작하며, 과거에 비해 경기변동성은 줄어들 것으로 예상됩니다.

#### [CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지 센서 시장은 스마트폰, DSLR 등 전통적인 수요처의 강세가 지속되는 가운데, 자동차용 블랙박스/후방카메라, 스마트 TV 등 다양한 산업군과의 Convergence를 통해 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 또한 이미지 센서 중 자사가 생산중인 CMOS 이미지 센서는 휴대폰, 캠코더, PC 등 멀티미디어 기기 시장의 영향을 크게 받는 제품으로서 소비재의 특성상 경기 변동과 기술변화에 민감할 뿐만 아니라 라이프 사이클이 짧은 특징을 가지고 있습니다.

### (4) 경쟁요소

반도체 사업의 핵심 경쟁력은 1. 기술 및 원가 경쟁력, 2. 시장 대응 능력(고객 확보, 제품 포트폴리오) 3. 설비투자 능력 등이 있습니다.

최근 대량생산이 용이한 표준제품 위주에서 응용분야가 점차 다양화, 융복합화 됨에 따라 시설투자와 생산성 향상을 통한 원가경쟁력 중심에서 제품 가치 증대를 통한 수익성 중심으로 경쟁의 패러다임이 빠르게 전환되고 있습니다.

지금까지는 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이 핵심 경쟁 요소였지만, 공정 미세화의 난이도 증가와 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증대 등 사업환경이 변화하였습니다. 따라서, 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 제품의 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력이 될 것입니다. 아울러 DRAM분야에서의 TSV(Through Silicon Via) 및 New Memory의 원활한 초기시장진 입과 eMMC나 SSD 제품의 시장확대를 위해서는 관련 기술업체와의 협업과 더불어 고객 만족도가 중요해짐에 따라 마케팅 및 고객 지원 활동도 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

이외에도 적기에 시장요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

2018년 3분기는 서버시장 호조 지속과 계절적 회복세를 보인 고용량 모바일 제품 수요 속에, 출하량 증가와 수익성 강화를 통한 견조한 실적을 기록하였습니다. 당사의 연결 기준 매출은 전년 동기 대비 약 41% 증가한 약 11조 4천 1백 7십억원을 기록하였으며, 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 약 73% 증가한 약 6조 4천 7백 2십억 원을 기록하였습니다. 연결 기준 당기순이익은 전년 동기 대비 약 54% 증가한 약 4조 6천 9백 2십억원을 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제71기 3분기 (2018.07.01~ 2018.09.30)	제71기 2분기 (2018.04.01~ 2018.06.30)	전분기 대비 증감	제70기 3분기 (2017.07.01~ 2017.09.30)	전년 동기 대비 증감
매출액	11,416,788	10,370,507	+10%	8,100,085	+41%
누계실적	30,506,985	19,090,197	-	21,081,881	+45%
영업이익	6,472,420	5,573,918	+16%	3,737,193	+73%
누계실적	16,413,675	9,941,255	-	9,255,492	+77%
당기순이익	4,692,193	4,328,543	+8%	3,055,529	+54%
누계실적	12,142,065	7,449,871	-	7,422,719	+64%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

※ 제70기(전기) 및 제69기(전전기)는 종전 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정, 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'에 따라 작성되었습니다.

#### (나) 공시대상 사업부문의 구분

[제71기 3분기 누계]

(단위: 백만원)

구 분	매출액	매출액 비중 (%)	주 요 제 품
반도체 부문	30,506,985	100.0%	DRAM, NAND Flash, MCP 등
합계	30,506,985	100.0%	-

※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '반도체 및 기타 전자부품 제조업 (분류번호 : 321)'에 해당하며, 반도체부문의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 반도체부문으로 기재함.

## (2) 시장점유율

구 분	'18년 2분기	'18년 1분기	'17년	'16년	'15년	'14년	'13년	'12년	'11년
DRAM	30.0%	27.2%	27.8%	26.0%	27.3%	27.1%	26.6%	24.7%	22.8%
NAND Flash	12.1%	11.2%	12.2%	11.8%	12.6%	10.8%	10.7%	9.9%	11.7%

출처: IDC 2018년 9월, 매출액 기준

## (3) 시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

### (가) 메모리반도체 사업

#### [DRAM]

피씨 메모리(PC Memory)는 게이밍 피씨(Gaming PC), 울트라북(Ultrabook), 크롬북(Chromebook)이 판매 증가를 도모하고 있습니다. 특히 게이밍 피씨의 경우, 고사양 게임을 즐기기 위한 사용자의 수요 증가로 피씨 내 작지만 확고한 위치를 자리잡아 가고 있습니다. 울트라북 제품군 내 2-in-1 노트북의 경우는 기능성과 편리성을 갖추고 있어 전체 울트라북의 판매를 촉진하고 있습니다. 크롬북은 북미에서 교육용으로 주로 판매가 증가하고 있으며 저렴한 가격, 다양한 교육용 프로그램 제공이 판매량 증가의 주요 원인으로 꼽을 수 있습니다. 이러한 수요로 인해 피씨 판매량은 하락세에서 유지로 변화되고 있으며, 게이밍 피씨와 울트라북의 평균 메모리 탑재량이 점차 높아지고 있어 지속적인 메모리 수요 증대를 이끌고 있습니다.

서버 메모리(Server Memory)는 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) 분야의 성장세 유지로 지속적인 수요 증대가 전망됩니다. 특히, Enterprise향 Workload 중 Public Cloud로의 전환 가속화 및 Cloud Native Workload 증가에 따라 대형 클라우드 서비스업체들은 Data Center 확장을 위한 투자에 집중하고 있습니다. 또한, 중국 정부 및 자국 기업의 IT 투자 증가 상승이 중국 Public Cloud 및 Local 서버 업체를 큰 성장물로 이끌고 있습니다. 이러한 흐름은 안정적인 서버 수요를 견인하고 있으며 동시에 단일 서버의 가상화 집적도 증가로 인한 서버 DRAM 용량(Content per Box) 상승세 유지에 일조하고 있습니다. 또한 5G 본격화와 함께 급격한 Edge Infra 확충이 이루어질 전망임에 따라 Edge Computing향 수요로 인한 서버 메모리 시장은 긍정적인 전망입니다. 더불어서 AI(Artificial Intelligence)와 ML(Machine Learning) 등을 기반으로 한 Analytics Application의 성장이 본격화되면서 High Bandwidth 및 High Density 메모리 수요가 증가할 것으로 전망합니다. 이에 당사는 해당 수요에 대응할 수 있는 고속, 고용량 서버 모듈(Module) 제품을 공급하며 시장 수요에 적극적으로 대응하고 있습니다.

그래픽스 메모리(Graphics Memory)는 게임, 동영상 및 3D 그래픽 기술의 발전과 함께 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 그래픽스 가속 기능을 기반으로 한 인공지능 분야는 IT 기업의 중요한 성장 전략 분야로 발전하고 있으며, 당사는 데이터 처리 속도를 혁신적으로 향상시킨 HBM(High Bandwidth Memory) 2세대 제품 개발을 마치고 '18년 하반기부터 본격 대량 양산을 하고 있습니다. 주요 그래픽 칩셋 업체 및 Game Console 업체들과의 전략적 관계 강화를 통하여 데스크탑, 노트북, HPC용 등 PC 그래픽 분야와 차세대 Game Console 분야에서도 주도적인 위치를 공고히 하고 있습니다.

컨슈머 메모리(Consumer Memory)는 기존 시장의 고용량화, 신규 시장의 Set 수요 증가에 따라 지속적이고 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 주요 응용분야인 Digital TV, Set-Top-Box 시장의 고사양/고화질(4K~8K) 지원 및 5G 네트워크 시대의 개막은 메모리 탑재 용량을 지속 증가 시킬 것이며, Smart Speaker를 위시한 IoT 시장의 성숙과 자율주행 시대를 준비하는 오토모티브 시장의 고성장은 향후 컨슈머 메모리 수요를 견인하는 신규 모멘텀이 될 것입니다.

이에 당사는, 저용량에서부터 고용량 (2G~32Gb), 범용제품(DDR3/DDR4)부터 저전압/고속 제품(LPDDR4/LPDDR4X), Specialty (IT(Industrial Temperature)/AT(Automotive Temperature)) 제품까지 Full line-up 제품 운영을 통해, 다양한 응용분야 및 고객의 니즈에 적극 대응함으로써 시장에서의 당사 입지를 견고히 하고 있습니다.

모바일 메모리(Mobile Memory)는 Low-power 및 High bandwidth를 필요로 하는 Mobile device (Smartphone/Tablet 등)를 중심으로 채용되고 있으며, 그 외 IoT 및 Automotive, Consumer application으로 채용이 확대되고 있습니다. Mobile application의 대표기기인 Smartphone은 '15년부터 시장 성숙기에 진입하여 현재 정체된 Set 성장률을 보이고 있으나, 연간 두 자리수 이상의 높은 성장률을 보이는 기기당 DRAM 채용량 및 인도 등 신흥시장 내 지속적인 수요 확대 등을 통하여 서버용 DRAM과 함께 전체 DRAM 시장의 수요 성장을 견인하고 있습니다. 특히 Smartphone의 AI on Device, AR 기능, Multiple camera 탑재와 같은 신규기술 채용 및 H/W spec. 경쟁 심화에 따라 고용량 DRAM 채용 추세는 지속될 것으로 전망됩니다. 이에 당사는 최신 Tech의 LPD4X와 Legacy LPD3에 기반한 다양한 PoP/eMCP 제품으로 Line up을 구축, 고객 대응 중에 있으며, 고용량/고성능 구현을 위한 미래제품 개발을 추진 중에 있습니다.

#### [낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 데이터 저장 용도로 쓰이는 대표적인 메모리 반도체로서, 빠른 테크놀로지의 진화로 매년 높은 성장률을 기록하였습니다. 낸드플래시 시장이 가파른 성장세를 지속하는 이유는 최첨단 IT기기 및 다양한 소비자 가전에서 낸드플래시 채용률 및 채용 용량이 지속적으로 높아지고 있기 때문입니다.

과거에는 플래시카드, USB 드라이브, MP3 플레이어, PMP 등이 낸드플래시 메모리의 주요 수요처였으나, 최근에는 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 분야에서 멀티 미디어 기능의 확대에 따른 채용량 증가로 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 스마트 TV, 스마트 카 등의 신개념 도입으로 인하여 과거에 저용량의 낸드플래시 메모리만 사용했던 분야에서도 고용량 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

그리고, 낸드플래시를 기반으로 한 SSD(Solid State Drive)와 같은 다양한 형태의

Storage Solution이 노트북은 물론이고 서버 시장에서도 주요 제품군으로 자리잡고 있어, 향후 낸드플래시 메모리 시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다.

이와 같은, 낸드플래시 시장에서 당사는 저용량부터 고용량까지 다양한 단품 및 응용복합 제품을 기반으로 고객의 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있으며, 응용 분야별선택과 집중을 통하여 낸드플래시 경쟁력을 확보하고 시장 지배력을 높여 가고 있습니다. 또한, 높은 기술력을 바탕으로 다양한 응용복합 제품에 채용 가능한 72단 및 96단 기반의 3D NAND를 개발, 빠른 NAND 시장 변화에 발 맞추어 대응하고 있습니다.

#### (나) 비메모리반도체 사업

##### [CIS (CMOS Image Sensor)]

CIS는 모바일 폰, 노트북, 태블릿, 디지털 카메라 등 다양한 디지털 기기에서 필름 역할을 하는 반도체 소자이며, 2015년부터 2022년까지 연평균 약 7.9%의 성장률을 보일것으로 예상하고 있습니다. (출처: Techno-Systems Research 1H. 2018, 출하량 기준)

모바일 폰, 노트북, 태블릿, 보안 카메라 등에 많이 채용되고 있으며, 화질이 크게 향상되면서 의료 기기, DSLR및 캠코더, 자동차, 게임기, 가전 제품 등으로 응용 범위가점점 확대되고 있습니다. 전체 Application 중 수량 및 매출 비중이 가장 큰 모바일의 경우, 화상 통신 및 Selfie를 위한 전면 카메라(Front Camera)와 사진 촬영을 위한 후면 카메라(Rear View Camera)용으로 두 개의 이미지 센서가 장착되고 있으며, 2016년부터는 후면 카메라에 광학 줌 및 Bokeh 기능을 지원하는 듀얼 카메라가 채용되기 시작하였고, 2018년에는 카메라 기능을 더욱 다양화한 Triple, Quadruple Camera가 채용되면서 기기당 이미지 센서 탑재 비율이 더욱 증가하고있는 추세입니다.

최근 스마트폰 시장에서는 전면 카메라에 16Mp 이상 고화소 제품, 후면 카메라에는 12M~48M 제품이 보편화 되고 있으며, Flagship model에는 Pixel Size를 늘려 화질을 더욱 개선한 제품과 40M이상의 초고해상도 제품이 채용되고 있습니다. 한편, 노트북용 이미지센서 시장은 HD 제품이 주류를 이루고 있으며, 태블릿 역시 5M~13M의 제품이 전면 카메라와 후면 카메라에 채용되고 있습니다.

당사는 이미지센서 시장중 가장 많은 비중을 점유하고 있는 모바일폰 시장과 이와 유사한 성능을 요구하고 있는 노트북, Tablet 시장에 집중하고 있으며, 2012년 4분기에BSI(Back-Side Illumination) 기술을 개발 완료하여 2013년부터 BSI를 적용한 5M, 8M 제품의 안정적 생산과 고객 대응으로 마켓 포지션을 강화하고 있습니다. 2016년에는 advanced BSI 기술을 적용한 13M 제품 개발을 완료하여 시장에 성공적으로 진입하므로써 제품 라인업을 13M까지 확대하였고, 2017년부터는 고화소 시장으로의 진입을 위해 300mm 공정 Setup과 16M 이상 제품 라인업 구축을 위한 1.0um Pixel 개발에 집중하고 있습니다. '18년 하반기 300mm 첫 제품인 13M 제품 출시와 더불어 1.0um 16M 제품 샘플 출시를 통해 고화소 시장 확대를 위한 제품 Line-up 준비에 박차를 가하고 있습니다.

향후 점유율 확대를 위하여 시장의 니즈에 맞추어 제품을 개발하는 것 이외에도, 자동차 및 보안 카메라등과 같이 새로운 시장 진입을 통한 애플리케이션 다양화로 CIS시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

## 다. 사업부문별 재무정보

당사는 반도체 제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문으로서 부문별 기재를 생략합니다.

## 2. 주요 제품, 서비스 등

### 가. 주요 제품 등의 현황

[제71기 3분기 누계]

(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
반도체 부문	제품 외	DRAM, NAND Flash, MCP 등	산업용 전자기기	SK하이닉스	30,506,985 (100%)
합계					30,506,985 (100%)

### 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

2018년 3분기에도 서버 중심의 수요가 견조하게 유지되었습니다. DRAM의 3분기 판매가격은 전 분기 대비 소폭 상승하였으나, 4분기에는 공급부족 상황이 다소 해소될 것으로 보입니다. NAND는 공급사들의 3D 전환 본격화로 3분기 가격이 하락을 지속했으며 4분기에도 추가적인 가격 조정이 예상되고 있습니다.

## 3. 주요 원재료에 관한 사항

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), 리드프레임(Lead Frame) 및 서브스트레이트(Substrate), PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료등으로 구성됩니다.

웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다.

Lead Frame은 반도체 IC를 구성하는 또 다른 주요 요소이며 반도체 칩과 PCB 기판간의 전기신호를 전달하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다.

Substrate는 리드프레임과 같은 기능을 하지만 전기신호를 전달하는 역할을 하는 다리를 기존의 금속 다리가 아닌 공(Ball) 모양의 연결부분을 이용한 부품입니다.

PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 장치하고 납땀하여 회로기능을 완성시키는 인쇄 배선판입니다. 그 외 가스 및 화학약품 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다.

### 가. 주요 원재료 등의 현황

[제71기 3분기 누계]

(단위: 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	투입액	비율	비고
반도체 부문	원재료	Wafer	fab 생산	617,662	14%	-
		Lead Frame& Substrate	package	133,958	3%	-
		PCB	module	131,115	3%	-
		기타	-	1,699,148	38%	-
		소계		2,581,883	58%	-
	저장품	S/P, 부재료	-	1,844,152	42%	-
	합 계			4,426,035	100%	-

### 나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성

당사는 일본, 독일, 미국, 한국 등에 생산시설을 보유한 5개사로부터 반도체 공정의 주요원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 수입하고 있습니다. 당사는 당사와 거래하는 매입처 등과 일상적인 영업활동 이외의 특수한 관계를 갖고 있지 않습니다. 당사가 거래하고 있는 상기 5개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90% 이상을 차지하고 있습니다.

최근 반도체 산업의 호황에 따라 웨이퍼 수요는 지속적으로 증가하는 추세이나, 공급처의 제한적 투자로 공급이 제한되며 가격이 상승하는 추세입니다. 일부 공급처의 소규모 보완 투자로 공급이 일부 증가할 것으로 예상되고 있으나, 공급 증가가 제한적임에 따라 가격 상승 추세는 향후 1~2년간 지속될 것으로 예상됩니다.

당사는 웨이퍼 시장의 수급 동향을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 당사 주요 매입처와의 중장기적 협력 관계를 통해 안정적 생산 지원 및 대응력을 강화해 나갈 것입니다.

## 4. 생산 및 설비에 관한 사항

### 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 4조3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2018년 3분기 총 가동일은 273일로, 각 지역별 FAB의 가동인원 및 가동율을 고려하여 계산한 당사의 평균가동시간은 월 14,734,720시간입니다.

생산능력은 "해당 연간 최대생산 일의 생산량 x 누적일수 x 평균원가"의 방법으로 산출하고 있으며, 2018년 3분기 생산능력은 13,045,474백만원 입니다.

(단위 : 백만원 )

사업부문	제71기 3분기	제70기	제69기
------	----------	------	------

반도체 부문	13,045,474	14,063,811	12,054,238
--------	------------	------------	------------

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

## 나. 생산실적 및 가동률

당사의 2018년 3분기 생산실적은 13,045,474백만원으로 집계되었으며, 동 기간 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.

### (1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	제71기 3분기	제70기	제69기
반도체 부문	13,045,474	14,063,811	12,054,238

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

### (2) 가동률

(단위 :시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률
반도체 부문	132,612,480	132,612,480	100%

※가동률은 각 지역별 제조 인원을 고려하여 계산함.

## 다. 생산설비의 현황

당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일 현재 약 31조 2천 5백 9십 5억 원이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위

:백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합계
2018.01.01								
취득원가	581,541	3,807,323	1,262,927	46,463,886	3,081	1,217,216	3,137,621	56,473,596
감가상각누계액		(851,655)	(404,204)	(30,163,696)	(2,304)	(774,959)		(32,196,818)
손상차손누계액		(23,699)	(19,104)	(165,509)		(35)		(208,346)
장부보조금		(1,217)		(4,613)		(2)		(5,831)
기초순장부금액	581,541	2,930,753	839,620	16,130,068	777	442,221	3,137,621	24,062,601
기중변동액								
취득	57,305	644,225	181,283	7,030,803	11,099	155,324	3,611,179	11,691,218
처분		(25,542)	(3,065)	(91,819)		(1,210)	(28,562)	(150,197)
손상차손								
감가상각		(103,677)	(47,815)	(3,998,427)	(653)	(134,590)		(4,285,162)
대체	124,092	641,352	45,649	1,588,860		15,938	(2,414,908)	984
환율변동 등	430	(2,140)	(2,163)	(29,002)	(27)	(792)	(26,259)	(59,953)
기말순장부금액	763,367	4,084,971	1,013,510	20,630,483	11,196	476,892	4,279,071	31,259,492
2018.09.30								

취득원가	763,367	5,057,879	1,472,255	54,018,575	13,964	1,375,019	4,279,071	66,980,131
감가상각누계액		(948,034)	(439,642)	(33,219,660)	(2,745)	(898,095)		(35,508,175)
손상차손누계액		(23,699)	(19,104)	(164,485)		(32)		(207,319)
정부보조금		(1,175)		(3,947)	(23)			(5,145)
기말순장부금액	763,367	4,084,971	1,013,510	20,630,483	11,196	476,892	4,279,071	31,259,492

## 라. 투자계획

2018년 3분기 당사의 입고 기준 투자집행 실적은 다음과 같습니다.

[입고기준]

(단위 : 십억원)

구분	투자대상자산	투자효과	투자 기간	기투자액 (누적)	비고
보완투자 등	기계장치 외	생산능력증가	2018.01.01~ 2018.09.30	11,791	-
합계				11,791	-

## 5. 매출에 관한 사항

### 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제71기 3분기	제70기	제69기
반도체 부문	제품 외	DRAM, 낸드플래시, MCP 등	30,506,985	30,109,434	17,197,975
합계			30,506,985	30,109,434	17,197,975

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

※ 제70기(전기) 및 제69기(전전기)는 종전 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정, 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'에 따라 작성되었습니다.

### 나. 판매경로 및 판매방법 등

#### (1) 판매조직

국내에서는 마케팅부문 관할 하에 대리점 6개사를 운영하고 있습니다. 해외 판매법인은 미국, 독일, 영국, 일본, 싱가포르, 인도, 대만, 중국 등 총 8개 국가에 10개 법인이 소재하고 있으며 산하에 14개 사무소 및 17개 대리점을 두고 있습니다.

#### (2) 판매경로

당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을통해서 일반 기

업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.

### (3) 판매방법 및 조건

내수 판매는 국내 대리점 등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 납품하고 있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 거래 등으로 납품하고 있습니다.

### (4) 판매전략

당사 판매 전략은 비즈니스 포트폴리오 최적화, 수익 구조 개선, 고객 관계 유지, 지역별 포지셔닝 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다.

비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다. 수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래 시장 발굴을 추진하고 있습니다. 고객 관계 유지를 위해서 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다. 지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.

### (5) 주요 매출처

반도체는 IT 제품군 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양합니다. 당사는 세계 유수의 모바일 및 컴퓨팅 관련 전자업체에 제품을 공급하고 있으며, SSD와 같은 대용량 저장장치와 메모리 카드 생산업체 등을 고객으로 확보하고 있습니다.

## 6. 수주상황

당사는 주요 고객사들과 월별/분기별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기 공급 계약에 따른 수주 현황은 없습니다.

## 7. 시장위험과 위험관리

### 가. 시장위험

#### (1) 환율변동위험

연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때발생합니다.

당분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	12,108	13,472,705	5,565	6,192,143
EUR	20	25,255	315	408,025
JPY	25,406	249,274	181,928	1,785,027

당분기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동을 가정한 화폐성 외화자산 및 외화부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	728,056	(728,056)
EUR	(38,277)	38,277
JPY	(153,575)	153,575

## (2) 이자율위험

연결실체의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결실체는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 3개월간 연결실체의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이익은 각각 5,939백만원 만큼 증가 또는 감소하였을 것입니다.

## (3) 가격위험

연결실체는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

# 나. 회사의 위험관리 정책

## (1) 위험관리의 일반적 전략

### [주요 시장위험요소]

당사는 외화표시 자산 및 부채에 대해 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영 안정성 제고를 목표로 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 또한 당사는 영업 측면에서 매출의 90% 이상이 USD로 발생되어 USD 수입이 지출보다 많은 구조를 가지고 있으므로 수입에서 지출을 차감한 잔존 외화 현금흐름을 환리스크 관리의 주 대상으로 하고 있습니다.

### [위험관리규정]

당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정, 외환관리위원회 구성 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 그 주요 내용은 ①외환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 외환관리위원회가 설정한 지침에 따라 관리하고 있습니다.

## (2) 위험관리조직 및 운영 현황

당사는 외환관리에 관한 의사결정기구로서 외환관리위원회를 운영하고 있으며, 외환관리위원회의 주요 업무는 다음과 같습니다.

- ① 외환 관리 정책, 전략 심의 및 의결
- ② 외환 관리 규정의 제정 및 개정
- ③ 외환관리 목표와 허용 손실한도의 설정
- ④ 외환위험 헤지 범위 및 헤지 비율, 관리수단 등의 조정
- ⑤ 외환포지션, 환율 변동 영향, 환율 전망 등 환관련 정보의 공유

## 8. 파생상품 거래현황

(1) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 파생상품은 없습니다.

(2) 당분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한 평가손익 및 거래손익은 없으며, 전분기 중 인식한 평가손익 및 거래손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)								
구 분	평가이익		평가손실		거래이익		거래손실	
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
이자율스왑	(188)	-	-	-	492	902	304	913

## 9. 경영상의 주요계약 등

계약 상대방	항목	내용	비고
삼성전자	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	-
	계약 기간	2013년 6월 1일 이후	
	목적 및 내용	삼성전자가 보유하고있는 반도체 관련 모든 특허에 대한 사용권을 확보하여 향후 잠재적 분쟁 가능성 원천적 해소	
	기타 주요내용	-	
Rambus Inc.	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	-
	계약 기간	2013년 7월 1일 ~ 2024년 6월 30일	
	목적 및 내용	라이선스 계약을 통해 반도체 전 제품 기술 관련 램버스 보유 특허에 대한 사용권한을 확보하여 향후 분쟁 가능성 해소	
	기타 주요내용	특허 및 반독점 소송 등 램버스와 진행중인 모든 소송 취하	
실리콘화일	계약 유형	주식교환계약	-
	계약 체결일	2014년 1월 28일	
	목적 및 내용	주식의 포괄적 교환을 통해 실리콘화일을 완전자회사로 편입하여 CIS 사업의 경영 효율성 증대	
	기타 주요내용	주식교환일: 2014년 4월 22일 주식교환비율: 에스케이하이닉스 보통주 : 실리콘화일 보통주 =1 : 0.2232438	
Softeq Flash Solutions LLC	계약 유형	주식 인수	-
	계약 체결일	2014년 5월 15일	
	목적 및 내용	NAND Flash 개발 역량 향상을 위해 인수	
	기타 주요내용	-	
Violin Memory	계약 유형	자산 인수	-

	계약 체결일	2014년 5월 29일	
	목적 및 내용	NAND 솔루션 역량 강화를 위해, Violin사의 PCIe Card 부문 자산 및 인력을 인수	
	기타 주요내용	PCIe Card 관련 특허에 대한 Cross-License 체결	
Sandisk Corporation	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약 등	-
	계약 기간	2015년 8월 ~ 2023년 3월	
	목적 및 내용	1) 기존 특허 cross license 계약 연장 2) 동 기간 동안 당사의 DRAM 제품을 판매하는 장기 공급계약 체결 3) 양사간 진행 중인 영업비밀 소송은 취하하기로 합의함	
	기타 주요내용	-	
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	계약 유형	영업 양도	-
	계약 기간	2017년 7월 1일 (영업/자산 양도 시점)	
	목적 및 내용	Foundry 사업의 책임 경영을 통한 수익성 및 사업가치 제고	
	기타 주요내용	1) Foundry 사업과 관련된 자산 등의 포괄적 양도 2) 이사회 의결일 : 2017년 5월 24일	
BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP	계약 유형	특수목적법인(SPC)에 대한 출자 (신규 설립)	-
	계약 기간	2017년 9월 28일 이후	
	목적 및 내용	Bain Capital이 General Partner로서 구성한 특수목적법인(SPC)이 도시바의 반도체 사업 지분을 인수하며, 당사는 이에 대한 Limited Partner로서 투자에 참여	
	기타 주요내용	-	
BCPE Pangea Cayman2 Limited	계약 유형	특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득	-
	계약 기간	2017년 9월 28일 이후	
	목적 및 내용	Bain Capital과의 특수목적법인(SPC)의 전환사채를 취득하고, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환 시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보 가능	
	기타 주요내용	-	

## 10. 연구개발활동

### 가. 연구개발 담당조직

당사는 보고서 제출일 현재, 메모리연구소 및 제품개발연구소, NandSolution & 미래기술 연구소 등에서 연구개발 활동에 주력하고 있습니다.



제70기	1) 3D 256Gb TLC	업계 최초로 개발한 72단 3D NAND FLASH로, 기존 48단 제품 대비 동위 단위면적당 셀의 수가 많아 고용량 확보에 유리함. SSD와 모바일 기기에 적용 예정이며 향후 매출 기여 예상됨.
	2) 2znm 8Gb GDDR6	2znm Tech. 기반의 GDDR6 제품으로 384개의 정보입출구 (I/O)를 활용해 초당 최대768GB의 그래픽 데이터 처리가 가능. 향후 인공지능 및 가상 현실 등의 솔루션 등에 활용되며 매출 확대 효과 발생 예상됨.
	3) 3D PCIe NVMe Client SSD	72단 3D NAND를 적용한 PCIe Client SSD 제품으로, 기존 36단 제품을 72단으로 전환함으로써 수익성 개선에 기여 전망
	4) 3D UFS 2.1	원가와 성능을 개선한 2세대 UFS 컨트롤러를 탑재하고, 기존 적용하던 36단 3D NAND를 48단으로 전환해 향후 수익성 개선에 기여 전망
	5) 3D eMMC 5.1	기존 적용하던 36단 3D NAND를 72단으로 전환하고, 자체 개발한 eMMC 컨트롤러를 적용해 매출 확대에 기여 예상
	6) 2znm 8Gb HBM2 Gen1	TSV 기술을 활용해 대역폭을 크게 늘림으로써 초당 204GB의 Data 처리가 가능한 초고속/저전력 제품. 고객과의 협업체제 구축으로 향후 매출 확대 기여 예상

구 분	연구과제명	기대효과
제69기	1) 2znm 4Gb LPDDR4	2znm Tech. 파생제품 첫번째로 개발 완료한 프로젝트이며, 2znm 제품 대비 원가 경쟁력을 갖춘 제품으로 2016년 High End Mobile Phone 시장에서 자사 수익성에 기여할 예정이며, Automobile/Consumer/Computing 등 LPDDR4제품을 활용한 타 어플리케이션 신규 시장 진입으로 향후 매출 확대 효과 발생 예상됨.
	2) 2znm 6Gb LPDDR4	2znm 6Gb LPDDR4 후속 공정 제품으로 2016년부터 Premium Mobile Phone 시장대응으로 자사 수익성 향상 및 '16년 LPDDR4X 신규 시장 SoC Validation 및 고객샘플 적기 대응으로 향후 매출 기여 예상됨.
	3) 3D eMMC5.1	3D NAND를 사용한 첫 번째 eMMC 솔루션 개발 완료 프로젝트로, 2D 대비 원가 경쟁력 확보한 3D NAND 통해 수익성 개선 예상함.
	4) 1xnm SATA Enterprise SSD	1xnm NAND 적용한 Enterprise향 SSD 제품 개발 완료. Enterprise SSD 시장 확대 통한 매출 및 수익성 확보할 것으로 기대함.
	5) 3D PCIe Enterprise SSD	3D NAND를 사용한 Enterprise향 PCIe SSD 제품 개발 완료. 3D NAND 및 PCIe NVMe 적용한 첫 제품이기에 매출 확대와 수익성 개선 예상함.
	6) 8MP, 1/4" (90nm BSI, 1.12um, Raw Sensor)	Hi-842 대비 픽셀특성향상, Analog 성능향상, 기능추가(2D-LSC)개선 제품으로 Smartphone의 front & main camera 시장 진입으로 2016년 1Q부터 고객사 양산물량 공급으로 매출 확대 기여할 것으로 예상함.
	7) 5MP, 1/5"(90nm BSI, 1.12um, Raw Sensor)	대형고객 진입을 목표로 픽셀성능 및 센서성능을 개선한 제품으로 1분기부터 매출 확대에 기여할 것으로 예상함.
	8) 2znm 8Gb DDR4	컴퓨팅 시장에서 DDR4의 고용량 DIMM(32GB, 64GB) 및 High

	Speed 제품 (2666Mbps)에 대한 수요가 커지는 시점에서 수익성 극대화 및 시장 적기대응을 위한 제품 개발로, 서버 및 PC향 대응 및 수익성 기대
9) 2znm 8Gb GDDR5	게임 콘솔향 GDDR5 판매 확대 및 안정적 시장 확보 및 Graphics High Density / High Speed 수요 전환 대응을 통한 수익성 확보 기대
10) 2znm 4Gb DDR3x16	2ynm 4Gb DDR3x16 의 후속 공정 개선을 통한 디지털TV/셋톱박스 등의 시장 장기 공급 대응으로 수익성 확보 기대
11) 2znm 8Gb LPDDR3N	2ynm 8Gb LPDDR3 후속 Tech Version 제품. Net Die 극대화에 따른 Cost 경쟁력을 바탕으로 자사 수익성 극대화에 기여가 예상됨. 또한 Speed Target 2133Mbps 확보로 주요 PC 업체향 대응이 가능하여 2ynm 8Gb LPDDR3 대비 매출 확대가 예상됨.
12) 3D UFS 2.0	3D NAND(36단)를 적용한 UFS2.0 제품 개발 완료. 기존 2D 탑재 제품 대비 성능과 특성이 개선되어 모바일 시장에서 High performance 요구 고객 중심으로 매출 확대 예상
13) 3D SATA Client SSD	3D NAND(48단)을 적용한 SATA Client SSD 제품으로, 3D TLC NAND를 적용한 자사 최초 SATA Client SSD 제품. 주요 PC업체 진입을 통한 매출 확대 및 수익성 개선 예상
14) 1ynm 128Gb TLC	기존 1xnm급 NAND제품의 미세화를 통해 원가경쟁력을 극대화한 제품. 개선된 성능과 특성으로 Mobile / SSD등에 널리 채용될 예정
15) 8MP, 1/4" (90nm BSI, 1.12um, Raw Sensor)	Hi-843 대비 픽셀, Analog/Digital 성능 향상 및 die size 축소로 품질/가격 경쟁력 향상한 제품. 모바일 폰의 전/후방 카메라 시장 진입으로 내년 초부터 매출 확대 기여 예상
16) 5MP, 1/5"(90nm BSI, 1.12um, Raw Sensor)	Hi-553 대비 픽셀, Analog/Digital 성능 향상 및 net die 증가로 품질/가격 경쟁력 향상한 제품. 모바일 시장 진입으로 향후 매출 확대에 기여 예상
17) 5MP, 1/4"(90nm BSI, 1.4um, Raw Sensor)	Hi-545대비 성능은 동등 수준 이상을 유지하며 net die를 극대화한 제품으로 향후 매출 기여 기대
18) 13MP, 1/3"(90nm BSI, 1.12um, Raw Sensor)	13M 고화소 제품으로, Hi-1331대비 성능이 향상되었으며올 하반기에 고객사들의 인증을 거쳐 향후 매출 발생 예상
19) 2zm 4Gb DDR4	2ym 4Gb DDR4 의 후속 공정 미세화 제품으로 '17년 이후 DDR4 기반의 디지털TV, 셋톱박스 등의 시장 확대로 매출 확대 예상
20) 2znm 8Gb LPDDR4X	고용량, 고속, 저전력 특성의 LPDDR4 파생제품으로서 플래그십 스마트폰 모델 탑재를 통한 매출 기여 예상. 향후 그래픽 등 다른 응용처에 대한 대응도 예상 중
21) 2znm 2Gb LPDDR4	DRAM 양산 제품 최소로 2znm 기술에서 On-die ECC (Error Correction Code) Scheme 탑재한 제품으로, 모뎀과 오토모티브 등의 응용처를 통한 매출 예상
22) 2znm 6Gb LPDDR4E	2znm 6Gb LPDDR4 의 파생제품으로 '17년 상반기부터 고사양 스마트폰에 대한 양산물량 공급으로 매출 확대 기여
23) 3D PCIe NVMe Client SSD	3D NAND(36단)을 적용한 PCIe Client SSD 제품으로 제품 판매를 통한 매출 기여와 함께 2D에서 3D로 NAND 기술 전환 통해

		수익성 개선 예상
구 분	연구과제명	기대효과
제68기	1) 2y나노급 6Gb LPDDR3	미세공정 전환을 통한 수익성 개선 제품으로 High-end Smartphone & Tablet 向 LPDDR3 제품 개발을 통한 매출 확대에 기여할 것으로 예상
	2) 1x나노급 64Gb TLC	3 bit cell 기술을 기반으로 개발된 저가 시장 대응용 제품임, 우수한 원가 경쟁력을 바탕으로 USB, Card 시장부터 Mobile시장까지 진입할 예정임
	3) 1x나노급 1st PCIe Client SSD	1x나노급 NAND를 채용한 PCIe 컨트롤러 탑재 1st Client SSD 제품으로 SATA에 이은 PCIe SSD 시장 진출 기반을 마련하였고, SSD 라인업이 보강되어 고객 확대에 기여할 것으로 예상됨.
	4) 1x나노급 2nd eMMC5.0	1x나노급 NAND를 채용한 eMMC 5.0 제품 개발 완료. 기존 제품 대비 Sequential Write(연속 쓰기)와 Sustain Performance를 개선하였으며, 차세대 eMMC5.1 기능 일부를 추가 반영하여 Mid-high 시장의 수익성 개선에 기여 할 것으로 예상됨.
	5) 2M, 1/5" (130nm, 1.75um, Raw Sensor)	기존 2M SoC Sensor에서 Image Signal Processor를 제외한 Raw Sensor 제품으로서 보급형 스마트폰 시장의 Low Cost Solution 요구를 만족시킴으로서 2M SOC 시장을 대체해 갈 것으로 예상됨.
	6) 2y나노급 2Gb DDR3(x16)	Embedded Application 4Gb 수요의 점진적 확대에도 불구하고 2015년 이후에도 DTV/STB 2Gb 수요가 견조할 것으로 예상되며, 미세공정 전환을 통한 수익성 개선이 예상됨
	7) 1x나노급 1st eMMC5.1	1x나노급 NAND를 채용한 eMMC5.1 제품으로 eMMC5.1 초기 시장에 진입할 제품이 준비됨에 따라 모바일 솔루션 시장에서의 매출과 수익성 확보에 기여할 것으로 예상함
	8) 1x나노급 2nd Client SSD	1x나노급 NAND를 채용한 Client SSD로 TLC NAND를 적용한 채널형 제품으로 기존 MLC NAND를 활용한 SSD 대비 원가 경쟁력 확보하였으며, OEM 시장에 이어 Channel 시장 매출 확대로 SSD 수익성이 개선될 것으로 예상됨
	9) 8MP, 1/4" (90nm BSI, 1.12um, Raw Sensor)	설계 개선을 통해 원가경쟁력을 증대시킨 수익성 개선 제품으로 중국 등 Mid-end 스마트폰의 전후방 카메라와 태블릿 시장 진입으로 하반기 이후 매출 확대에 기여할 것으로 예상
	10) 2z나노급 4Gb DDR3	2z나노급 DRAM 제품으로 원가경쟁력 증대로 수익성 개선이 예상되며 4Gb DDR3 시장 지속 대응 예정.
	11) 1x나노급 1st UFS2.0	1x나노급 NAND를 채용한 UFS2.0 제품 개발 완료. UFS 시장 초기에 제품 출시하여 High-end 시장에서의 경쟁력 강화될 것으로 예상됨.
	12) 36단 128Gb MLC	NAND 차세대 기술로 주목받고 있는 3D 적층 기술을 적용한 자사의 첫 상용화 제품으로, 우수한 특성과 신뢰성을 가졌으며 향후 모바일 시장을 중심으로 매출에 기여할 것으로 예상됨.
	13) 1xnm급 PCIe NVMe Client SSD	PCIe NVMe 인터페이스 적용한 Client SSD 개발 완료. Client 시장이 SATA에서 NVMe 시장으로 전환되고 있어 Client 시장 점유율 확대에 기여할 것으로 기대함.
	14) 1xnm급 SATA Client SSD	1xnm급 NAND 채용한 3번째 SATA Client SSD 개발 완료. 기존

		SATA 컨트롤러 대비 여러 정정능력 개선한 컨트롤러 사용. TLC NAND 비즈니스 규모 확대하여 수익성 개선될 것으로 예상함.
15) 5MP, 1/5" (90nm BSI, 1.12um, Raw Sensor)		Hi-551 대비 설계 개선을 통해 원가경쟁력을 증대시킨 수익성 개선 제품으로 중국 및 국내 Mid-end 스마트폰의 front & main 카메라 시장 진입으로 4분기부터 매출 확대 기여.

## 11. 기타 투자이사결정에 필요한 사항

### 가. 최근 3년간 신용등급

[국내]

평가일	평가대상 유가증권 등	신용등급	평가회사	신용평가 등급범위	평가구분
15.05.27	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	정기평가
15.05.27	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	정기평가
15.05.28	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	정기평가
15.06.25	기업어음	A1	한기평	A1~D	본평가
15.06.25	기업어음	A1	한신평	A1~D	본평가
15.06.26	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	본평가
15.08.13	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	본평가
15.08.13	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	본평가
15.08.13	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	본평가
15.11.13	기업어음	A1	한기평	A1~D	정기평가
15.11.13	기업어음	A1	한신평	A1~D	정기평가
15.11.13	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	정기평가
15.11.13	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	본평가
15.11.13	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	본평가
15.11.13	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	본평가
16.02.03	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	본평가
16.02.04	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	본평가
16.02.04	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	본평가
16.05.17	기업어음	A1	한기평	A1~D	본평가
16.05.16	기업어음	A1	한신평	A1~D	본평가
16.05.17	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	본평가
16.05.17	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	본평가
16.05.16	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	본평가
16.05.17	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	본평가
16.12.15	기업어음	A1	한기평	A1~D	정기평가
16.12.08	기업어음	A1	한신평	A1~D	정기평가
16.12.16	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	정기평가
17.05.19	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	정기평가
17.06.08	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	정기평가
17.06.30	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	정기평가
17.11.07	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	수시평가

17.11.09	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	수시평가
17.11.15	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	수시평가
18.04.26	회사채	AA	NICE신평	AAA ~ D	정기평가
18.05.16	회사채	AA	한신평	AAA ~ D	정기평가
18.05.31	회사채	AA	한기평	AAA ~ D	정기평가

[해외]

평가일	평가대상 유가증권등	평가대상 유 가증권의 신용등급	평가회사	신용평가등급 범위	평가구분
16.05.13	발행회사	BB+	S & P	AAA ~ D	수시평가
16.11.07	발행회사	Ba1	Moody's	Aaa ~ C	수시평가
17.01.20	발행회사	BBB-	S & P	AAA ~ D	수시평가
17.11.06	발행회사	Baa3	Moody's	Aaa ~ C	수시평가
17.11.23	발행회사	BBB-	S & P	AAA ~ D	수시평가
18.10.23	발행회사	Baa2	Moody's	Aaa ~ C	수시평가

[참고] 국내 신용평가사 (NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 등급정의

신용등급	등급의 정의
AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임
AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음
A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음
BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음
BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음
B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임
CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음
CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음
C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음
D	현재 채무불이행 상태에 있음

※ AA ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 국내 신용평가사(NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 기업어음의 등급정의

신용등급	등급의 정의
A1	적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임
A2	적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3	적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임
B	적기상환능력이 적정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음
C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼
D	상환 불능상태임

※ A2 ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 해외 신용평가사 Moody's 등급 정의

신용등급	등급의 정의
Aaa	최소한의 신용 리스크를 보이며, 최고의 신용상태를 가진 것으로 판단됨.
Aa	신용상태가 우수한 것으로 판단되며 신용리스크가 매우 낮음.
A	중상위 등급으로 간주되며 신용 리스크가 낮음.
Baa	신용 리스크가 보통 수준임. 이들은 중위 등급으로 간주되며 그에 따라 일부 투기적 특징을 가질 수 있음.
Ba	투기적 요소가 있는 것으로 판단되며 신용 리스크가 상당한 수준임.
B	투기적인 것으로 간주되며 신용 리스크가 높음.
Caa	신용상태가 불량한 것으로 판단되며 신용 리스크가 매우 높음.
Ca	투기성이 매우 높고 부도상태이거나 부도에 매우 근접해 있을 가능성이 높으며 원리금 회수 가능성이 어느 정도 있음.
C	채권의 최하 등급. 일반적으로 부도상태이고 원리금 회수 가능성이 거의 없음.

※ Aa부터 Caa까지 각 일반 등급 분류에 1,2,3의 숫자를 부여함. 숫자 1은 해당 등급 분류 내에서 상위에 있음을, 숫자 2는 중위에, 숫자 3은 하위에 있음을 나타냄.

[참고] 해외 신용평가사 S&P 등급 정의

신용등급	등급의 정의
AAA	채무상환능력이 극히 높음. 최상 등급임.
AA	채무상환능력이 매우 높음, 상위 등급과 크게 차이는 없으나 최고 수준은 아님.
A	채무상환능력이 높음, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BBB	채무상환능력은 충분하나, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BB	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 적으나, 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 충분히 고려됨
B	현재로서는 채무상환능력이 있으나, 상위 등급의 기업에 비해 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 높음.
CCC	현재 채무불이행 가능성이 있으며, 채무이행 능력은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 있다고 보여짐.
CC	채무불이행 가능성이 현재로서 상당히 높음.

D	채무만기시 1건 이상의 채무를 상환하지 못한 기업을 의미함.
---	-----------------------------------

※ AA등급에서 CCC등급까지는 해당 등급에서의 상대적인 위치에 따라 '+', '-'를 추가로 부여할 수 있음.

## 나. 회사의 고객관리 정책

당사는 IT 산업을 대표하는 글로벌 기업으로서 당사 매출기여도가 매우 높고 당사 판매 전략과 부합하는 고객을 '전략 고객(Strategic Account, S/A)'으로 정하여 관리하고 있으며, 각 응용 분야별 전략 고객의 관리를 통하여 안정적인 매출 기반을 확보함은 물론 제품 구성을 다양화하여 수익성을 극대화하고 있습니다.

## 다. 지식재산권 보유현황

2018년 9월 30일 현재 당사는 반도체와 관련하여 총 12,712건(특허 12,508건/상표 204건)의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 매분기 기 등록된 권리를 평가하여 등록유지 또는 포기여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동할 수 있습니다.

당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담조직에 의해 관리되고 있으며, 당해 전문 인력은 지식재산권 개발, 출원/등록, 사후관리 및 관련 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다

특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호되고 있습니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기한을 연장할 수 있습니다.

## 라. 정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항

'산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제11조'에 의하여 국가핵심기술로 지정된 반도체 제조기술을 해외로 이전하는 경우, 수출자는 산업통상자원부에 신고할 의무를 지니고 있습니다. 이에 당사는 제품개발 경쟁력 강화를 위한 해외 생산공장 및 기술센터에 반도체 기술 이전 시 관련법 및 절차를 준수 이행하고 있습니다.

## 마. 환경보호 정책 및 현황

### (1) SHE경영시스템 인증

당사는 국제 인증규격인 OHSAS18001(안전보건경영시스템) 및 ISO14001(환경경영시스템)과 국내 인증규격인 KOSHA18001(안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리 하고 있으며, 이를 통해 SHE경영활동의 객관성 확보 및 효과를 극대화하기 위한 활동들을 수행하고 있습니다. SHE 경영시스템 내부 전문심사원을 양성하여 기업활동으로 인해 발생하는 안전보건환경 영향요인을 모니터링 하고, 또한 이를 효율적으로 관리하기 위해 전담조직을 구성하여 체계적으로 관리하고 있습니다. 당사는 안전보건 및 환경 분야의 지속적인개선을 추구하고, 환경영향을 최소화하고 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위한 노력을 지속적으로 수행해 나 갈 것입니다.

## (2) 기후변화 협약 대응

당사는 기후변화와 관련된 유무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고 고객 및 정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에 대한 새로운 가치를 창출할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다.

### [온실가스 배출권거래제 대응]

당사는 2015년부터 시행되고 있는 온실가스 배출권거래제 참여기업으로 정부로부터 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 온실가스 저감 활동을 펼치고 있습니다. 온실가스 배출권거래제는 정부가 각 기업에게 온실가스를 배출할 수 있는 배출권을 부여하고 기업들은 시장원리에 의해 형성된 배출권 가격을 토대로 각 기업별 한계저감비용에 따라 배출권을 매입하거나 매도하는 제도입니다. 당사는 배출권 부족분(초과 배출량)의 구매 비용을 최소화하기 위해 온실가스 저감장치(스크러버) 측정 기술을 개발/운영하여 배출량 저감을 유도하고 있으며, 배출권 거래를 포함한 배출권 관리, 배출권 감축 등의 전사 TF 활동을 추진하고 있습니다.

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제2014-162호)에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되었으며, 매년 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 배출권거래제 TF를 조직하여 이에 체계적으로 대응하고 있습니다.

「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2017년 온실가스 배출량은 최종 3,077,306톤 CO<sub>2</sub>e (tCO<sub>2</sub>e)입니다.

### [CDP(탄소정보 공개 프로젝트) 탄소경영 최우수기업 명예의 전당 5년차 유지]

당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는 탄소경영 최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 6년 연속 편입되어 국내 최초로 명예의 전당에 입성, 2017년 명예의 전당 5년차를 유지하였습니다.

## (3) 친환경제품을 위한 노력

### [전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)/물발자국/탄소성적]

당사는 매년 DRAM 및 NAND Flash 메모리의 주요 제품에 대하여 전과정평가를 수행하고 있습니다. 회사는 2013년 환경부로부터 20나노급 4G DDR3 제품에 대하여 업계 최초 환경성적표지 인증을 획득하였으며, 2014년에는 20나노급 64Gb NAND Flash 제품까지 인증을 확대 하는 등 지속적으로 LCA 평가결과에 대한 제 3자 인증을 확대하고 있습니다. 특히 2016년에는 국내 최초로 20나노급 4Gb DDR3 제품에 대하여 미국 UL社로부터 물 발자국 인증을 획득하였습니다. 2017년에는 환경부로부터 당사가 생산하는 8Gb LPDDR3 제품에 대하여 업계 최초 물 발자국 인증을 획득하였습니다. 회사는 향후에도 지속적으로 주요 제품에 대하여 친환경 제품 인증을 확대하고, 이해관계자 들에게 친환경 정보를 제공할 계획입니다.

## (4) 기타 환경보호 정책

2009년 5월, 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합 및 환경경영 전문가로 환경경영검증위원회를 구성하여, 당사 환경경영성과에 대한 검증을 진행하여

환경경영검증위원회 보고서를 발행하였습니다. 2010년도부터는 검증위원회를 자문위원회로 변경, 환경경영자문위원회를 개최하고 있으며, 당사의 전반적인 환경경영 및 환경전략 관련 의견을 수렴하여 경영활동에 반영하고 있습니다.

또한 2015년도에는 외부 전문가로 구성된 산업보건검증위원회를 발족하여 당사의 작업환경 및 복지 제도 등 보건분야 진단을 통해 127개 개선과제를 도출하였고, 2018년 8월에 산업보건검증위원회로부터 최종 검증 완료보고서를 수취 완료하였습니다.

### III. 재무에 관한 사항

#### 1. 요약재무정보

##### 가. 요약연결재무정보

(단위 :백만원)

구분	제71기 3분기	제70기	제69기
[유동자산]	17,700,533	17,310,444	9,838,982
· 현금및현금성자산	2,340,357	2,949,991	613,786
· 단기금융상품	388,229	4,674,862	1,951,721
· 단기투자자산	2,946,807	929,801	1,570,172
· 매출채권	7,711,347	5,552,795	3,251,652
· 재고자산	3,686,740	2,640,439	2,026,198
· 기타	627,053	562,556	425,453
[비유동자산]	39,676,719	28,108,020	22,377,044
· 관계기업 및 조인트벤처투자	564,441	359,864	131,016
· 장기투자자산	4,005,499	43,226	147,779
· 유형자산	31,259,492	24,062,601	18,777,402
· 무형자산	2,469,187	2,247,290	1,915,591
· 기타	1,378,100	1,395,039	1,405,256
자산총계	57,377,252	45,418,464	32,216,026
[유동부채]	10,002,009	8,116,133	4,160,849
[비유동부채]	3,886,417	3,481,412	4,031,647
부채총계	13,888,426	11,597,545	8,192,496
[지배기업 소유주지분]	43,484,017	33,815,280	24,016,955
· 자본금	3,657,652	3,657,652	3,657,652
· 자본잉여금	4,143,736	4,143,736	4,143,736
· 기타포괄손익누계액	-503,817	-502,264	-79,103
· 기타자본항목	-2,506,748	-771,100	-771,913
· 이익잉여금	38,693,194	27,287,256	17,066,583
[비지배지분]	4,809	5,639	6,575
자본총계	43,488,826	33,820,919	24,023,530
매출액	30,506,985	30,109,434	17,197,975
영업이익	16,413,675	13,721,326	3,276,746
연결총당기순이익	12,142,065	10,642,219	2,960,483
지배기업의 소유주지분	12,143,821	10,641,512	2,953,774
비지배지분	-1,756	707	6,709
기본주당순이익	17,272 원	15,073 원	4,184 원
연결에 포함된 회사수	25개사	24개사	23개사

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

- ※ 제71기 3분기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2018년 9월 30일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2018년 9월 30일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.
- ※ 제70기(전기) 및 제69기(전전기)는 종전 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정, 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'에 따라 작성되었습니다.
- ※ MMT 특정금전신탁은 연결에 포함된 회사수에서 제외하였습니다.

## 나. 요약 별도재무정보

(단위 :백만원)

구분	제71기 3분기	제70기	제69기
[유동자산]	15,205,373	15,338,930	7,933,301
· 현금및현금성자산	1,797,362	2,270,036	476,917
· 단기금융상품	297,500	4,528,880	1,917,500
· 단기투자자산	1,716,160	580,449	570,442
· 매출채권	7,738,621	5,259,052	2,896,443
· 재고자산	3,153,574	2,224,740	1,698,723
· 기타	502,156	475,773	373,276
[비유동자산]	41,142,431	28,973,916	23,465,792
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	6,504,980	4,778,280	4,588,062
· 장기투자자산	3,935,961	37,593	143,590
· 유형자산	27,718,946	21,322,943	16,071,281
· 무형자산	2,137,218	1,918,259	1,546,733
· 기타	845,326	916,841	1,116,126
자산총계	56,347,804	44,312,846	31,399,093
[유동부채]	10,159,274	8,076,214	4,351,661
[비유동부채]	3,867,812	3,464,757	3,955,919
부채총계	14,027,086	11,540,971	8,307,580
[자본금]	3,657,652	3,657,652	3,657,652
[자본잉여금]	4,183,564	4,183,564	4,183,564
[기타포괄손익누계액]	0	-10,735	-
[기타자본항목]	-2,506,748	-771,100	-771,913
[이익잉여금]	36,986,250	25,712,494	16,022,210
자본총계	42,320,718	32,771,875	23,091,513
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
매출액	30,335,667	29,718,939	16,733,111
영업이익	16,234,058	13,340,791	3,012,419
당기순이익	12,011,626	10,110,797	2,655,022
기본주당순이익	17,084 원	14,321 원	3,761 원

- ※ 한국채택국제회계기준에 따라 별도기준으로 작성되었습니다.
- ※ 제71기 3분기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2018년 9월 30일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은

분 은 2018년 9월 30일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

※ 제70기(전기) 및 제69기(전전기)는 종전 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정, 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성 제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'에 따라 작성되었습니다.

## 2. 연결재무제표

### 연결 재무상태표

제 71 기 3분기말 2018.09.30 현재

제 70 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 71 기 3분기말	제 70 기말
자산		
유동자산	17,700,533	17,310,444
현금및현금성자산	2,340,357	2,949,991
단기금융상품	388,229	4,674,862
단기투자자산	2,946,807	929,801
매출채권	7,711,347	5,552,795
기타수취채권	16,101	37,613
재고자산	3,686,740	2,640,439
당기법인세자산	1,663	1,305
기타유동자산	609,289	523,638
비유동자산	39,676,719	28,108,020
관계기업 및 공동기업투자	564,441	359,864
장기투자자산	4,005,499	43,226
기타수취채권	68,950	42,410
기타금융자산	173	273
유형자산	31,259,492	24,062,601
무형자산	2,469,187	2,247,290
투자부동산	1,416	2,468
이연법인세자산	637,326	599,783
종업원급여자산		13,385
기타비유동자산	670,235	736,720
자산총계	57,377,252	45,418,464
부채		
유동부채	10,002,009	8,116,133
매입채무	795,675	758,578
단기미지급금	3,204,547	2,724,547
기타지급채무	1,129,176	1,340,225

단기차입금 및 유동성 장기 차입금	1,316,854	773,780
총당부채	43,152	81,351
당기법인세부채	3,377,828	2,385,876
기타유동부채	134,777	51,776
비유동부채	3,886,417	3,481,412
기타지급채무	4,443	3,412
장기차입금	3,660,524	3,397,490
확정급여부채	147,453	6,096
이연법인세부채	2,229	5,554
기타비유동부채	71,768	68,860
부채총계	13,888,426	11,597,545
자본		
지배기업의 소유지분	43,484,017	33,815,280
자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금	4,143,736	4,143,736
기타자본	(2,506,748)	(771,100)
기타포괄손익누계액	(503,817)	(502,264)
이익잉여금	38,693,194	27,287,256
비지배지분	4,809	5,639
자본총계	43,488,826	33,820,919
자본과부채총계	57,377,252	45,418,464

### 연결 포괄손익계산서

제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 71 기 3분기		제 70 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	11,416,788	30,506,985	8,100,085	21,081,881
매출원가	3,871,624	11,017,081	3,398,157	9,241,783
매출총이익	7,545,164	19,489,904	4,701,928	11,840,098
판매비와관리비	1,072,744	3,076,229	964,735	2,584,606
영업이익	6,472,420	16,413,675	3,737,193	9,255,492
금융수익	172,835	1,176,190	252,745	750,110
금융비용	251,999	929,616	159,536	739,685
지분법투자 관련 손익	2,979	11,451	3,524	8,027

기타영업외수익	57,491	74,725	24,472	62,695
기타영업외비용	18,492	116,906	15,542	54,320
법인세비용차감전 순이익	6,435,234	16,629,519	3,842,856	9,282,319
법인세비용	1,743,041	4,487,454	787,327	1,859,600
당기순이익	4,692,193	12,142,065	3,055,529	7,422,719
법인세차감후 기타 포괄손익	(244,827)	(32,508)	84,920	(118,698)
후속적으로 당기 손익으로 재분류되 지 않는 포괄손익				
확정급여제도 의 재측정요소	(7,051)	(21,146)	(4,210)	(12,521)
당기손익으로 재 분류될 수 있는 항 목(세후기타포괄손 익)				
해외사업장환 산외환차이(세후기 타포괄손익)	(233,252)	(20,728)	86,708	(101,252)
지분법 적용대 상 관계기업과 공 동기업의 기타포괄 손익에 대한 지분 (세후기타포괄손익 )	(4,524)	9,366	2,422	(4,925)
총포괄이익	4,447,366	12,109,557	3,140,449	7,304,021
당기순이익의 귀속				
지배기업의 소유 주지분	4,693,620	12,143,821	3,054,248	7,420,763
비지배지분	(1,427)	(1,756)	1,281	1,956
총 포괄손익의 귀 속				
지배기업의 소유 주지분	4,448,533	12,110,387	3,139,284	7,302,781
비지배지분	(1,167)	(830)	1,165	1,240
주당이익				
기본주당순이익 (단위 : 원)	6,731	17,272	4,326	10,511
희석주당순이익 (단위 : 원)	6,730	17,270	4,326	10,511

**연결 자본변동표**

제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본							
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배자본	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계		
2017.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,143,736	(771,913)	(79,103)	17,066,583	24,016,955	6,575	24,023,530
당기손이익					7,420,763	7,420,763	1,956	7,422,719
확정급여제도의 재측정요소					(12,521)	(12,521)		(12,521)
기타포괄손익				(4,925)		(4,925)		(4,925)
환율변동				(100,536)		(100,536)	(716)	(101,252)
자기주식 거래로 인한 증감								
배당금지급					(423,601)	(423,601)		(423,601)
주식선택권 부여			548			548		548
2017.09.30 (기말자본)	3,657,652	4,143,736	(771,365)	(184,564)	24,051,224	30,896,683	7,815	30,904,498
2018.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,143,736	(771,100)	(491,529)	27,276,521	33,815,280	5,639	33,820,919
당기손이익					12,143,821	12,143,821	(1,756)	12,142,065
확정급여제도의 재측정요소					(21,146)	(21,146)		(21,146)
기타포괄손익				9,366		9,366		9,366
환율변동				(21,654)		(21,654)	926	(20,728)
자기주식 거래로 인한 증감			(1,736,514)			(1,736,514)		(1,736,514)
배당금지급					(706,002)	(706,002)		(706,002)
주식선택권 부여			866			866		866
2018.09.30 (기말자본)	3,657,652	4,143,736	(2,506,748)	(503,817)	38,693,194	43,484,017	4,809	43,488,826

**연결 현금흐름표**

제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 71 기 3분기	제 70 기 3분기
영업활동현금흐름	15,256,517	9,904,080

영업으로부터 창출된 현금흐름	18,252,184	10,572,132
이자의 수취	73,561	22,329
이자의 지급	(90,820)	(92,061)
배당금의 수취	15,099	14,841
법인세의 납부	(2,993,507)	(613,161)
투자활동현금흐름	(14,172,714)	(9,048,646)
단기금융상품의 순증감	4,286,955	(282,287)
단기투자자산의 순증감	(1,988,553)	(1,375,859)
기타수취채권의 감소	13,338	14,171
기타수취채권의 증가	(41,870)	(17,568)
장기투자자산의 처분	1,201	1,916
장기투자자산의 취득	(4,002,669)	(21,798)
기타금융자산의 감소	117	1
기타금융자산의 취득	(17)	(168)
파생상품거래로 인한 현금유입		902
파생상품거래로 인한 현금유출		(1,201)
유형자산의 처분	122,757	221,136
유형자산의 취득	(11,757,688)	(6,852,671)
무형자산의 처분	2,532	985
무형자산의 취득	(613,359)	(622,245)
정부보조금의 수취	1,422	
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(196,880)	(113,960)
재무활동현금흐름	(1,691,367)	(362,299)
차입금의 차입	2,407,194	752,944
차입금의 상환	(1,656,045)	(691,642)
자기주식의 취득	(1,736,514)	
배당금의 지급	(706,002)	(423,601)
현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,070)	16,198
현금및현금성자산의 순증감	(609,634)	509,333
기초 현금및현금성자산	2,949,991	613,786
기말 현금및현금성자산	2,340,357	1,123,119

### 3. 연결재무제표 주석

## 1. 회사의 개요

### (1) 지배기업의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "지배기업")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 지배기업은 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091에 본사와 경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있습니다. 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결실체")은 경기도 이천시와 충청북도 청주시, 중국 우시(Wuxi)와 충칭(Chongqing)에 생산공장을 설치·가동하고 있습니다.

2018년 9월 30일 현재 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)	지분율(%)
SK텔레콤주	146,100,000	20.07
국민연금공단 및 기타주주	537,901,795	73.89
자기주식	44,000,570	6.04
합 계	728,002,365	100.00

당분기말 현재 지배기업의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식예탁증서는 룩셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	소재지	주요영업활동	결산월	소유지분율(%)	
				당분기말	전기말
에스케이하이이엔지(주)	국 내	건설공사 및 서비스	12월	100	100
에스케이하이이텍(주)	국 내	사업지원 및 서비스	12월	100	100
(주)실리콘화일(*1)	국 내	전자·전기부품 개발 및 제조	12월	-	100
행복모아(주)	국 내	반도체 의류 제조 및 서비스	12월	100	100
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)(*1)	국 내	반도체 제조 및 판매	12월	100	100
SK hynix America Inc.	미 국	반도체 판매	12월	97.74	97.74
SK hynix Deutschland GmbH	독 일	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Asia Pte. Ltd.	싱가포르	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	홍 콩	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix U.K. Ltd.	영 국	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	대 만	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Japan Inc.	일 본	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	중 국	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(*2)	인 도	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	중 국	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(*3)	중 국	반도체 제조	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(*3)	중 국	반도체 제조	12월	-	100
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(*4)	중 국	반도체 제조	12월	100	100
SK hynix Italy S.r.l	이탈리아	반도체 연구개발	12월	100	100
SK hynix memory solutions America Inc.(*5)	미 국	반도체 연구개발	12월	100	100
SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.(*6)	대 만	반도체 연구개발	12월	100	100
SK hynix memory solutions Eastern Europe LLC.(*7)	벨라루스	반도체 연구개발	12월	100	100
SK APTECH Ltd.	홍 콩	해외투자법인	12월	100	100
SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.	홍 콩	해외투자법인	12월	100	100
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.(*8)	중 국	해외투자법인	12월	100	-
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.(*9)	중 국	해외병원자산법인	12월	100	-
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.(*9)	중 국	해외병원운영법인	12월	100	-
MMT(특정금전신탁)	국 내	특정금전신탁	12월	100	100

(\*1) 당분기 중 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 합병하였습니다.

(\*2) 종속기업인 SK hynix Asia Pte. Ltd.의 종속기업입니다.

(\*3) 당분기 중 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.가 SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.를 합병하였습니다.

(\*4) 종속기업인 SK APTECH Ltd.의 종속기업입니다.

(\*5) 당분기 중 회사명이 SK hynix memory solutions Inc.에서 SK hynix memory solutions America Inc.로 변경되었습니다.

(\*6) 당분기 중 회사명이 SK hynix Flash Solution Taiwan에서 SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.로 변경되었습니다.

(\*7) 당분기 중 회사명이 Softeq Flash Solutions LLC.에서 SK hynix memory solutions Eastern Europe LLC.로 변경되었습니다.

(\*8) 당분기 중 설립되었으며, 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.의 종속기업입니다.

(\*9) 당분기 중 설립되었으며, 종속기업인 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.의 종속기업입니다.

(3) 당분기 중 연결대상 종속기업의 변동내역은 다음과 같습니다.

구분	기업명	사유
종속기업 제외	(주)실리콘화일	합병으로 인한 소멸
종속기업 제외	SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.	합병으로 인한 소멸
종속기업 추가	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	신규설립
종속기업 추가	SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.	신규설립
종속기업 추가	SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.	신규설립

(4) 당분기말과 전기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
종속기업명	당분기말			전기말		
	총자산	총부채	총자본	총자산	총부채	총자본
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	545,658	97,237	448,421	360,254	77,958	282,296
SK hynix America Inc.	3,409,109	3,182,829	226,280	2,522,348	2,259,210	263,138
SK hynix Deutschland GmbH	135,703	95,838	39,865	108,470	70,430	38,040
SK hynix Asia Pte. Ltd.	974,354	893,907	80,447	636,286	559,400	76,886
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	674,986	506,089	168,897	1,043,889	918,305	125,584
SK hynix U.K. Ltd.	475,853	461,577	14,276	325,434	308,999	16,435
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	639,571	621,366	18,205	566,155	536,592	29,563
SK hynix Japan Inc.	748,726	688,057	60,669	632,590	569,810	62,780
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	1,391,995	1,311,885	80,110	414,850	379,888	34,962
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	567,095	542,271	24,824	13,347	12,677	670
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	4,713,530	455,972	4,257,558	4,043,100	322,545	3,720,555
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	500,813	94,630	406,183	388,033	195,849	192,184

(5) 당분기와 전분기 중 주요 종속기업의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
종속기업명	당분기			전분기		
	매출액	분기순손익	총포괄손익	매출액	분기순손익	총포괄손익
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	403,445	51,460	51,460	116,261	(16,301)	(16,301)
SK hynix America Inc.	10,610,821	(46,080)	(46,080)	7,616,352	69,963	69,963
SK hynix Deutschland GmbH	407,394	1,379	1,379	356,401	1,718	1,718
SK hynix Asia Pte. Ltd.	2,594,969	606	606	1,895,313	1,743	1,743
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	3,121,929	37,582	37,582	6,656,870	11,850	11,850
SK hynix U.K. Ltd.	1,065,889	(2,738)	(2,738)	779,432	(2,040)	(2,040)
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	2,370,401	(825)	(825)	1,930,326	(16,551)	(16,551)
SK hynix Japan Inc.	877,491	(4,291)	(4,291)	666,189	(307)	(307)
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	5,763,952	47,183	47,183	330,364	9,045	9,045
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	3,042,181	25,030	25,030	156	(108)	(108)
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	1,839,936	137,740	137,740	1,630,954	53,631	53,631
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	299,190	19,916	19,916	254,625	14,375	14,375

(6) 당분기말과 전기말 현재 연결실체에 대한 중요한 비지배지분은 없습니다.

## 2. 재무제표 작성기준

### (1) 회계기준의 적용

연결실체의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

연결실체의 분기연결재무제표에는 기업회계기준서 제1109호와 기업회계기준서 제 1115호가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석 3에서 설명하고 있습니다.

### (2) 추정과 판단

#### ① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1109호와 기업회계기준서 제1115호 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

#### ② 공정가치 측정

연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 금융위험관리 주석 등에 포함되어 있습니다.

### 3. 유의적인 회계정책

연결실체는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표에도 반영될 것입니다.

#### (1) 회계정책의 변경

연결실체는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'과 제1109호 '금융상품'을 최초 적용하였습니다. 2018년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준서들은 연결실체의 분기연결재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.

##### 1) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'

기업회계기준서 제1115호는 수익을 언제, 얼마나 인식할지를 결정하기 위한 포괄적인 체계입니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체하였습니다.

연결실체는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 실무적 간편법 적용 없이 소급 적용하여, 최초 적용 누적효과를 최초적용일(2018년 1월 1일)에 인식하였습니다. 개정기준서 도입으로 인하여 당사에 재무적 영향이 있는 항목은 다음과 같습니다.

##### ① 반품권이 있는 판매 회계처리

연결실체는 고객에게 반도체 제품을 공급하는 계약에 있어 품질하자 등에 따른 반품을 허용하기 때문에 고객으로부터 수령하는 대가가 변동될 수 있습니다. 기업회계기준서 제1115호 적용시 연결실체는 고객으로부터 수령할 대가를 보다 적절하게 예측할 것으로 예상하는 기대값 방법을 사용하여 변동대가를 추정하고, 반품기한이 경과할 때 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 변동대가를 거래가격에 포함하여 수익을 인식합니다. 한편, 연결실체가 수령하였거나 수령할 대가 중 권리를 갖게 될 것으로 예상하지 않는 금액은 환불부채(계약부채)로 인식합니다.

##### ② C조건 운송용역 회계처리

기업회계기준서 제1115호 적용시 고객과의 계약에서 제품판매와 제품운송의 수행의무가 식별되었으나 연결실체의 일반적인 거래형태인 도착지인도조건의 매출거래는 제품 운송이 완료된 후 제품의 통제가 이전되므로 두 개의 수행의무가 별도로 구별되지 않는 것으로 판단하였습니다. 하지만 고객이 운송료 또는 보험료를 부담하는 선적지인도조건(이하, "C조건")으로 체결된 수출거래의 경우에는 제품운송 수행의무가 제품에 대한 통제가 고객에게 이전된 이후에 수행되므로 이를 별도의 수행의무로 식별하였으며, C조건 운송용역 매출과 관련된 운송비용을 매출원가로 인식하였습니다.

- 최초 적용일(당기초) 현재 연결재무상태표에 반영한 전환 효과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)			
계정과목	2017.12.31 전환전	조정	2018. 1. 1 전환후
I. 유동자산			
기타유동자산	523,638	17,884	541,522

기타	16,786,806	-	16,786,806
유동자산 계	17,310,444	17,884	17,328,328
II. 비유동자산	28,108,020	-	28,108,020
자 산 총 계	45,418,464	17,884	45,436,348
I. 유동부채			
총당부채	81,351	(30,672)	50,679
기타유동부채	51,776	48,556	100,332
기타	7,983,006	-	7,983,006
유동부채 계	8,116,133	17,884	8,134,017
II. 비유동부채	3,481,412	-	3,481,412
부 채 총 계	11,597,545	17,884	11,615,429
자    본			
I. 지배기업의 소유지분	33,815,280	-	33,815,280
II. 비지배지분	5,639	-	5,639
자 본 총 계	33,820,919	-	33,820,919
부 채 및 자 본 총 계	45,418,464	17,884	45,436,348

2018년 9월 30일 기준 연결실체의 분기연결재무상태표와 동일자로 종료되는 분기연결포괄 손익계산서에서 기업회계기준서 제1115호 적용효과는 다음과 같습니다. 연결실체의 동일자로 종료되는 분기연결현금흐름표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.

당분기말 현재 분기연결재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)			
계정과목	공시금액	조정	제1115호 반영 전 금액
I. 유동자산			
기타유동자산	609,289	(20,509)	588,780
기타	17,091,244	-	17,091,244
유동자산 계	17,700,533	(20,509)	17,680,024
II. 비유동자산	39,676,719	-	39,676,719
자 산 총 계	57,377,252	(20,509)	57,356,743
I. 유동부채			
총당부채	43,152	58,155	101,307
기타유동부채	134,777	(78,664)	56,113
기타	9,824,080	-	9,824,080
유동부채 계	10,002,009	(20,509)	9,981,500
II. 비유동부채	3,886,417	-	3,886,417
부 채 총 계	13,888,426	(20,509)	13,867,917
자 본			
I. 지배기업의 소유지분	43,484,017	-	43,484,017
II. 비지배지분	4,809	-	4,809
자 본 총 계	43,488,826	-	43,488,826
부 채 및 자 본 총 계	57,377,252	(20,509)	57,356,743

당분기 중 분기연결포괄손익계산서에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)			
계정과목	공시금액	조정	제1115호 반영 전 금액
I. 매출액	30,506,985	-	30,506,985
II. 매출원가	11,017,081	(17,247)	10,999,834
III. 매출총이익	19,489,904	17,247	19,507,151
판매비와관리비	3,076,229	17,247	3,093,476
IV. 영업이익	16,413,675	-	16,413,675
금융수익	1,176,190	-	1,176,190
금융비용	929,616	-	929,616
지분법투자 관련 손익	11,451	-	11,451
기타영업외수익	74,725	-	74,725
기타영업외비용	116,906	-	116,906
V. 법인세비용차감전순이익	16,629,519	-	16,629,519
법인세비용	4,487,454	-	4,487,454
VI. 분기순이익	12,142,065	-	12,142,065
VII. 법인세차감후 기타포괄손익	(32,508)	-	(32,508)
VIII. 총포괄이익	12,109,557	-	12,109,557

2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'

기업회계기준서 제1109호는 금융자산, 금융부채 및 비금융항목을 매입하거나 매도할 수 있는 일부 계약의 인식과 측정을 규정합니다. 이 기준서는 기업회계기준서 제 1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체합니다. 연결실체는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 연결재무제표를 재작성하지 않았습니다.

금융상품의 분류와 측정으로 인해 변경된 기초 자본내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
조정내역	기타포괄손익누계액	이익잉여금
기업회계기준서 제1039호에 따른 기초 자본	(502,264)	27,287,256
매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류	10,735	(10,735)
기업회계기준서 제1109호에 따른 기초 자본	(491,529)	27,276,521

① 금융자산과 금융부채의 분류

기업회계기준서 제1109호는 금융부채의 분류와 측정에 대한 기업회계기준서 제 1039호의 기존 요건을 대부분 유지하였습니다. 그러나 만기보유금융자산, 대여금 및수취채권과 매도가능금융자산의 금융자산 기존 분류를 삭제하였습니다.

기업회계기준서 제1109호에 의하면, 최초 적용 시에 금융자산은 상각후원가측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품, 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품, 당기손익-공정가치 측정 범주로 분류됩니다. 기업회계기준서 제1109호에 따른 금융자산의 분류는 일반적으로 금융자산이 관리되는 방식인 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름의 특성에 근거하여 결정됩니다. 주계약이 이 기준서의 적용범위에 해당하는 금융자산인 계약에 내재된 파생상품은 분리되지 않습니다.

금융자산은 다음 두 가지 조건을 모두 충족하고, 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정되지 않은 경우 상각후원가로 측정됩니다.

- 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산이 보유된다.
- 계약 조건에 따라 특정일에 이자와 원금 잔액에 대한 이자 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생한다.

채무상품은 다음 두 가지 조건을 모두 충족하고 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정되지 않은 경우 기타포괄손익-공정가치로 측정됩니다.

- 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산이 보유된다.
- 계약 조건에 따라 특정일에 이자와 원금 잔액에 대한 이자 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생한다.

단기매매항목이 아닌 지분상품의 최초 인식일에 연결실체는 그 투자지분의 후속적인공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 수 있으며, 그러한 선택을 취소할 수 없습니다. 이러한 선택은 금융상품 별로 이루어집니다.

위에서 설명된 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치로 측정되지 않는 모든 금융상품은 모든 파생 금융자산을 포함하여 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 연결실체는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정되어야 하는 금융자산을 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄일 목적으로 해당 금융자산의 최초 인식시점에 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있습니다. 다만, 이러한 지정은 취소할 수 없습니다.

최초에 거래가격으로 측정되는 유의적인 금융요소가 없는 매출채권이 아닌 금융자산은 당기손익-공정가치 측정 항목이 아니라면 최초에 공정가치에 취득에 직접 관련되는 거래원가를 가산하여 측정합니다.

다음 회계정책은 금융자산의 후속측정에 적용합니다.

당기손익-공정가치 측정 금융자산	이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 이자와 배당수익을 포함한 순손익은 당기손익으로 인식합니다.
상각후원가 측정 금융자산	이러한 자산은 후속적으로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가는 손상손실에 의해 감소됩니다. 이자수익, 외화환산손익 및 손상은 당기손익으로 인식합니다. 제거에 따르는 손익도 당기손익으로 인식합니다.
기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품	이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 유효이자율법을 사용하여 계산된 이자수익, 외화환산손익과 손상은 당기손익으로 인식합니다. 다른 순손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 제거시에 기타포괄손익에 누적된손익은 당기손익으로 재분류합니다.
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 배당은 배당금이 명확하게 투자원가의 회수를 나타내지 않는다면 당기손익으로 인식합니다. 다른 순손익은 기타포괄손익으로 인식하고 절대로 당기손익으로 재분류되지 않습니다.

최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기업회계기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융자산 범주의 재분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)					
구 분	측정범주		장부금액		
	도입 전	도입 후	도입 전	도입 후	차이
현금및현금성자산	대여금및수취채권	상각후원가	2,949,991	2,949,991	-
단기금융상품	대여금및수취채권	상각후원가	4,674,862	4,674,862	-
단기투자자산	당기손익인식금융자산	당기손익-공정가치	929,801	929,801	-
매출채권	대여금및수취채권	상각후원가	5,552,795	5,552,795	-
기타수취채권	대여금및수취채권	상각후원가	80,023	80,023	-
기타금융자산	대여금및수취채권	상각후원가	273	273	-
장기투자자산(*)	매도가능금융자산	당기손익-공정가치	43,226	43,226	-
금융자산 합계			14,230,971	14,230,971	-

(\*) 당기초 현재 출자금 등을 포함한 43,226백만원은 매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류되었습니다. 동 금융자산은 계약상 현금흐름이 원리금 지급만을 나타내지 않아 상각후원가로 분류되는 조건을 충족하지 못합니다. 동 재분류로 인해 당기초 현재 관련 기타포괄손익누계액 (-)10,735백만원은 이익잉여금으로 재분류되었습니다. 당분기 중 동 금융자산과 관련한 공정가치 변동은 없습니다.

## ② 금융자산의 손상

기업회계기준서 제1109호는 기업회계기준서 제1039호의 '발생손실'모형을 '기대신용손실'모형으로 대체하였습니다. 새로운 손상모형은 상각후원가로 측정되는 금융자산, 계약자산 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품에 적용되지만, 지분상품 투자에는 적용되지 않습니다. 기업회계기준서 제1109호에서 신용손실은 기업회계기준서 제1039호보다 일찍 인식됩니다.

기대신용손실은 신용손실의 확률가중추정치입니다. 신용손실은 모든 현금부족액(즉, 계약에 따라 지급받기로 한 모든 계약상 현금흐름과 수취할 것으로 예상하는 모든 계약상 현금흐름의 차이)의 현재가치로 측정됩니다.

매 보고기간말에, 연결실체는 상각후원가로 측정되는 금융자산과 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무증권의 신용이 손상되었는지 평가합니다. 금융자산의 추정미래현금흐름에 악 영향을 미치는 하나 이상의 사건이 발생한 경우에 해당 금융자산은 신용이 손상된 것입니다.

상각후원가로 측정하는 금융자산에 대한 손실충당금은 해당 자산의 장부금액에서 차감합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대해서는 해당 자산의 장부금액을 감소시키는 대신에 손실충당금을 기타포괄손익에 인식합니다. 당기초 현재기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 없습니다.

기업회계기준서 제1109호의 금융자산 손상 요구사항의 적용에 따라 발생하는 회계정책 변경의 효과는 없습니다.

### ③ 위험회피회계

연결실체는 기업회계기준서 제1109호를 최초 적용하면서 동 기준서의 위험회피회계요구사항을 적용하기로 결정하였습니다. 당기초 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품은 없으며, 따라서 기업회계기준서 제1109호의 위험회피회계 요구사항의 적용에 따라 발생하는 회계정책 변경의 효과는 없습니다.

### (2) 미적용 제·개정 기준서

제정·공표되었으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 제·개정 기준서는 다음과 같습니다. 연결실체는 분기연결재무제표 작성시 다음의 제·개정 기준서를 조기적용하지 아니하였습니다.

#### - 기업회계기준서 제1116호 '리스'

연결실체는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다. 2018년 중 기업회계기준서 제1116호의 도입에 따른 재무영향을 분석하여 그 결과를 2018년 연차연결재무제표 주석에 공시할 예정입니다. 전기 연차 연결재무제표에서 설명한 일반적인 영향분석 이외의 당분기말 현재 동 기준서의 도입 준비와 관련한 중요한 변동사항은 없습니다.

4. 영업부문

연결실체는 반도체 제품의 제조 및 판매의 단일영업부문으로 구성되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업전략을 수립하는 과정에서 검토되는 보고정보에 반도체사업부문의 성과를 검토하고 있습니다.

(1) 당분기와 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
제품의 판매	11,404,467	30,468,084	8,077,799	21,028,014
용역의 제공	12,321	38,901	22,286	53,867
합 계	11,416,788	30,506,985	8,100,085	21,081,881

(2) 당분기와 전분기 중 매출액의 품목별 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
DRAM	9,201,152	24,402,869	6,262,013	15,996,044
NAND Flash	2,045,502	5,609,054	1,683,190	4,678,746
기 타	170,134	495,062	154,882	407,091
합 계	11,416,788	30,506,985	8,100,085	21,081,881

(3) 당분기와 전분기 중 지역별(법인소재지 기준) 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
국 내	191,014	717,143	272,769	907,950
중 국	4,532,705	11,904,846	2,559,772	6,977,013
대 만	785,736	2,369,867	662,243	1,928,781
아시아(중국, 대만제외)	1,244,343	3,471,220	1,021,771	2,558,695
미 국	4,102,850	10,608,979	3,161,812	7,575,610
유 럽	560,140	1,434,930	421,718	1,133,832
합 계	11,416,788	30,506,985	8,100,085	21,081,881

(4) 당분기말과 전기말 현재 지역별 비유동자산(금융상품, 기타수취채권, 관계기업 및 공동기업투자, 이연법인세자산 제외)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
국 내	30,481,039	23,959,991
중 국	3,574,974	2,768,494
대 만	6,155	5,752
아시아(중국, 대만제외)	967	1,100
미 국	327,550	318,567
유 럽	9,645	8,560
합 계	34,400,330	27,062,464

(5) 당분기와 전분기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 연결실체 전체 매출액의 10%를 상회하는 고객 (가), (나) 및 (다)로부터 발생한 매출액은 각각 3,917,063백만원(전분기: 2,580,498백만원), 3,762,588백만원(전분기: 1,787,100백만원) 및 2,148,500백만원(전분기: 2,707,017백만원)입니다.

5. 금융상품의 범주별 분류

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산	합 계
현금및현금성자산	-	2,340,357	2,340,357
단기금융상품	-	388,229	388,229
단기투자자산	2,946,807	-	2,946,807
매출채권	-	7,711,347	7,711,347
기타수취채권	-	85,051	85,051
기타금융자산	-	173	173
장기투자자산	4,005,499	-	4,005,499
합 계	6,952,306	10,525,157	17,477,463

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	당기손익인식 금융자산	매도가능 금융자산	대여금및 수취채권	합 계
현금및현금성자산	-	-	2,949,991	2,949,991
단기금융상품(*)	-	-	4,674,862	4,674,862
단기투자자산(*)	929,801	-	-	929,801
매출채권	-	-	5,552,795	5,552,795
기타수취채권	-	-	80,023	80,023
기타금융자산	-	-	273	273
장기투자자산(*)	-	43,226	-	43,226
합 계	929,801	43,226	13,257,944	14,230,971

(\*) 전기말의 단기금융상품 및 매도가능금융자산은 당분기의 분류에 따라 재분류되었습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)	
구 분	상각후원가로 측정하는 금융부채
매입채무	795,675
미지급금	3,204,547
기타지급채무(*)	1,133,619
차입금	4,977,378
합 계	10,111,219

② 전기말

(단위: 백만원)	
구 분	상각후원가로 측정하는 금융부채
매입채무	758,578
미지급금	2,724,547
기타지급채무(*)	1,343,637
차입금	4,171,270
합 계	8,998,032

(\*) 당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미지급비용	1,129,176	1,340,225
비유동:		
임대보증금	4,126	3,412
장기미지급비용	317	-
소 계	4,443	3,412
합 계	1,133,619	1,343,637

## 6. 금융위험관리

### (1) 금융위험관리

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2017년 12월 31일의 연차연결재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결실체의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

#### ① 시장위험

##### (가) 환율변동위험

연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	12,108	13,472,705	5,565	6,192,143
EUR	20	25,255	315	408,025
JPY	25,406	249,274	181,928	1,785,027

당분기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동을 가정한 화폐성 외화자산 및 외화부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	728,056	(728,056)
EUR	(38,277)	38,277
JPY	(153,575)	153,575

(나) 이자율위험

연결실체의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결실체는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 3개월간 연결실체의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이익은 각각 5,939백만원 만큼 증가 또는 감소할 것입니다.

(다) 가격위험

연결실체는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

② 신용위험

신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

### (가) 매출채권 및 기타수취채권

연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리 업무를 수행하고 있습니다. 연결실체는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 연결실체의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.

### (나) 기타의 자산

현금및현금성자산, 단기금융상품, 단기투자자산 및 장·단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

### ③ 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 연결실체가 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

연결실체는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

## (2) 자본관리

연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
부 채 (A)	13,888,426	11,597,545
자 본 (B)	43,488,826	33,820,919
현금및현금성자산 등 (C)(*1)	5,675,393	8,554,654
차입금 (D)	4,977,378	4,171,270
부채비율 (A/B)	31.94%	34.29%
순차입금비율 (D-C)/B(*2)	-	-

(\*1) 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.

(\*2) 당분기말 및 전기말의 순차입금비율은 부(-)의 비율로 산출되어 표시하지 않았습니다.

## (3) 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	2,946,807	-	2,946,807	-	2,946,807
장기투자자산	4,005,499	-	-	4,005,499	4,005,499
소 계	6,952,306	-	2,946,807	4,005,499	6,952,306
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*)	2,340,357	-	-	-	-
단기금융상품(*)	388,229	-	-	-	-
매출채권(*)	7,711,347	-	-	-	-
기타수취채권(*)	85,051	-	-	-	-
기타금융자산(*)	173	-	-	-	-
소 계	10,525,157	-	-	-	-
금융자산 합계	17,477,463	-	2,946,807	4,005,499	6,952,306
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*)	795,675	-	-	-	-
미지급금(*)	3,204,547	-	-	-	-
기타지급채무(*)	1,133,619	-	-	-	-
차입금	4,977,378	-	4,979,915	-	4,979,915
금융부채 합계	10,111,219	-	4,979,915	-	4,979,915

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	929,801	-	929,801	-	929,801
장기투자자산	43,226	-	-	43,226	43,226
소 계	973,027	-	929,801	43,226	973,027
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*)	2,949,991	-	-	-	-
단기금융상품(*)	4,674,862	-	-	-	-
매출채권(*)	5,552,795	-	-	-	-
기타수취채권(*)	80,023	-	-	-	-
기타금융자산(*)	273	-	-	-	-
소 계	13,257,944	-	-	-	-
금융자산 합계	14,230,971	-	929,801	43,226	973,027
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*)	758,578	-	-	-	-
미지급금(*)	2,724,547	-	-	-	-
기타지급채무(*)	1,343,637	-	-	-	-
차입금	4,171,270	-	4,178,598	-	4,178,598
금융부채 합계	8,998,032	-	4,178,598	-	4,178,598

(\*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

③ 가치평가기법

수준 2 및 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3 간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)					
구 분	기 초(*)	취 득	처 분	환율변동	당분기말
장기투자자산	43,226	4,002,669	(953)	(39,443)	4,005,499

(\*) 전기말 동일한 상품(즉, 수준 1의 투입변수)에 대한 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 지분상품에 해당하여 다른 방법으로 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로, 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 원가로 측정 한 매도가능금융자산 29,700백만원이 포함되어 있습니다.

7. 사용제한 금융상품

당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
단기금융상품:		
중소기업지원관련 사용제한(상생펀드)	227,500	227,500
소비세 이연납부에 대한 예치금	5,887	5,695
기타	-	1,287
소 계	233,387	234,482
기타금융자산:		
당좌개설보증금	11	11
기타	162	262
소 계	173	273
합 계	233,560	234,755

8. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미수금	7,576	10,816
미수수익	2,758	22,308
단기대여금	4,538	2,886
단기보증금	1,229	1,603
소 계	16,101	37,613
비유동:		
장기미수금	52	56
장기대여금	25,589	11,098
보증금	43,090	31,109
기타	219	147
소 계	68,950	42,410
합 계	85,051	80,023

(2) 대손충당금의 내역

당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액
매출채권	7,711,394	(47)	7,711,347	5,552,841	(46)	5,552,795
유동성 기타수취채권	17,424	(1,323)	16,101	38,940	(1,327)	37,613
비유동성 기타수취채권	69,052	(102)	68,950	43,497	(1,087)	42,410
합 계	7,797,870	(1,472)	7,796,398	5,635,278	(2,460)	5,632,818

(3) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	환율변동	당분기말
매출채권	46	-	-	-	1	47
유동성 기타수취채권	1,327	-	(3)	-	(1)	1,323
비유동성 기타수취채권	1,087	-	-	(985)	-	102
합 계	2,460	-	(3)	(985)	-	1,472

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	대손상각비	환 입	환율변동	기 말
매출채권	1,837	240	(238)	18	1,857
유동성 기타수취채권	1,371	-	(14)	44	1,401
비유동성 기타수취채권	1,476	53	(3)	(98)	1,428
계	4,684	293	(255)	(36)	4,686

9. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실총당금	장부금액	취득원가	평가손실총당금	장부금액
제 품	980,231	(103,443)	876,788	544,978	(111,573)	433,405
재공품	1,996,716	(28,050)	1,968,666	1,653,778	(36,889)	1,616,889
원재료	409,889	(11,033)	398,856	322,283	(26,031)	296,252
저장품	418,231	(16,629)	401,602	278,422	(7,618)	270,804
미착품	40,828	-	40,828	23,089	-	23,089
합 계	3,845,895	(159,155)	3,686,740	2,822,550	(182,111)	2,640,439

10. 기타유동자산 및 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선급금	85,631	34,887
선급비용	274,337	222,411
부가세대급금	228,269	263,287
계약자산	20,796	-
기타	256	3,053
소 계	609,289	523,638
비유동:		
장기선급금	118,299	183,489
장기선급비용	551,936	553,231
소 계	670,235	736,720
합 계	1,279,524	1,260,358

11. 관계기업 및 공동기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)								
구 분	회사명	소재지	주요 영업활동	당분기말			전기말	
				지분율(%)	순자산 지분금액	장부금액	지분율(%)	장부금액
관계기업	Stratio, Inc.(*1)	미 국	반도체 부품 개발 및 제조	9.12	87	2,087	9.12	2,105
	SK China Company Limited(*1)	중 국	컨설팅 및 투자	11.87	202,229	254,579	11.87	244,912
	Gemini Partners Pte. Ltd.	싱가포르	컨설팅	20.00	2,234	3,929	20.00	4,003
	TCL Fund(*1)	홍 콩	투자	11.06	3,422	3,421	11.06	2,634
	SK South East Asia Investment Pte. Ltd.(*2)	싱가포르	컨설팅 및 투자	20.00	111,270	111,270	-	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	중 국	반도체 부품 제조	45.00	106,394	106,394	45.00	106,210
	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(*3)	중 국	파운드리 공장 건설	50.10	81,934	82,761	-	-
합 계						564,441		359,864

(\*1) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(\*2) 당분기 중 SK South East Asia Investment Pte. Ltd.의 지분 20.00%를 취득하였으며, 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(\*3) 당분기 중 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)에서 Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.의 지분 50.10%를 취득하였으며, 공동지배력을 행사할 수 있으므로 공동기업으로 분류하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	취 득	지분법손익	지분법 자본변동	배 당	당분기말
Stratio, Inc.	2,105	-	(22)	4	-	2,087
SK China Company Limited	244,912	-	2,249	7,418	-	254,579
Gemini Partners Pte. Ltd.	4,003	-	(110)	36	-	3,929
TCL Fund	2,634	720	124	(57)	-	3,421
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	-	110,880	-	390	-	111,270
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	106,210	-	9,506	3,798	(13,120)	106,394
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	-	85,280	(296)	(2,223)	-	82,761
합 계	359,864	196,880	11,451	9,366	(13,120)	564,441

② 전분기

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	취 득	지분법손익	지분법 자본변동	배 당	전분기말
Stratio, Inc.	2,151	-	(23)	(8)	-	2,120
SK China Company Limited	-	257,169	-	1,607	-	258,776
Gemini Partners Pte. Ltd.	5,199	-	(552)	31	-	4,678
TCL Fund	2,219	-	9	(12)	-	2,216
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	121,447	-	8,593	(6,543)	(14,828)	108,669
합 계	131,016	257,169	8,027	(4,925)	(14,828)	376,459

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
Stratio, Inc.	516	580	146	-
SK China Company Limited	792,885	1,058,845	64,391	83,082
Gemini Partners Pte. Ltd.	5,095	6,092	17	-
TCL Fund	6,588	27,181	2,833	-
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	556,350	-	-	-
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	216,718	372,781	122,952	230,114
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	146,661	16,983	102	-

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
Stratio, Inc.	681	577	111	-
SK China Company Limited	812,882	934,872	54,752	70,213
Gemini Partners Pte. Ltd.	6,227	5,314	2	-
TCL Fund	7,863	15,957	-	-
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	192,905	334,678	79,725	211,835

(4) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	매출액	분기순손익	매출액	분기순손익
Stratio, Inc.	70	(236)	30	(245)
SK China Company Limited	48,851	18,955	-	-
Gemini Partners Pte. Ltd.	-	(550)	-	(1,486)
TCL Fund	-	1,118	-	(58)
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	-	-	-	-
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	464,475	21,125	443,803	20,735
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	-	(591)	-	-

## 12. 장기투자자산

당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	43,226	147,779
취득(*)	4,002,669	21,798
처분	(953)	(114,180)
환율변동	(39,443)	(19)
기말장부금액	4,005,499	55,378

(\*) 연결실체는 전기 중 도시바 반도체 사업의 지분투자와 관련하여 Bain Capital이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 당분기말 현재 특수목적법인인 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP에 대한 JPY 266,000백만의 출자 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited가 발행한 전환사채 JPY 129,000백만의 취득을 완료하였습니다.

### 13. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	24,062,601	18,777,402
취득	11,691,193	6,821,718
처분 및 폐기	(150,196)	(198,041)
감가상각	(4,285,162)	(3,408,687)
대체(*)	984	-
환율변동	(59,928)	(15,234)
기말장부금액	31,259,492	21,977,158

(\*) 당분기 중 투자부동산에서 유형자산으로 대체되었습니다.

(2) 당분기말 현재 연결실체의 일부 토지와 건물 등은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.(주석 31 참조)

(3) 금융리스와 운용리스 이용내역

당분기말 현재 연결실체는 HANSU TECHNICAL SERVICE LTD. 등으로부터 기계장치를 금융리스계약을 통하여 사용하고 있습니다.

당분기말 현재 금융리스 계약에 따른 기계장치 등의 장부금액은 74,592백만원 (전기말 : 79,161백만원)입니다. 동 기계장치 등은 금융리스부채와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.

당분기말 현재 연결실체는 Macquarie Capital 등으로부터 기계장치를 운용리스계약에 의하여 사용하고 있으며, 기간별 리스료의 지급계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)	
구 분	리스료지급액
1년 이내	170,949
1년 초과	179,935
합 계	350,884

14. 무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	2,247,290	1,915,591
취득	611,962	622,245
처분 및 폐기	(6,946)	(4,911)
상각	(389,993)	(279,087)
손상차손	(3,463)	(47)
환율변동	10,337	(16,847)
기말장부금액	2,469,187	2,236,944

(2) 당분기 중 개발활동과 관련하여 발생한 비용 중 개발비 인식요건을 충족하는 422,270백만원(전분기: 411,424백만원)은 개발비로 자산화하였으며 연구활동과 관련하여 발생한 비용과 개발비 인식요건을 충족하지 못하는 개발활동 관련비용 1,589,573백만원(전분기: 1,389,797백만원)은 경상개발비로 비용인식하였습니다.

15. 투자부동산

(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	2,468	2,573
감가상각	(68)	(79)
대체(*)	(984)	-
기말장부금액	1,416	2,494

(\*) 당분기 중 투자부동산에서 유형자산으로 대체되었습니다.

(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의 감가상각비 68백만원(전분기: 79백만원)은 전액 매출원가에 포함되어 있습니다.

(3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 248백만원(전분기: 372백만원)입니다.

16. 차입금

당분기말과 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
단기차입금	265,799	192,686
유동성장기차입금	531,327	361,258
유동성사채	519,728	219,836
소 계	1,316,854	773,780
비유동:		
장기차입금	2,154,754	2,080,333
사 채	1,505,770	1,317,157
소 계	3,660,524	3,397,490
합 계	4,977,378	4,171,270

17. 기타유동부채 및 기타비유동부채

당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선수금	9,016	3,040
선수수익	47	81
예수금	41,176	39,862
보증예수금	874	989
계약부채	80,176	-
기타	3,488	7,804
소 계	134,777	51,776
비유동:		
기타장기종업원급여부채	66,868	63,960
장기선수금	4,900	4,900
소 계	71,768	68,860
합 계	206,545	120,636

18. 충당부채

(1) 당분기와 전분기 중 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사용/대체	환 입	기 말
판매보증충당부채	3,807	10,508	(9,009)	-	5,306
반품충당부채(*)	-	-	-	-	-
소송충당부채	9,460	5,119	(9,460)	-	5,119
배출부채	37,412	-	-	(4,685)	32,727
합 계	50,679	15,627	(18,469)	(4,685)	43,152

(\*) 반품충당부채를 기업회계기준서 제1115호의 적용으로 인하여 고객의 반품권 행사로 장래에 지출될 것이 예상되는 금액과, 연결실체가 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 각각 기타유동부채(계약부채)와 기타유동자산(계약자산)으로 구분하여 표시하였습니다.

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사용/대체	환 입	기 말
판매보증충당부채	2,997	1,803	(809)	-	3,991
반품충당부채	13,317	88,543	(73,382)	-	28,478
소송충당부채	400	4,391	-	(400)	4,391
배출부채	26,108	4,349	(695)	-	29,762
합 계	42,822	99,086	(74,886)	(400)	66,622

(2) 판매보증충당부채

연결실체는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채를 인식하고 있습니다.

(3) 반품충당부채

연결실체는 전기 중 판매 후 반품이 예상되는 매출액을 합리적으로 추정하여 매출액과 매출 원가에서 각각 차감하고 매출총이익에 해당하는 금액과 반품과 관련하여 발생할 것으로 예상되는 비용의 합계액을 충당부채로 인식하였습니다.

(4) 소송충당부채

연결실체는 소송 혹은 분쟁 등과 관련하여 경제적 효익이 내재된 자원이 유출될 가능성이 높고 그 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 그 금액을 충당부채로 인식하고 있습니다.

(5) 배출부채

연결실체는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

19. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	1,478,151	1,330,559
사외적립자산의 공정가치	(1,330,698)	(1,337,848)
순확정급여부채	147,453	(7,289)
확정급여부채	147,453	6,096
확정급여자산(*)	-	(13,385)

(\*) 전기말 현재 지배기업의 확정급여제도의 초과적립액 13,385백만원을 종업원급여자산으로 표시하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적 평가를 위해 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말(%)	전기말(%)
할인율	3.81 ~ 4.35	3.81 ~ 4.35
미래임금상승률	2.20 ~ 5.46	2.20 ~ 5.46

(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,330,559	1,195,047
당기근무원가	127,355	114,084
이자원가	42,348	35,191
관계사전출입액	1,277	331
퇴직급여지급액	(23,408)	(25,337)
기 타	20	14
기말장부금액	1,478,151	1,319,330

(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,337,848	888,559
이자수익	42,559	26,192
기여금납입액	91	-
관계사전출입액	1,328	334
퇴직급여지급액	(29,982)	(24,848)
재측정요소	(21,146)	(12,521)
기말금액	1,330,698	877,716

(5) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용(수익)은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
당기근무원가	42,440	127,355	38,453	114,084
순이자원가(수익)	(70)	(211)	2,958	8,999
합 계	42,370	127,144	41,411	123,083

(6) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
예적금	1,329,318	1,336,484
기 타	1,380	1,364
합 계	1,330,698	1,337,848

한편, 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 실제수익은 각각 21,412백만원과 13,671백만원입니다.

(7) 당분기 중 확정기여형 퇴직연금제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 129백만원(전분기: 48백만원)입니다.

## 20. 파생상품거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 파생상품은 없습니다.

(2) 당분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한 평가손익 및 거래손익은 없으며, 전분기 중 인식한 평가손익 및 거래손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)								
구 분	평가이익		평가손실		거래이익		거래손실	
	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적
이자율스왑	(188)	-	-	-	492	902	304	913

21. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본

(1) 당분기말 현재 지배기업의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)		
구 분	당분기말	전기말
보통주 발행주식수(*)	731,530	731,530
보통주자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금:		
주식발행초과금	3,625,797	3,625,797
기 타	517,939	517,939
합 계	4,143,736	4,143,736
기타자본:		
자기주식	(2,508,427)	(771,913)
주식선택권	1,679	813
합 계	(2,506,748)	(771,100)
자기주식수	44,001	22,001

(\*) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와 발행주식 총수에 차이가 있습니다.

(2) 당분기말 현재 자기주식의 취득으로 인하여 지배기업의 유통주식수는 684,002천주로 감소하였습니다.

22. 기타포괄손익누계액

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
(부의)지분법자본변동	(11,076)	(20,442)
매도가능금융자산평가손익(*)	-	(10,735)
해외사업장외화환산차이	(492,741)	(471,087)
합 계	(503,817)	(502,264)

(\*) 기업회계기준서 제1109호의 적용으로 인하여 매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류 됨에 따라, 당기 초 현재 관련 기타포괄손익누계액 (-)10,735백만원은 이익잉여금으로 재분류되었습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)				
구 분	기 초	증 감	유의적인 회계정책 변경효과	기 말
(부의)지분법자본변동	(20,442)	9,366	-	(11,076)
장기투자자산평가손익	(10,735)	-	10,735	-
해외사업장환산외환차이	(471,087)	(21,654)	-	(492,741)
합 계	(502,264)	(12,288)	10,735	(503,817)

② 전분기

(단위: 백만원)			
구 분	기 초	증 감	기 말
(부의)지분법자본변동	5,944	(4,925)	1,019
해외사업장환산외환차이	(85,047)	(100,536)	(185,583)
합 계	(79,103)	(105,461)	(184,564)

### 23. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
법정적립금(*1)	178,955	108,354
임의적립금(*2)	235,506	235,506
미처분이익잉여금(*3)	38,278,733	26,943,396
합 계	38,693,194	27,287,256

(\*1) 지배기업은 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.

(\*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.

(\*3) 2018년 3월 28일자 주주총회에서 배당금 706,002백만원이 결의되었으며, 당분기 중 전액 지급하였습니다.

24. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
급여	126,936	383,647	124,651	345,671
퇴직급여	7,793	23,304	6,669	19,956
복리후생비	27,227	79,920	21,311	62,195
지급수수료	85,464	264,381	56,878	170,160
감가상각비	32,808	90,695	24,174	70,119
무형자산상각비	110,027	330,949	104,897	237,846
운반보관비	9,106	21,682	9,780	28,111
송무비	6,615	17,039	8,638	25,380
임차료	3,341	9,948	3,186	10,398
세금과공과	9,901	19,554	4,518	11,946
교육훈련비	7,964	21,335	7,103	17,364
광고선전비	21,347	50,845	15,178	36,557
소모품비	26,179	57,495	18,097	50,133
수선비	5,511	18,546	13,796	20,412
여비교통비	4,147	11,138	3,063	8,262
판매촉진비	17,981	51,442	11,887	41,710
기 타	12,184	34,736	8,089	38,589
소 계	514,531	1,486,656	441,915	1,194,809
경상개발비:				
연구개발비 총지출액	718,589	2,011,843	638,639	1,801,221
개발비 자산화	(160,376)	(422,270)	(115,819)	(411,424)
소 계	558,213	1,589,573	522,820	1,389,797
합 계	1,072,744	3,076,229	964,735	2,584,606

25. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
제품 및 재공품의 변동	(235,018)	(795,160)	(37,666)	(412,332)
원재료, 저장품 및 소모품 사용	1,419,455	3,978,281	1,028,672	2,987,097
종업원급여	797,316	2,421,656	802,729	2,250,107
유형자산, 투자부동산, 무형자산 상각비	1,612,895	4,574,972	1,281,172	3,598,274
기술료	41,946	134,980	55,946	163,691
지급수수료	397,477	1,179,141	333,726	889,567
동력 및 수도광열비	294,785	816,506	251,763	696,641
수선비	219,403	675,632	254,047	665,520
외주가공비	286,975	787,430	228,046	662,541
기 타	109,134	319,872	164,457	325,283
합 계(*)	4,944,368	14,093,310	4,362,892	11,826,389

(\*) 분기연결포괄손익계산서상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

26. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
금융수익:				
이자수익	10,598	53,791	14,632	33,983
배당금수익	-	1,979	-	13
외환차이(*1)	145,913	1,091,720	202,297	672,703
파생상품관련이익	-	-	304	902
단기투자자산평가이익(*3)	4,750	9,578	1,201	2,937
단기투자자산처분이익(*3)	11,574	18,874	3,366	8,627
장기투자자산처분이익(*3)	-	248	30,945	30,945
소 계	172,835	1,176,190	252,745	750,110
금융비용:				
이자비용	23,404	65,781	32,304	96,330
외환차이(*2)	228,595	863,835	126,927	642,441
파생상품관련손실	-	-	304	913
장기투자자산처분손실(*3)	-	-	1	1
소 계	251,999	929,616	159,536	739,685
순금융수익(비용)	(79,164)	246,574	93,209	10,425

(\*1) 당분기 중 발생한 장기투자자산의 환율변동효과 1,272백만원이 포함되어 있습니다.

(\*2) 당분기 중 발생한 장기투자자산의 환율변동효과 40,715백만원이 포함되어 있습니다.

(\*3) 전분기의 장·단기투자자산 관련손익은 당분기의 분류에 따라 재분류 되었습니다.

27. 기타영업외수익과 기타영업외비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
유형자산처분이익	17,231	30,475	19,890	29,379
기 타	40,260	44,250	4,582	33,316
합 계	57,491	74,725	24,472	62,695

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
유형자산처분손실	4,242	57,759	954	6,284
무형자산처분손실	1,834	4,414	730	3,926
매출채권처분손실	2,873	6,522	1,776	5,401
기부금	7,035	35,028	3,843	25,179
무형자산손상차손	-	3,463	47	47
기 타	2,508	9,720	8,192	13,483
합 계	18,492	116,906	15,542	54,320

28. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

29. 주당이익

주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 지배기업 소유주지분순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익

(단위: 주, 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
지배기업소유주지분 분기순이익	4,693,620	12,143,821	3,054,248	7,420,763
가중평균유통보통주식수(*)	697,358,807	703,089,140	706,001,795	706,001,795
기본주당이익	6,731 원	17,272 원	4,326 원	10,511 원

(\*) 주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
발행주식수	728,002,365	728,002,365	728,002,365	728,002,365
자기주식 효과	(30,643,558)	(24,913,225)	(22,000,570)	(22,000,570)
가중평균유통보통주식수	697,358,807	703,089,140	706,001,795	706,001,795

(2) 희석주당이익

(단위: 백만원, 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
보통주희석분기순이익	4,693,620	12,143,821	3,054,248	7,420,763
가중평균희석유통보통주식수(*)	697,448,623	703,181,187	706,046,520	706,010,823
희석주당이익	6,730 원	17,270 원	4,326 원	10,511 원

(\*) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
가중평균유통보통주식수	697,358,807	703,089,140	706,001,795	706,001,795
주식선택권 효과	89,816	92,047	44,725	9,028
가중평균희석유통보통주식수	697,448,623	703,181,187	706,046,520	706,010,823

30. 특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와의 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
관계기업	Stratio. Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund, SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
기타특수관계자	연결실체에 유의적인 영향력을 행사하는 SK텔레콤(주) 및 그 종속기업과 SK텔레콤(주)의 지배기업인 SK(주)와 그 종속기업

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)									
구 분	회사명	영업수익 등		영업비용 등		자산취득		배당금수익	
		3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	2,632	3,318	163,908	464,832	1,901	1,901	-	13,120
	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	108	108	-	-	-	-	-	-
기타특수관계자	SK텔레콤(주)(*1)	14	220	3,414	158,326	3,249	6,772	-	-
	SK(주)(*2)	510	1,102	53,246	166,857	50,915	170,888	-	-
	ESSENCORE Limited	217,783	712,307	-	-	-	-	-	-
	SK건설(주)	804	3,806	135	427	738,938	1,770,175	-	-
	SK에너지(주)	781	3,417	11,604	49,352	-	-	-	-
	SK네트웍스(주)	-	-	1,646	4,016	-	10,600	-	-
	에스케이씨솔믹스(주)	-	-	4,376	14,060	384	847	-	-
	충청에너지서비스(주)	-	-	2,541	11,719	-	203	-	-
	행복나래(주)	9	29	134,720	384,833	18,074	42,786	-	-
	SK머티리얼즈(주)	-	-	17,686	49,326	-	-	-	-
	SK실트론(주)	1,224	3,333	94,976	243,260	-	-	-	-
기타	86	249	97,140	228,573	8,123	24,188	-	-	
합 계		223,951	727,889	585,392	1,775,581	821,584	2,028,360	-	13,120

(\*1) 영업비용 등에는 배당금 146,100백만원이 포함되어 있습니다.

(\*2) 당분기 중 발생한 SK브랜드 사용료는 46,466백만원입니다.

② 전분기

(단위: 백만원)									
구 분	회사명	영업수익 등		영업비용 등		자산취득		배당금수익	
		3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	289	5,755	153,585	442,061	-	-	-	14,828
기타특수관계자	SK텔레콤(*1)	11	224	2,053	93,875	16,740	22,286	-	-
	SK(*2)	278	730	44,501	124,697	21,825	100,347	-	-
	ESSENCORE Limited	189,653	537,469	-	-	-	-	-	-
	SK건설(주)	6,870	15,559	125	351	307,022	641,325	-	-
	SK에너지(주)	1,236	3,723	8,813	42,132	-	-	-	-
	SK네트웍스(주)	-	-	1,102	3,090	-	-	-	-
	에스케이씨솔믹스(주)	-	-	5,098	25,493	168	744	-	-
	충청에너지서비스(주)	-	-	1,600	11,921	-	10	-	-
	행복나래(주)	8	26	128,171	314,324	11,011	23,913	-	-
	SK머티리얼즈(주)	3	3	14,033	36,981	-	-	-	-
	SK실트론(주)	583	583	28,610	28,610	-	-	-	-
	기타	163	590	45,226	122,247	2,818	17,620	-	-
합 계		199,094	564,662	432,917	1,245,782	359,584	806,245	-	14,828

(\*1) 영업비용 등에는 배당금 87,660백만원이 포함되어 있습니다.

(\*2) 전분기 중 발생한 SK브랜드사용료는 26,180백만원입니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채권 등	채무 등
		매출채권 등	미지급금 등
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	1,921	109,154
	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	93	-
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	-	4,577
	SK(주)	5,583	136,557
	ESSENCORE Limited	64,328	-
	SK건설(주)	8,737	678,914
	SK에너지(주)	169	3,383
	SK네트웍스(주)	-	406
	에스케이씨솔믹스(주)	-	2,874
	충청에너지서비스(주)	-	954
	행복나래(주)	4	32,528
	SK머티리얼즈(주)	-	16,274
	SK실트론(주)(*)	151,033	38,909
	기타	79	75,161
합 계		231,947	1,099,691

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채권 등	채무 등
		매출채권 등	미지급금 등
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	-	90,782
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	94	3,014
	SK(주)	5,530	108,038
	ESSENCORE Limited	90,367	-
	SK건설(주)	7,327	946,517
	SK에너지(주)	500	10,505
	SK네트웍스(주)	-	1,395
	에스케이씨솔믹스(주)	-	3,393
	충청에너지서비스(주)	11	2,128
	행복나래(주)	3	55,126
	SK머티리얼즈(주)	-	11,692
	SK실트론(주)(*)	150,521	21,071
	기타	90	99,043
	합 계		254,443

(\*) 연결실체는 전기 중 Wafer 구매대금 150,000백만원을 선급하였습니다.(주석 31 참조)

(4) 주요경영진에 대한 보상

연결실체의 주요 경영진은 지배기업의 이사(등기 및 비등기), 이사회 의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	28,184	78,803	32,418	79,001
퇴직급여	2,631	7,821	2,167	6,621
주식보상비용	297	866	263	548
기타	4	12	3	9
합 계	31,116	87,502	34,851	86,179

(5) 당분기와 전분기 중 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	영업비용 등	
		3개월	누적
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	292	882

② 전분기

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	영업비용 등	
		3개월	누적
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	310	870

(6) 당분기말과 전기말 현재 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)		
구 분	회사명	채 무
		미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	290

② 전기말

(단위: 백만원)		
구 분	회사명	채 무
		미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK디스커버리	339
	SK케미칼(주)	38
합 계		377

### 31. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결실체와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

#### ① Netlist, Inc.의 특허 침해 소송

Netlist, Inc.는 지배기업과 SK hynix America Inc. 등 지배기업의 종속기업들을 상대로 다수의 특허를 침해하였다는 소송을 2016년 8월 31일 및 2017년 6월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 9월 1일 및 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에, 2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원 및 중국 베이징 지식재산법원에 각각 제기하였습니다. 당분기말 현재 미국 등 각 지역에서 진행 중인 Netlist, Inc.의 특허 침해 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며, 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

한편, 2016년 9월 1일 미국국제무역위원회에 제기되었던 특허 침해 소송은 2018년 1월 16일 지배기업 및 지배기업의 종속기업들이 Netlist, Inc.의 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정되었습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2018년 3월 26일에 항소를 제기하였습니다.

또한, 2017년 7월 11일 중국 베이징 지식재산법원에 제기되었던 특허 침해 소송에 대하여 중국 특허심판원은 2018년 5월 30일 소송 특허가 무효임을 결정하였으며, 본결정에 따라 특허 침해 소송은 2018년 6월 26일에 기각되었습니다.

#### ② Hagens Berman의 가격 담합 집단소송

Hagens Berman(소송대리인)은 지배기업 및 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 가격 담합에 대한 집단소송을 2018년 4월 27일 미국 캘리포니아 북부지방법원에 제기하였습니다. 당분기말 현재 제기된 본 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

#### ③ 중국 반독점법 위반 조사

2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였습니다. 당분기말 현재 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

#### ④ 소송 및 특허 클레임 등

당분기말 현재 연결실체는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며 향후 자원의 유출가능성이 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

#### (2) 특허라이선스 계약

연결실체는 당분기말 현재 제품생산과 관련한 다수의 특허라이선스 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의한 Royalty는 Lump-sum royalty 및 Running royalty의 형식으로 지급되며, Lump-sum royalty 지급액은 특허라이선스 계약기간에 따라 정액으로 안분된 금액을 비용으로 처리하고 있습니다.

#### (3) 공업용수공급계약

연결실체는 베올리아워터산업개발주 ("Veolia")와 공업용수를 공급받는 계약을 체결하고 있습니다. 기존 계약은 2018년 5월 만료되었으며, 2018년 6월부터 2023년 5월까지 5년간의 신규 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 의하면 연결실체는 계약기간 동안 Base Service Charge ("BSC")와 공업용수 사용량에 일정액을 적용하여 계산된 Additional Service Charge ("ASC")를 Veolia에 지급해야 합니다.

#### (4) HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.와 후공정서비스계약

연결실체는 HITECH과 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등입니다. 연결실체는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 가격을 지불하기로 하였습니다.

(5) 당분기말 현재 담보제공자산 등의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
구 분(*)	장부금액	담보설정액	비 고
토 지	1,260	939,664	시설자금대출관련 등
건 물	6,810		
기계장치	656,710		
합 계	664,780	939,664	

(\*) 상기 담보제공자산 이외에 연결실체의 금융리스자산은 해당 금융리스 계약에 의하여 관련 금융리스부채의 담보로 제공되어 있습니다.

(6) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	금융기관	약정사항	한도금액	
			통 화	금 액
지배기업	KEB하나은행 등	Usance 등 수입금융약정	USD	225
		매입외환 등 수출금융약정	USD	50
		수입·수출 포괄한도약정	USD	960
		상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정	KRW	140,000
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	중국농업은행 등	Usance 등 수입금융약정	RMB	2,000
			USD	492
SK hynix America Inc. 등 판매법인	한국씨티은행 등	상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정	USD	369
국내중속기업	KEB하나은행 등	Usance 등 수입금융약정	USD	45
		외상매출채권담보대출	KRW	46,000
		납품대금지급업무대행계약	KRW	12,500

(7) 당분기말 현재 연결실체가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	금 액	비 고
종업원	5	우리사주관련 금융기관 차입금 지급보증

(8) 당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정액은 2,100,358백만원(전기말: 661,588백만원)입니다.

(9) 원재료 장기매입 약정

연결실체는 Wafer 수급 안정성 확보를 위하여 SK실트론(주)와 2019년부터 2023년까지 Wafer 구매계약을 체결하였으며, 전기 중 구매대금 150,000백만원을 선급하였습니다. 한편, SK실트론(주)는 연결실체가 선급한 150,000백만원을 보증하기 위하여 투자자산 일부를 양도담보로 제공하기로 약정하였습니다.

(10) 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)의 조인트벤처 출자 약정

지배기업의 연결대상 종속기업인 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)(이하, SKHYIC)는 중국 무석산업발전그룹유한공사와 Hystar Semiconductor (Wuxi) Co, Ltd.(이하,HSIC)를 출자 설립하는 공동약정을 체결하였습니다. SKHYIC의 해당 회사에 대한 지분율은 50%를 초과하나 피투자자의 이익에 유의적 영향을 미치는 의사결정을 이사회 의 만장일치 사항으로 규정한 공동약정서에 따라 기업회계기준서 제1111호에 따른 공동기업에 해당하는 것으로 판단 하였습니다. 한편, SKHYIC는 2018년 7월 23일에 USD 75,150천을 출자완료하였습니다.

32. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
분기순이익	12,142,065	7,422,719
조정항목:		
법인세비용	4,487,454	1,859,600
퇴직급여	127,144	123,083
감가상각비	4,285,162	3,408,687
투자부동산상각비	68	79
무형자산상각비	389,993	279,087
주식보상비용	866	548
유형자산처분손실	57,759	6,284
무형자산처분손실	4,414	3,926
무형자산손상차손	3,463	47
이자비용	65,781	96,330
외화환산손실	188,233	40,526
지분법손익	(11,451)	(8,027)
유형자산처분이익	(30,475)	(29,379)
단기투자자산평가이익	(9,578)	(2,937)
단기투자자산처분이익	(18,874)	(8,627)
장기투자자산처분이익	(248)	(30,945)
파생상품관련손익	-	11
이자수익	(53,791)	(33,983)
외화환산이익	(69,563)	(213,079)
기 타	4,661	5,430
운전자본의 변동:		
매출채권의 감소(증가)	(2,056,686)	(2,105,702)
기타수취채권의 감소(증가)	19,914	(1,591)
재고자산의 감소(증가)	(1,051,823)	(532,470)
기타자산의 감소(증가)	(18,494)	(123,189)
매입채무의 증가(감소)	(79,100)	142,577
미지급금의 증가(감소)	34,583	(46,469)
기타지급채무의 증가(감소)	(199,454)	316,910
총당부채의 증가(감소)	(38,214)	23,840
기타부채의 증가(감소)	87,007	(7,308)
사외적립자산의 납부	(91)	-
퇴직금의 지급	(8,541)	(13,846)

영업으로부터 창출된 현금	18,252,184	10,572,132
---------------	------------	------------

(2) 당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입·유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
SK China Company Limited에 대한 현물출자	-	143,208
유형자산 취득관련 미지급금 증가	94,604	-

(3) 당분기와 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초	4,171,270	4,335,978
재무적 현금으로 인한 변동		
- 차입금의 차입	2,407,194	752,944
- 차입금의 상환	(1,656,045)	(691,642)
환율변동효과	53,767	(95,054)
상각(이자비용)	1,192	1,312
기말	4,977,378	4,303,538

### 33. 주식기준보상

(1) 연결실체는 당분기 중 연결실체의 주요 경영진에게 주식결제형 주식선택권을 부여하였으며, 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)								
구 분	총부여수량	소멸수량	행사수량	미행사수량	부여일	약정용역제공기간	행사가능기간	행사가격
1차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2019.03.24	2019.03.25 ~ 2022.03.24	48,400원
2차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2020.03.24	2020.03.25 ~ 2023.03.24	52,280원
3차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2021.03.24	2021.03.25 ~ 2024.03.24	56,460원
4차	7,747	-	-	7,747	2018.01.01	2018.01.01 ~ 2019.12.31	2020.01.01 ~ 2022.12.31	77,440원
5차	7,223	-	-	7,223	2018.03.28	2018.03.28 ~ 2020.03.28	2020.03.29 ~ 2023.03.28	83,060원
합 계	313,770	-	-	313,770				

### (2) 공정가치 측정

이항모형을 적용하여 공정가액 접근법에 의한 보상원가를 산정하였으며, 주식결제형주식기준보상제도의 부여일 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분	기대주가변동성	부여일 공정가치	배당수익률	무위험이자율 (국공채 수익률)
1차	23.23%	10,026원	1.20%	1.86%
2차	23.23%	9,613원	1.20%	1.95%
3차	23.23%	9,296원	1.20%	2.07%
4차	22.50%	16,687원	0.78%	2.38%
5차	25.30%	18,362원	1.23%	2.46%

(3) 연결실체가 당분기 중 인식한 주식보상비용은 866백만원(전분기: 548백만원)입니다.

### 34. 보고기간 후 사건

#### (1) 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)의 출자

지배기업의 연결대상 종속기업인 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)는 중국 내 파운드리 사업 운영법인 SK Hynix System ic (Wuxi) Ltd.에 2018년 11월 중 USD 10,000,000을 출자하였습니다.

## 4. 재무제표

### 재무상태표

제 71 기 3분기말 2018.09.30 현재

제 70 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 71 기 3분기말	제 70 기말
자산		
유동자산	15,205,373	15,338,930
현금및현금성자산	1,797,362	2,270,036
단기금융상품	297,500	4,528,880
단기투자자산	1,716,160	580,449
매출채권	7,738,621	5,259,052
기타수취채권	16,523	41,049
재고자산	3,153,574	2,224,740
기타유동자산	485,633	434,724
비유동자산	41,142,431	28,973,916
관계기업 및 공동기업투자	6,504,980	4,778,280
장기투자자산	3,935,961	37,593
기타수취채권	38,501	29,600
기타금융자산	11	11
유형자산	27,718,946	21,322,943
무형자산	2,137,218	1,918,259
투자부동산	1,416	2,468
이연법인세자산	136,291	136,291
종업원급여자산		13,385
기타비유동자산	669,107	735,086
자산총계	56,347,804	44,312,846
부채		
유동부채	10,159,274	8,076,214
매입채무	1,249,848	1,107,029
단기미지급금	3,086,487	2,642,022
기타지급채무	1,003,806	1,204,808
단기차입금 및 유동성 장기 차입금	1,289,333	634,768
총당부채	55,650	103,099
당기법인세부채	3,331,822	2,354,425
기타유동부채	142,328	30,063
비유동부채	3,867,812	3,464,757
기타지급채무	5,315	4,406
장기차입금	3,658,132	3,394,588
확정급여부채	135,824	
기타비유동부채	68,541	65,763
부채총계	14,027,086	11,540,971

자본		
자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금	4,183,564	4,183,564
기타자본	(2,506,748)	(771,100)
기타포괄손익누계액		(10,735)
이익잉여금	36,986,250	25,712,494
자본총계	42,320,718	32,771,875
자본과부채총계	56,347,804	44,312,846

### 포괄손익계산서

제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 71 기 3분기		제 70 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	11,335,564	30,335,667	7,974,611	20,827,540
매출원가	3,975,253	11,305,277	3,472,026	9,447,978
매출총이익	7,360,311	19,030,390	4,502,585	11,379,562
판매비와관리비	970,327	2,796,331	888,838	2,378,434
영업이익	6,389,984	16,234,059	3,613,747	9,001,128
금융수익	64,087	856,886	198,168	641,176
금융비용	146,294	598,570	118,494	589,601
기타영업외수익	33,031	50,817	25,724	69,960
기타영업외비용	15,165	116,024	13,065	54,178
법인세비용차감전 순이익	6,325,643	16,427,168	3,706,080	9,068,485
법인세비용	1,714,499	4,415,542	767,525	1,820,049
당기순이익	4,611,144	12,011,626	2,938,555	7,248,436
법인세차감후 기타 포괄손익	(7,047)	(21,133)	(4,209)	(12,521)
후속적으로 당기 손익으로 재분류되 지 않는 포괄손익				
확정급여제도 의 재측정요소	(7,047)	(21,133)	(4,209)	(12,521)
총포괄이익	4,604,097	11,990,493	2,934,346	7,235,915
주당이익				

기본주당순이익 (단위 : 원)	6,612	17,084	4,162	10,267
희석주당순이익 (단위 : 원)	6,611	17,082	4,162	10,267

### 자본변동표

제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본					
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2017.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,183,564	(771,913)		16,022,210	23,091,513
당기순이익					7,248,436	7,248,436
확정급여제도의 재측정요소					(12,521)	(12,521)
배당금지급					(423,601)	(423,601)
자기주식 거래로 인한 증감						
주식선택권 부여			548			548
2017.09.30 (기말자본)	3,657,652	4,183,564	(771,365)		22,834,524	29,904,375
2018.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,183,564	(771,100)		25,701,759	32,771,875
당기순이익					12,011,626	12,011,626
확정급여제도의 재측정요소					(21,133)	(21,133)
배당금지급					(706,002)	(706,002)
자기주식 거래로 인한 증감			(1,736,514)			(1,736,514)
주식선택권 부여			866			866
2018.09.30 (기말자본)	3,657,652	4,183,564	(2,506,748)		36,986,250	42,320,718

### 현금흐름표

제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 71 기 3분기	제 70 기 3분기
영업활동현금흐름	14,432,864	9,032,933

영업으로부터 창출된 현금흐름	17,304,083	9,649,291
이자의 수취	63,655	20,316
이자의 지급	(87,573)	(88,856)
배당금의 수취	48,858	17,619
법인세의 납부	(2,896,159)	(565,437)
투자활동현금흐름	(13,327,677)	(8,374,452)
단기금융상품의 순증감	4,231,380	(180,000)
단기투자자산의 순증감	(1,122,591)	(1,046,410)
기타금융자산의 감소		1
기타수취채권의 감소	10,620	9,405
기타수취채권의 증가	(14,581)	(12,341)
장기투자자산의 처분	1,201	1,916
장기투자자산의 취득	(3,939,690)	(21,798)
파생상품거래로 인한 현금유입		902
파생상품거래로 인한 현금유출		(1,201)
유형자산의 처분	136,052	296,144
유형자산의 취득	(10,311,163)	(6,244,367)
무형자산의 처분	2,433	985
무형자산의 취득	(606,620)	(607,984)
종속기업투자(MMT)의 순증감	(809,587)	(294,013)
종속기업투자의 취득	(794,251)	(161,731)
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(110,880)	(113,960)
재무활동현금흐름	(1,575,661)	(372,048)
차입금의 차입	2,402,196	685,084
차입금의 상환	(1,535,341)	(633,531)
자기주식의 취득	(1,736,514)	
배당금의 지급	(706,002)	(423,601)
현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,200)	13,414
현금및현금성자산의 순증감	(472,674)	299,847
기초 현금및현금성자산	2,270,036	476,917
기말 현금및현금성자산	1,797,362	776,764

## 5. 재무제표 주석

## 1. 회사의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "당사")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 당사는 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091에 본사와 경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있으며, 경기도 이천시와 충청북도 청주시에 생산공장을 설치·가동하고 있습니다.

한편, 2018년 9월 30일 현재 당사의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)	지분율(%)
SK텔레콤주	146,100,000	20.07
국민연금공단 및 기타주주	537,901,795	73.89
자기주식	44,000,570	6.04
합 계	728,002,365	100.00

당분기말 현재 당사의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식예탁증서는 록셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다.

## 2. 재무제표 작성기준

### (1) 회계기준의 적용

당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차 보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 원가로 표시한 재무제표입니다

당사의 분기재무제표에는 기업회계기준서 제1109호와 기업회계기준서 제1115호가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석 3에서 설명하고 있습니다.

## (2) 추정과 판단

### ① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1109호와 기업회계기준서 제1115호 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

## ② 공정가치 측정

당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가방법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 금융위험관리 주석 등에 포함되어 있습니다.

### 3. 유의적인 회계정책

당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.

#### (1) 회계정책의 변경

당사는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'과 제1109호 '금융상품'을 최초 적용하였습니다. 2018년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준서들은 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.

##### 1) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'

기업회계기준서 제1115호는 수익을 언제, 얼마나 인식할지를 결정하기 위한 포괄적인 체계입니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체하였습니다.

당사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 실무적 간편법적용 없이 소급 적용하여, 최초 적용 누적효과를 최초적용일(2018년 1월 1일)에 인식하였습니다. 개정기준서 도입으로 인하여 당사에 재무적 영향이 있는 항목은 다음과 같습니다.

##### ① 반품권이 있는 판매 회계처리

당사는 고객에게 반도체 제품을 공급하는 계약에 있어 품질하자 등에 따른 반품을 허용하기 때문에 고객으로부터 수령하는 대가가 변동될 수 있습니다. 기업회계기준서 제1115호 적용시 당사는 고객으로부터 수령할 대가를 보다 적절하게 예측할 것으로 예상하는 기댓값 방법을 사용하여 변동대가를 추정하고, 반품기한이 경과할 때 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 변동대가를 거래가격에 포함하여 수익을 인식합니다. 한편, 당사가 수령하였거나 수령할 대가 중 권리를 갖게 될 것으로 예상하지 않는 금액은 환불부채(계약부채)로 인식합니다.

② C조건 운송용역 회계처리

기업회계기준서 제1115호 적용시 고객과의 계약에서 제품판매와 제품운송의 수행의무가 식별되었으나 당사의 일반적인 거래형태인 도착지인도조건의 매출거래는 제품 운송이 완료된 후 제품의 통제가 이전되므로 두 개의 수행의무가 별도로 구별되지 않는 것으로 판단하였습니다. 하지만 고객이 운송료 또는 보험료를 부담하는 선적지인도조건(이하, "C조건")으로 체결된 수출거래의 경우에는 제품운송 수행의무가 제품에 대한 통제가 고객에게 이전된 이후에 수행되므로 이를 별도의 수행의무로 식별하였으며, C조건 운송용역 매출과 관련된 운송비용을 매출원가로 인식하였습니다.

- 최초 적용일(당기초) 현재 재무상태표에 반영한 전환 효과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)			
계정과목	2017.12.31 전환전	조정	2018. 1. 1 전환후
I. 유동자산			
기타유동자산	434,724	26,183	460,907
기타	14,904,206	-	14,904,206
유동자산 계	15,338,930	26,183	15,365,113
II. 비유동자산	28,973,916	-	28,973,916
자 산 총 계	44,312,846	26,183	44,339,029
I. 유동부채			
충당부채	103,099	(45,148)	57,951
기타유동부채	30,063	71,331	101,394
기타	7,943,052	-	7,943,052
유동부채 계	8,076,214	26,183	8,102,397
II. 비유동부채	3,464,757	-	3,464,757
부 채 총 계	11,540,971	26,183	11,567,154
자 본 총 계	32,771,875	-	32,771,875
부 채 및 자 본 총 계	44,312,846	26,183	44,339,029

2018년 9월 30일 기준 당사의 분기재무상태표와 동일자로 종료되는 분기포괄손익계산서에  
서 기업회계기준서 제1115호 적용효과는 다음과 같습니다. 당사의 동일자로 종료되는 분기  
현금흐름표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.

당분기말 현재 분기재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)			
계정과목	공시금액	조정	제1115호 반영 전 금액
I. 유동자산			
기타유동자산	485,633	(30,998)	454,635
기타	14,719,740	-	14,719,740
유동자산 계	15,205,373	(30,998)	15,174,375
II. 비유동자산	41,142,431	-	41,142,431
자 산 총 계	56,347,804	(30,998)	56,316,806
I. 유동부채			
충당부채	55,650	80,160	135,810
기타유동부채	142,328	(111,158)	31,170
기타	9,961,296	-	9,961,296
유동부채 계	10,159,274	(30,998)	10,128,276
II. 비유동부채	3,867,812	-	3,867,812
부 채 총 계	14,027,086	(30,998)	13,996,088
자 본 총 계	42,320,718	-	42,320,718
부 채 및 자 본 총 계	56,347,804	(30,998)	56,316,806

당분기 중 분기포괄손익계산서에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)			
계정과목	공시금액	조정	제1115호 반영 전 금액
I. 매출액	30,335,667	-	30,335,667
II. 매출원가	11,305,277	(17,247)	11,288,030
III. 매출총이익	19,030,390	17,247	19,047,637
판매비와관리비	2,796,331	17,247	2,813,578
IV. 영업이익	16,234,059	-	16,234,059
금융수익	856,886	-	856,886
금융비용	598,570	-	598,570
기타영업외수익	50,817	-	50,817
기타영업외비용	116,024	-	116,024
V. 법인세비용차감전순이익	16,427,168	-	16,427,168
법인세비용	4,415,542	-	4,415,542
VI. 분기순이익	12,011,626	-	12,011,626
VII. 법인세차감후 기타포괄손익	(21,133)	-	(21,133)
VIII. 분기총포괄이익	11,990,493	-	11,990,493

2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'

기업회계기준서 제1109호는 금융자산, 금융부채 및 비금융항목을 매입하거나 매도할 수 있는 일부 계약의 인식과 측정을 규정합니다. 이 기준서는 기업회계기준서 제 1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체합니다. 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.

금융상품의 분류와 측정으로 인해 변경된 기초 자본내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
조정내역	기타포괄손익누계액	이익잉여금
기업회계기준서 제1039호에 따른 기초 자본	(10,735)	25,712,494
매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류	10,735	(10,735)
기업회계기준서 제1109호에 따른 기초 자본	-	25,701,759

① 금융자산과 금융부채의 분류

기업회계기준서 제1109호는 금융부채의 분류와 측정에 대한 기업회계기준서 제 1039호의 기존 요건을 대부분 유지하였습니다. 그러나 만기보유금융자산, 대여금 및수취채권과 매도가능금융자산의 금융자산 기존 분류를 삭제하였습니다.

기업회계기준서 제1109호에 의하면, 최초 적용 시에 금융자산은 상각후원가측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품, 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품, 당기손익-공정가치 측정 범주로 분류됩니다. 기업회계기준서 제1109호에 따른 금융자산의 분류는 일반적으로 금융자산이 관리되는 방식인 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름의 특성에 근거하여 결정됩니다. 주계약이 이 기준서의 적용범위에 해당하는 금융자산인 계약에 내재된 파생상품은 분리되지 않습니다.

금융자산은 다음 두 가지 조건을 모두 충족하고, 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정되지 않은 경우 상각후원가로 측정됩니다.

- 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산이 보유된다.
- 계약 조건에 따라 특정일에 이자와 원금 잔액에 대한 이자 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생한다.

채무상품은 다음 두 가지 조건을 모두 충족하고 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정되지 않은 경우 기타포괄손익-공정가치로 측정됩니다.

- 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산이 보유된다.
- 계약 조건에 따라 특정일에 이자와 원금 잔액에 대한 이자 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생한다.

단기매매항목이 아닌 지분상품의 최초 인식일에 당사는 그 투자지분의 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 수 있으며, 그러한 선택을 취소할 수 없습니다. 이러한 선택은 금융상품별로 이루어집니다.

위에서 설명된 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치로 측정되지 않는 모든 금융상품은 모든 파생 금융자산을 포함하여 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 당사는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정되어야 하는 금융자산을 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄일 목적으로 해당 금융자산의 최초 인식시점에 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있습니다. 다만, 이러한 지정은 취소할 수 없습니다.

최초에 거래가격으로 측정되는 유의적인 금융요소가 없는 매출채권이 아닌 금융자산은 당기손익-공정가치 측정 항목이 아니라면 최초에 공정가치에 취득에 직접 관련되는 거래원가를 가산하여 측정합니다.

다음 회계정책은 금융자산의 후속측정에 적용합니다.

당기손익-공정가치 측정 금융자산	이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 이자와 배당수익을 포함한 순손익은 당기손익으로 인식합니다.
상각후원가 측정 금융자산	이러한 자산은 후속적으로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가는 손상손실에 의해 감소됩니다. 이자수익, 외화환산손익 및 손상은 당기손익으로 인식합니다. 제거에 따르는 손익도 당기손익으로 인식합니다.
기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품	이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 유효이자율법을 사용하여 계산된 이자수익, 외화환산손익과 손상은 당기손익으로 인식합니다. 다른 순손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 제거시에 기타포괄손익에 누적된손익은 당기손익으로 재분류합니다.
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 배당은 배당금이 명확하게 투자원가의 회수를 나타내지 않는다면 당기손익으로 인식합니다. 다른 순손익은 기타포괄손익으로 인식하고 절대로 당기손익으로 재분류되지 않습니다.

최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기업회계기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융자산 범주의 재분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)					
구 분	측정범주		장부금액		
	도입 전	도입 후	도입 전	도입 후	차이
현금및현금성자산	대여금및수취채권	상각후원가	2,270,036	2,270,036	-
단기금융상품	대여금및수취채권	상각후원가	4,528,880	4,528,880	-
단기투자자산	당기손익인식금융자산	당기손익-공정가치	580,449	580,449	-
매출채권	대여금및수취채권	상각후원가	5,259,052	5,259,052	-
기타수취채권	대여금및수취채권	상각후원가	70,649	70,649	-
기타금융자산	대여금및수취채권	상각후원가	11	11	-
장기투자자산(*)	매도가능금융자산	당기손익-공정가치	37,593	37,593	-
금융자산 합계			12,746,670	12,746,670	-

(\*) 당기초 현재 출자금 등을 포함한 37,593백만원은 매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류되었습니다. 동 금융자산은 계약상 현금흐름이 원리금 지급만을 나타내지않아 상각후원가로 분류되는 조건을 충족하지 못합니다. 동 재분류로 인해 당기초 현재 관련 기타포괄손익누계액 (-)10,735백만원은 이익잉여금으로 재분류되었습니다. 당분기 중 동 금융자산과 관련한 공정가치 변동은 없습니다.

## ② 금융자산의 손상

기업회계기준서 제1109호는 기업회계기준서 제1039호의 '발생손실'모형을 기대신용손실'모형으로 대체하였습니다. 새로운 손상모형은 상각후원가로 측정되는 금융자산, 계약자산 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품에 적용되지만, 지분상품 투자에는 적용되지 않습니다. 기업회계기준서 제1109호에서 신용손실은 기업회계기준서 제1039호보다 일찍 인식됩니다.

기대신용손실은 신용손실의 확률가중추정치입니다. 신용손실은 모든 현금부족액(즉, 계약에 따라 지급받기로 한 모든 계약상 현금흐름과 수취할 것으로 예상하는 모든 계약상 현금흐름의 차이)의 현재가치로 측정됩니다.

매 보고기간말에, 당사는 상각후원가로 측정되는 금융자산과 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무증권의 신용이 손상되었는지 평가합니다. 금융자산의 추정미래현금흐름에 악영향을 미치는 하나 이상의 사건이 발생한 경우에 해당 금융자산은 신용이 손상된 것입니다.

상각후원가로 측정하는 금융자산에 대한 손실충당금은 해당 자산의 장부금액에서 차감합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대해서는 해당 자산의 장부금액을 감소시키는 대신에 손실충당금을 기타포괄손익에 인식합니다. 당기초 현재기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 없습니다.

기업회계기준서 제1109호의 금융자산 손상 요구사항의 적용에 따라 발생하는 회계정책 변경의 효과는 없습니다.

### ③ 위험회피회계

당사는 기업회계기준서 제1109호를 최초 적용하면서 동 기준서의 위험회피회계 요구사항을 적용하기로 결정하였습니다. 당기초 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품은 없으며, 따라서 기업회계기준서 제1109호의 위험회피회계 요구사항의 적용에 따라 발생하는 회계정책 변경의 효과는 없습니다.

### (2) 미적용 제·개정 기준서

제정·공표되었으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 제·개정 기준서는 다음과 같습니다. 당사는 분기재무제표 작성시 다음의 제·개정 기준서를 조기적용하지 아니하였습니다.

#### - 기업회계기준서 제1116호 '리스'

당사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일 시작되는 회계연도부터 적용할 예정이며, 2018년 중 기업회계기준서 제1116호의 도입에 따른 재무영향을 분석하여 그 결과를 2018년 연차재무제표 주석에 공시할 예정입니다. 전기 연차 재무제표에서 설명한 일반적인 영향분석 이외의 당분기말 현재 동 기준서의 도입 준비와 관련한 중요한 변동사항은 없습니다.

4. 금융상품의 범주별 분류

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 구분 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산	합 계
현금및현금성자산	-	1,797,362	1,797,362
단기금융상품	-	297,500	297,500
단기투자자산	1,716,160	-	1,716,160
매출채권	-	7,738,621	7,738,621
기타수취채권	-	55,024	55,024
기타금융자산	-	11	11
장기투자자산	3,935,961	-	3,935,961
합 계	5,652,121	9,888,518	15,540,639

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	당기손익인식 금융자산	매도가능 금융자산	대여금및 수취채권	합 계
현금및현금성자산	-	-	2,270,036	2,270,036
단기금융상품(*)	-	-	4,528,880	4,528,880
단기투자자산(*)	580,449	-	-	580,449
매출채권	-	-	5,259,052	5,259,052
기타수취채권	-	-	70,649	70,649
기타금융자산	-	-	11	11
장기투자자산(*)	-	37,593	-	37,593
합 계	580,449	37,593	12,128,628	12,746,670

(\*) 전기말의 단기금융상품 및 매도가능금융자산은 당분기의 분류에 따라 재분류되었습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 구분내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)	
구 분	상각후원가로 측정하는 금융부채
매입채무	1,249,848
미지급금	3,086,487
기타지급채무(*)	1,009,121
차입금	4,947,465
합 계	10,292,921

② 전기말

(단위: 백만원)	
구 분	상각후원가로 측정하는 금융부채
매입채무	1,107,029
미지급금	2,642,022
기타지급채무(*)	1,209,214
차입금	4,029,356
합 계	8,987,621

(\*) 당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미지급비용	1,003,806	1,204,808
비유동:		
임대보증금	4,998	4,406
장기미지급비용	317	-
합 계	1,009,121	1,209,214

5. 금융위험관리

(1) 금융위험관리

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2017년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 당사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기 말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

① 시장위험

(가) 환율변동위험

당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 당사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	8,290	9,224,662	2,486	2,766,081
EUR	1	786	288	372,625
JPY	25,279	248,031	175,251	1,719,509

당분기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동을 가정한 화폐성 외화자산 및 외화부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	645,858	(645,858)
EUR	(37,184)	37,184
JPY	(147,148)	147,148

#### (나) 이자율위험

당사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

당사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시, 향후 3개월 간 당사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이익은 5,883백만원만큼 증가 또는 감소할 것입니다.

#### (다) 가격위험

당사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

#### ② 신용위험

신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

#### (가) 매출채권 및 기타수취채권

당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 당사의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.

#### (나) 기타의 자산

현금및현금성자산, 단기금융상품, 단기투자자산 및 장·단기대여금 등으로 구성되는당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액입니다. 한편, 당사는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

#### ③ 유동성 위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

당사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

#### (2) 자본관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재의 부채비율과 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
부 채 (A)	14,027,086	11,540,971
자 본 (B)	42,320,718	32,771,875
현금및현금성자산 등(C) (*1)	3,811,022	7,379,365
차입금 (D)	4,947,465	4,029,356
부채비율 (A/B)	33.14%	35.22%
순차입금비율 (D-C)/B (*2)	2.69%	-

(\*1) 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.

(\*2) 전기말의 순차입금비율은 부(-)의 비율로 산출되어 표시하지 않았습니다.

### (3) 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	1,716,160	-	1,716,160	-	1,716,160
장기투자자산	3,935,961	-	-	3,935,961	3,935,961
소 계	5,652,121	-	1,716,160	3,935,961	5,652,121
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*)	1,797,362	-	-	-	-
단기금융상품(*)	297,500	-	-	-	-
매출채권(*)	7,738,621	-	-	-	-
기타수취채권(*)	55,024	-	-	-	-
기타금융자산(*)	11	-	-	-	-
소 계	9,888,518	-	-	-	-
금융자산 합계	15,540,639	-	1,716,160	3,935,961	5,652,121
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*)	1,249,848	-	-	-	-
미지급금(*)	3,086,487	-	-	-	-
기타지급채무(*)	1,009,121	-	-	-	-
차입금	4,947,465	-	4,950,192	-	4,950,192
금융부채 합계	10,292,921	-	4,950,192	-	4,950,192

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	580,449	-	580,449	-	580,449
장기투자자산	37,593	-	-	37,593	37,593
소 계	618,042	-	580,449	37,593	618,042
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*)	2,270,036	-	-	-	-
단기금융상품(*)	4,528,880	-	-	-	-
매출채권(*)	5,259,052	-	-	-	-
기타수취채권(*)	70,649	-	-	-	-
기타금융자산(*)	11	-	-	-	-
소 계	12,128,628	-	-	-	-
금융자산 합계	12,746,670	-	580,449	37,593	618,042
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*)	1,107,029	-	-	-	-
미지급금(*)	2,642,022	-	-	-	-
기타지급채무(*)	1,209,214	-	-	-	-
차입금	4,029,356	-	4,037,013	-	4,037,013
금융부채 합계	8,987,621	-	4,037,013	-	4,037,013

(\*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

③ 가치평가기법

수준 2 및 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3 간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)					
구 분	기 초(*)	취 득	처 분	환율변동	당분기말
장기투자자산	37,593	3,939,690	(952)	(40,370)	3,935,961

(\*) 전기말 동일한 상품(즉, 수준 1의 투입변수)에 대한 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 지분상품에 해당하여 다른 방법으로 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로, 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 원가로 측정한 매도가능금융자산 27,340백만원이 포함되어 있습니다.

6. 사용제한 금융상품

당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
단기금융상품:		
중소기업지원관련 사용제한(상생펀드)	227,500	227,500
기타금융자산:		
당좌개설보증금	11	11
합 계	227,511	227,511

7. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미수금	14,383	15,348
미수수익	2,009	20,630
단기대여금	131	5,071
소 계	16,523	41,049
비유동:		
장기대여금	1,589	2,160
보증금	36,912	27,440
소 계	38,501	29,600
합 계	55,024	70,649

(2) 대손충당금의 내역

당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액
매출채권	7,738,621	-	7,738,621	5,259,052	-	5,259,052
유동성 기타수취채권	17,806	(1,283)	16,523	42,335	(1,286)	41,049
비유동성 기타수취채권	38,603	(102)	38,501	29,702	(102)	29,600
합 계	7,795,030	(1,385)	7,793,645	5,331,089	(1,388)	5,329,701

(3) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	당분기말
매출채권	-	-	-	-	-
유동성 기타수취채권	1,286	-	(3)	-	1,283
비유동성 기타수취채권	102	-	-	-	102
합 계	1,388	-	(3)	-	1,385

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	전분기말
매출채권	1,069	-	(238)	-	831
유동성 기타수취채권	1,371	-	(14)	-	1,357
비유동성 기타수취채권	399	-	(3)	-	396
합 계	2,839	-	(255)	-	2,584

8. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실총당금	장부금액	취득원가	평가손실총당금	장부금액
제품	901,152	(84,399)	816,753	520,895	(105,601)	415,294
재공품	1,745,435	(24,805)	1,720,630	1,432,927	(29,096)	1,403,831
원재료	327,583	(10,377)	317,206	251,791	(25,960)	225,831
저장품	273,233	(6,557)	266,676	176,006	(7,040)	168,966
미착품	32,309	-	32,309	10,818	-	10,818
합 계	3,279,712	(126,138)	3,153,574	2,392,437	(167,697)	2,224,740

9. 기타유동자산 및 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선급금	72,836	33,859
선급비용	257,510	205,823
부가세대급금	124,038	191,996
계약자산	30,998	-
기 타	251	3,046
소 계	485,633	434,724
비유동:		
장기선급금	118,298	183,489
장기선급비용	550,809	551,597
소 계	669,107	735,086
합 계	1,154,740	1,169,810

10. 종속기업, 관계기업 및 공동기업

(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
종속기업	6,042,129	4,426,309
관계기업 및 공동기업	462,851	351,971
합 계	6,504,980	4,778,280

(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말	
			지분율(%)	장부금액	지분율(%)	장부금액
에스케이하이이엔지(주)	국 내	건설공사 및 서비스	100.00	7,521	100.00	7,521
에스케이하이시스템(주)	국 내	사업지원 및 서비스	100.00	6,760	100.00	6,760
(주)실리콘화일(*1)	국 내	전자·전기부품 개발 및 제조	-	-	100.00	30,756
행복모아(주)	국 내	반도체 의류 제조 및 서비스	100.00	7,400	100.00	7,400
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)(*1,2)	국 내	반도체 제조 및 판매	100.00	404,928	100.00	290,172
SK hynix America Inc.	미 국	반도체 판매	97.74	31	97.74	31
SK hynix Deutschland GmbH	독 일	반도체 판매	100.00	22,011	100.00	22,011
SK hynix Asia Pte. Ltd.	싱가포르	반도체 판매	100.00	52,380	100.00	52,380
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	홍 콩	반도체 판매	100.00	32,623	100.00	32,623
SK hynix U.K. Ltd.	영 국	반도체 판매	100.00	1,775	100.00	1,775
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	대 만	반도체 판매	100.00	37,562	100.00	37,562
SK hynix Japan Inc.	일 본	반도체 판매	100.00	42,905	100.00	42,905
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	중 국	반도체 판매	100.00	4,938	100.00	4,938
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(*3)	인 도	반도체 판매	1.00	5	1.00	5
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	중 국	반도체 판매	100.00	237	100.00	237
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(*4,5)	중 국	반도체 제조	100.00	3,533,221	91.50	2,847,911
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(*4)	중 국	반도체 제조	-	-	100.00	238,271
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(*6)	중 국	반도체 제조	-	-	-	-
SK hynix Italy S.r.l	이탈리아	반도체 연구개발	100.00	18	100.00	18
SK hynix memory solutions America Inc.(*7)	미 국	반도체 연구개발	100.00	311,283	100.00	311,283
SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.(*8)	대 만	반도체 연구개발	100.00	7,819	100.00	7,819
SK hynix memory solutions Eastern Europe LLC.(*9)	벨라루스	반도체 연구개발	99.93	14,579	99.93	14,579
SK APTECH Ltd.(*10)	홍 콩	해외투자법인	100.00	373,300	100.00	166,299
SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.(*11)	홍 콩	해외투자법인	100.00	59,263	100.00	3,053
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.(*12)	중 국	해외투자법인	-	-	-	-
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.(*13)	중 국	해외병원자산법인	-	-	-	-
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.(*13)	중 국	해외병원운영법인	-	-	-	-
MMT(특정금전신탁)(*14)	국 내	특정금전신탁	100.00	1,121,570	100.00	300,000
합 계				6,042,129		4,426,309

- (\*1) 당분기 중 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 합병하였습니다.
- (\*2) 당분기 중 유상증자로 인하여 84,000백만원의 추가취득이 발생하였습니다.
- (\*3) 종속기업인 SK hynix Asia Pte. Ltd.의 종속기업입니다.
- (\*4) 당분기 중 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.가 SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.를 합병하였습니다.
- (\*5) 당분기 중 유상증자로 인하여 447,040백만원의 추가취득이 발생하였습니다.
- (\*6) 종속기업인 SK APTECH Ltd.의 종속기업입니다.
- (\*7) 당분기 중 회사명이 SK hynix memory solutions Inc.에서 SK hynix memory solutions America Inc.로 변경되었습니다.
- (\*8) 당분기 중 회사명이 SK hynix Flash Solution Taiwan에서 SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.로 변경되었습니다.
- (\*9) 당분기 중 회사명이 Softeq Flash Solutions LLC.에서 SK hynix memory solutions Eastern Europe LLC.로 변경되었습니다.
- (\*10) 당분기 중 유상증자로 인하여 207,001백만원의 추가취득이 발생하였습니다.
- (\*11) 당분기 중 유상증자로 인하여 56,210백만원의 추가취득이 발생하였습니다.
- (\*12) 당분기 중 설립되었으며, 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.의 종속기업입니다.
- (\*13) 당분기 중 설립되었으며, 종속기업인 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.의 종속기업입니다.
- (\*14) 당분기 중 MMT(특정금전신탁)을 전액 처분하고 신규 취득하였습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)							
구 분	회사명	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말	
				지분율(%)	장부금액	지분율(%)	장부금액
관계기업	Stratio, Inc.(*)	미 국	반도체 부품 개발 및 제조	9.12	2,194	9.12	2,194
	SK China Company Limited(*)	중 국	컨설팅 및 투자	11.87	257,169	11.87	257,169
	SK South East Asia Investment Pte. Ltd.(*)	싱가포르	컨설팅	20.00	110,880	-	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	중 국	반도체 부품 제조	45.00	92,608	45.00	92,608
합 계					462,851		351,971

(\*1) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(\*2) 당분기 중 SK South East Asia Investment Pte. Ltd.의 지분 20.00%를 취득하였으며, 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

#### 11. 장기투자자산

당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	37,593	143,590
취득(*)	3,939,690	21,798
처분	(952)	(114,180)
환율변동	(40,370)	-
기말장부금액	3,935,961	51,208

(\*) 당사는 전기 중 도시바 반도체 사업의 지분투자와 관련하여 Bain Capital이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 당분기말 현재 특수목적법인인 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP에 대한 JPY 266,000백만의 출자 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited가 발행한 전환사채 JPY 129,000백만의 취득을 완료하였습니다.

## 12. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	21,322,943	16,071,281
취득	10,185,929	6,160,733
처분 및 폐기	(172,015)	(275,023)
감가상각	(3,618,895)	(2,756,754)
대체(*)	984	-
기타	-	(55,250)
기말장부금액	27,718,946	19,144,987

(\*) 당분기 중 투자부동산에서 유형자산으로 대체되었습니다.

(2) 당분기말 현재 당사의 일부 기계장치 등은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.  
(주석 30 참조)

### (3) 금융리스와 운용리스 이용내역

당분기말 현재 당사는 HANSU TECHNICAL SERVICE LTD.로부터 기계장치를 금융리스 계약을 통하여 사용하고 있습니다.

당분기말 현재 금융리스 계약에 따른 기계장치 등의 장부금액은 73,133백만원(전기말: 77,434백만원)입니다. 동 기계장치 등은 금융리스부채와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.

당사는 보유중인 기계장치 중 일부에 대하여 에스케이하이이엔지(주) 등과 운용리스계약을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 동 운용리스로 제공된 자산의 장부금액은 209,409백만원(전기말: 35,244백만원)입니다.

당분기말 현재 당사는 Macquarie Capital로부터 기계장치를 운용리스계약에 의하여 사용하고 있으며, 기간별 리스료의 지급계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)	
구 분	리스료지급액
1년 이내	161,685
1년 초과	174,086
합 계	335,771

### 13. 무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,918,259	1,546,733
취득	606,621	607,984
처분 및 폐기	(6,806)	(4,887)
상각	(377,393)	(264,164)
손상차손	(3,463)	(47)
기타	-	(277)
기말장부금액	2,137,218	1,885,342

(2) 당분기 중 개발활동과 관련하여 발생한 비용 중 개발비 인식요건을 충족하는 422,270백만원(전분기:411,424백만원)은 개발비로 자산화하였으며 연구활동과 관련하여 발생한 비용과 개발비 인식요건을 충족하지 못하는 개발활동 관련비용 1,585,558백만원(전분기:1,398,433백만원)은 경상개발비로 비용인식하였습니다.

14. 투자부동산

(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	2,468	2,573
감가상각	(68)	(79)
대체(*)	(984)	-
기말장부금액	1,416	2,494

(\*) 당분기 중 투자부동산에서 유형자산으로 대체되었습니다.

(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의 감가상각비 68백만원(전분기: 79백만원)은 전액 매출원가에 포함되어 있습니다.

(3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 248백만원(전분기:372백만원)입니다.

15. 차입금

당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
단기차입금	238,621	107,140
유동성장기차입금	530,984	307,792
유동성사채	519,728	219,836
소 계	1,289,333	634,768
비유동:		
장기차입금	2,152,362	2,077,431
사채	1,505,770	1,317,157
소 계	3,658,132	3,394,588
합 계	4,947,465	4,029,356

16. 기타유동부채 및 기타비유동부채

당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선수금	739	196
선수수익	47	81
예수금	30,384	29,767
보증예수금	-	19
계약부채	111,158	-
소 계	142,328	30,063
비유동:		
기타장기종업원급여부채	63,641	60,863
장기선수금	4,900	4,900
소 계	68,541	65,763
합 계	210,869	95,826

17. 총당부채

(1) 당분기와 전분기 중 총당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사용/대체	환 입	기 말
계약손실총당부채	7,316	5,236	-	-	12,552
판매보증총당부채	3,763	7,740	(6,251)	-	5,252
반품총당부채(*)	-	-	-	-	-
소송총당부채	9,460	5,119	(9,460)	-	5,119
배출부채	37,412	-	-	(4,685)	32,727
합 계	57,951	18,095	(15,711)	(4,685)	55,650

(\*) 반품총당부채를 기업회계기준서 제1115호의 적용으로 인하여 고객의 반품권 행사로 장래에 지출될 것이 예상되는 금액과, 당사가 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 각각 기타유동부채(계약부채)와 기타유동자산(계약자산)으로 구분하여 표시하였습니다.

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사용/대체	환 입	기 말
계약손실총당부채	163	8,329	-	-	8,492
판매보증총당부채	2,988	1,212	(226)	-	3,974
반품총당부채	16,346	98,108	(79,830)	-	34,624
소송총당부채	400	4,391	-	(400)	4,391
배출부채	26,108	4,349	(695)	-	29,762
합 계	46,005	116,389	(80,751)	(400)	81,243

(2) 계약손실총당부채

당사는 당사의 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.로부터 Wafer반제품을 구매하고 있으며, 당분기말 현재 동 종속기업이 생산 중인 재공품에 대해서 구매후 추가 가공하여 판매할 경우 예상되는 매출손실을 계약손실총당부채전입액으로 하여 매출원가에 가산하고 총당부채로 인식하고 있습니다.

(3) 판매보증충당부채

당사는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험을 등을 기초로 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

(4) 반품충당부채

당사는 전기 중 판매 후 반품이 예상되는 매출액을 합리적으로 추정하여 매출액과 매출원가에서 각각 차감하고 매출총이익에 해당하는 금액과 반품과 관련하여 발생할 것으로 예상되는 비용의 합계액을 충당부채로 인식하였습니다.

(5) 소송충당부채

당사는 소송 혹은 분쟁 등과 관련하여 경제적 효익이 내재된 자원이 유출될 가능성이 높고 그 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 그 금액을 충당부채로 인식하고 있습니다.

(6) 배출부채

당사는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

18. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	1,426,711	1,285,003
사외적립자산의 공정가치	(1,290,887)	(1,298,388)
순확정급여부채	135,824	(13,385)
확정급여부채	135,824	-
확정급여자산(*)	-	13,385

(\*) 전기말 현재 확정급여제도의 초과적립액 13,385백만원을 종업원급여자산으로 표시하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적 평가를 위해 사용된 주요 추정치는 다음과 같습니다.

구 분	당분기말(%)	전기말(%)
할인율	4.31	4.31
미래임금상승률	5.46	5.46

(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,285,003	1,157,053
당기근무원가	121,988	109,918
이자원가	40,876	34,112
관계사전출입액	976	(2,175)
퇴직급여지급액	(22,132)	(24,166)
기말장부금액	1,426,711	1,274,742

(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,298,388	859,100
이자수익	41,330	25,381
관계사전출입액	1,069	112
퇴직급여지급액	(28,767)	(23,450)
재측정요소	(21,133)	(12,521)
기말장부금액	1,290,887	848,622

(5) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용(수익)은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기근무원가	40,691	121,988	36,874	109,918
순이자원가(수익)	(146)	(454)	2,853	8,731
합 계	40,545	121,534	39,727	118,649

(6) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
예적금	1,289,598	1,297,024
기 타	1,289	1,364
합 계	1,290,887	1,298,388

한편, 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 실제수익은 각각 20,197백만원과 12,860백만원입니다.

(7) 당분기 중 확정기여형 퇴직연금제도와 관련하여 비용으로 인식된 금액은 129백만원(전분기: 48백만원)입니다.

19. 파생상품거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 파생상품은 없습니다.

(2) 당분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한 평가손익 및 거래손익은 없으며, 전분기 중 인식한 평가손익 및 거래손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)								
구 분	평가이익		평가손실		거래이익		거래손실	
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
이자율스왑	(188)	-	-	-	492	902	304	913

20. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본

(1) 당분기말 현재 당사의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금 및 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)		
구 분	당분기말	전기말
보통주 발행주식수(*)	731,530	731,530
보통주자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금:		
주식발행초과금	3,625,797	3,625,797
기 타	557,767	557,767
합 계	4,183,564	4,183,564
기타자본:		
자기주식	(2,508,427)	(771,913)
주식선택권	1,679	813
합 계	(2,506,748)	(771,100)
자기주식수	44,001	22,001

(\*) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와 발행주식 총수에 차이가 있습니다.

(2) 당분기말 현재 자기주식의 취득으로 인하여 당사의 유통주식수는 684,002천주로 감소하였습니다.

21. 기타포괄손익누계액

당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
매도가능금융자산평가손익(*)	-	(10,735)

(\*) 기업회계기준서 제1109호의 적용으로 인하여 매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류 됨에 따라, 당기 초 현재 관련 기타포괄손익누계액 (-)10,735백만원은 이익잉여금으로 재분류되었습니다.

22. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
법정적립금(*1)	178,955	108,354
임의적립금(*2)	235,506	235,506
미처분이익잉여금(*3)	36,571,789	25,368,634
합 계	36,986,250	25,712,494

(\*1) 당사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.

(\*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.

(\*3) 2018년 3월 28일자 주주총회에서 배당금 706,002백만원이 결의되었으며, 당분기 중 전액 지급하였습니다.

23. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	91,102	276,518	93,245	258,134
퇴직급여	7,410	21,994	6,311	18,906
복리후생비	17,948	53,810	14,847	43,746
지급수수료	78,661	242,169	51,081	156,039
감가상각비	28,946	79,664	20,596	59,735
무형자산상각비	108,594	326,698	103,239	232,985
운반보관비	5,317	11,336	6,961	20,248
송무비	6,408	16,253	8,567	24,948
임차료	568	1,735	599	2,564
세금과공과	1,203	4,058	1,349	4,035
교육훈련비	7,244	19,571	6,643	16,250
광고선전비	21,298	50,495	14,927	36,262
소모품비	23,993	50,932	17,013	46,798
수선비	4,804	16,545	13,316	19,287
여비교통비	2,649	6,851	2,018	5,422
판매촉진비	923	3,670	1,244	3,636
기타	7,611	28,474	5,156	31,006
소 계	414,679	1,210,773	367,112	980,001
경상개발비:				
연구개발비 총지출액	716,024	2,007,828	637,545	1,809,857
개발비 자산화	(160,376)	(422,270)	(115,819)	(411,424)
소 계	555,648	1,585,558	521,726	1,398,433
합 계	970,327	2,796,331	888,838	2,378,434

24. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기(*2)	
	3개월	누적	3개월	누적
제품 및 재공품의 변동	(207,308)	(718,258)	(504)	(344,716)
원재료, 저장품 및 소모품 사용	1,774,407	5,022,754	1,440,267	3,997,496
종업원급여	667,247	2,045,875	684,926	1,904,269
유형자산, 투자부동산, 무형자산 상각비	1,397,098	3,908,460	1,055,206	2,934,758
기술료	41,946	134,980	55,946	163,691
지급수수료	310,664	950,898	253,845	730,085
동력 및 수도광열비	245,304	670,504	199,307	575,862
수선비	165,788	509,647	203,937	540,588
외주가공비	357,381	998,589	291,933	825,690
기 타	193,053	578,159	176,001	498,689
합 계(*1)	4,945,580	14,101,608	4,360,864	11,826,412

(\*1) 분기포괄손익계산서상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

(\*2) 전분기의 비용은 당분기의 분류에 따라 재분류 되었습니다.

25. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
금융수익:				
이자수익	7,823	45,034	13,465	31,421
배당금수익	-	48,858	-	17,619
외환차이	48,508	749,626	151,275	555,347
파생상품관련이익	-	-	304	902
단기투자자산평가이익(*2)	4,744	6,160	862	1,794
단기투자자산처분이익(*2)	3,012	6,960	1,317	3,148
장기투자자산처분이익(*2)	-	248	30,945	30,945
소 계	64,087	856,886	198,168	641,176
금융비용:				
이자비용	22,778	62,940	31,228	92,994
외환차이(*1)	123,516	535,630	86,961	495,693
장기투자자산처분손실(*2)	-	-	1	1
파생상품관련손실	-	-	304	913
소 계	146,294	598,570	118,494	589,601
순금융수익(비용)	(82,207)	258,316	79,674	51,575

(\*1) 당분기 중 발생한 장기투자자산의 환율변동효과 40,370백만원이 포함되어 있습니다.

(\*2) 전분기의 장·단기투자자산 관련손익은 당분기의 분류에 따라 재분류 되었습니다.

26. 기타영업외수익과 기타영업외비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
유형자산처분이익	19,641	31,395	21,491	36,132
종속기업및관계기업투자주식처분이익	8,119	11,983	1,916	5,987
기 타	5,271	7,439	2,317	27,841
합 계	33,031	50,817	25,724	69,960

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
유형자산처분손실	5,791	67,202	2,270	15,012
무형자산처분손실	1,835	4,374	705	3,901
매출채권처분손실	314	1,283	349	1,218
기부금	6,074	33,650	2,865	24,157
무형자산손상차손	-	3,463	47	47
기 타	1,151	6,052	6,829	9,843
합 계	15,165	116,024	13,065	54,178

27. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

28. 주당이익

주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익

(단위: 백만원, 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
보통주분기순이익	4,611,144	12,011,626	2,938,555	7,248,436
가중평균유통보통주식수(*)	697,358,807	703,089,140	706,001,795	706,001,795
기본주당이익	6,612 원	17,084 원	4,162 원	10,267 원

(\*) 주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
발행주식수	728,002,365	728,002,365	728,002,365	728,002,365
자기주식 효과	(30,643,558)	(24,913,225)	(22,000,570)	(22,000,570)
가중평균유통보통주식수	697,358,807	703,089,140	706,001,795	706,001,795

(2) 희석주당이익

(단위: 백만원, 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
보통주희석분기순이익	4,611,144	12,011,626	2,938,555	7,248,436
가중평균희석유통보통주식수(*)	697,448,623	703,181,187	706,046,520	706,010,823
희석주당이익	6,611 원	17,082 원	4,162 원	10,267 원

(\*) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
가중평균유통보통주식수	697,358,807	703,089,140	706,001,795	706,001,795
주식선택권 효과	89,816	92,047	44,725	9,028
가중평균희석유통보통주식수	697,448,623	703,181,187	706,046,520	706,010,823

29. 특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와의 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
종속기업(*1)	SK hynix America Inc.외 24사
관계기업(*2)	Stratio. Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund, SK South East Asia Investment Pte. Ltd..
공동기업(*3)	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
기타특수관계자	당사에 유의적인 영향력을 행사하는 SK텔레콤(주) 및 그 종속기업과 SK텔레콤(주)의 지배기업인 SK(주)와 그 종속기업

(\*1) 종속기업인 MMT(특정금전신탁)는 제외하였습니다.

(\*2) 종속기업의 관계기업이 포함되어 있습니다.

(\*3) 종속기업의 공동기업이 포함되어 있습니다.

(2) 당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	지배기업	주요영업활동
에스케이하이이엔지(주)	당사	건설공사 및 서비스
에스케이하이텍(주)	당사	사업지원 및 서비스
행복모아(주)	당사	반도체 의류 제조 및 서비스
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	당사	반도체 제조 및 판매
SK hynix America Inc.	당사	반도체 판매
SK hynix Deutschland GmbH	당사	반도체 판매
SK hynix Asia Pte. Ltd.	당사	반도체 판매
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.	당사	반도체 판매
SK hynix U.K. Ltd.	당사	반도체 판매
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	당사	반도체 판매
SK hynix Japan Inc.	당사	반도체 판매
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	당사	반도체 판매
SK hynix Semiconductor India Pvt Ltd.	SK hynix Asia Pte. Ltd.	반도체 판매
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	당사	반도체 판매
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	당사	반도체 제조
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	SK APTECH Ltd.	반도체 제조
SK hynix Italy S.r.l	당사	반도체 연구개발
SK hynix memory solutions America Inc.	당사	반도체 연구개발
SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.	당사	반도체 연구개발
SK hynix memory solutions Eastern Europe LLC.	당사	반도체 연구개발
SK APTECH Ltd.	당사	해외투자법인
SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.	당사	해외투자법인
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외투자법인
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	해외병원자산법인
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	해외병원운영법인

(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)									
구 분	회사명	영업수익 등		영업비용 등		자산취득		배당금수익	
		3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
종속기업	국내종속기업	58,599	180,850	177,924	500,311	46,254	121,885	-	22,500
	해외판매법인	11,185,212	29,720,457	65,824	172,344	488,871	1,799,495	-	11,056
	해외제조법인(*1)	11,573	25,995	649,173	1,929,146	2,986	86,734	-	-
	해외연구개발법인	28	85	52,632	159,018	-	117	-	219
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	2,632	3,315	163,902	464,826	1,901	1,901	-	13,120
기타특수관계자	SK텔레콤㈜(*2)	14	220	3,267	157,479	3,255	5,936	-	-
	SK㈜(*3)	242	336	51,294	150,589	39,465	140,088	-	-
	ESSENCORE Limited	940	940	-	-	-	-	-	-
	SK건설㈜	76	228	-	31	579,385	1,587,302	-	-
	SK에너지㈜	192	846	11,372	49,014	-	-	-	-
	SK네트웍스㈜	-	-	542	741	-	10,600	-	-
	에스케이씨솔믹스㈜	-	-	739	3,045	194	636	-	-
	충청에너지서비스㈜	-	-	2,511	11,597	-	203	-	-
	행복나래㈜	6	18	106,108	307,929	15,462	38,207	-	-
	SK머티리얼즈㈜	-	-	14,361	40,983	-	-	-	-
	SK실트론㈜	765	2,346	45,456	126,121	-	-	-	-
기타	10	18	72,977	174,864	6,566	10,634	-	-	
합 계		11,260,289	29,935,654	1,418,082	4,248,038	1,184,339	3,803,738	-	46,895

(\*1) 해외제조법인에 대한 누적 영업수익 등에는 자산 처분액 21,921백만원(3개월 :10,325백만원)이 포함되어 있습니다.

(\*2) 영업비용 등에는 배당금 146,100백만원이 포함되어 있습니다.

(\*3) 당분기 중 발생한 SK브랜드 사용료는 45,281백만원입니다.

② 전분기

(단위: 백만원)									
구 분	회사명	영업수익 등		영업비용 등		자산취득		배당금수익	
		3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
종속기업	국내종속기업	255,318	275,691	150,688	312,665	36,717	82,871	-	-
	해외판매법인	7,723,970	19,950,122	53,059	134,004	267,742	1,197,294	-	2,494
	해외제조법인(*1)	5,219	79,115	645,292	1,787,002	4,614	9,956	-	-
	해외연구개발법인	2,253	2,593	54,528	139,711	-	-	-	297
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	260	5,726	153,585	442,061	-	-	-	14,828
기타특수관계자	SK텔레콤㈜(*2)	10	156	1,970	93,661	15,679	21,225	-	-
	SK㈜(*3)	48	146	54,029	113,819	20,926	90,699	-	-
	SK건설㈜	59	199	-	-	289,694	606,188	-	-
	SK에너지㈜	245	946	8,801	42,086	-	-	-	-
	SK네트웍스㈜	-	-	164	595	-	-	-	-
	에스케이씨솔믹스㈜	-	-	862	13,564	167	650	-	-
	충청에너지서비스㈜	-	-	1,600	11,920	-	-	-	-
	행복나래㈜	5	14	107,530	270,275	10,206	21,409	-	-
	SK머티리얼즈㈜	-	-	10,241	27,871	-	-	-	-
	SK실트론㈜	482	482	16,629	16,629	-	-	-	-
	기타	15,161	15,186	20,607	95,999	1,806	5,980	-	-
합 계		8,003,030	20,330,376	1,279,585	3,501,862	647,551	2,036,272	-	17,619

(\*1) 해외제조법인에 대한 누적 영업수익 등에는 자산 처분액 75,708백만원(3개월 : 4,006백만원)이 포함되어 있습니다.

(\*2) 영업비용 등에는 배당금 87,660백만원이 포함되어 있습니다.

(\*3) 전분기 중 발생한 SK브랜드 사용료는 25,633백만원입니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
종속기업	국내종속기업	33,854	183,681
	해외판매법인	7,544,031	612,151
	해외제조법인	124,911	546,182
	연구개발법인	27	13,567
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	1,921	109,154
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	-	4,514
	SK(주)	5,366	128,754
	SK건설(주)	28	678,863
	SK에너지(주)	33	3,383
	SK네트웍스(주)	-	3
	에스케이씨솔믹스(주)	-	1,333
	충청에너지서비스(주)	-	954
	행복나래(주)	2	22,500
	SK머티리얼즈(주)	-	14,341
	SK실트론(주)	150,675	16,680
	기타	2	60,103
합 계		7,860,850	2,396,163

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	회사명	채 권		채 무
		매출채권 등	대여금	미지급금 등
총속기업	국내총속기업(*1)	37,293	4,920	174,644
	해외판매법인	5,081,829	-	466,164
	해외제조법인	32,850	-	438,892
	해외연구개발법인	22	-	28,511
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	-	-	90,782
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	94	-	2,803
	SK(주)	5,365	-	105,960
	SK건설(주)	21	-	941,843
	SK에너지(주)	93	-	10,505
	SK네트웍스(주)	-	-	1,033
	에스케이씨솔믹스(주)	-	-	1,576
	충청에너지서비스(주)	11	-	2,127
	행복나래(주)	2	-	46,406
	SK머티리얼즈(주)	-	-	9,889
	SK실트론(주)(*2)	150,384	-	10,429
	기타	2	-	90,279
합 계		5,307,966	4,920	2,421,843

(\*1) 전기 중 행복모아(주)에 4,920백만원을 대여하였으며, 당분기 중 상환되었습니다.(\*2) 당사는 전기 중 Wafer 구매대금 150,000백만원을 선급하였습니다.(주석 30 참조)

(5) 주요 경영진에 대한 보상

당사의 주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회 의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	28,184	78,803	32,418	79,001
퇴직급여	2,631	7,821	2,167	6,621
주식보상비용	297	866	263	548
기타	4	12	3	9
합 계	31,116	87,502	34,851	86,179

(6) 당분기와 전분기 중 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	영업비용 등	
		3개월	누적
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	292	874

② 전분기

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	영업비용 등	
		3개월	누적
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	304	840

(7) 당분기말과 전기말 현재 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)		
구 분	회사명	채 무
		미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	290

② 전기말

(단위: 백만원)		
구 분	회사명	채 무
		미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK디스커버리(주)	228
	SK케미칼(주)	38
합 계		266

### 30. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 당사와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

#### ① Netlist, Inc.의 특허 침해 소송

Netlist, Inc.는 당사와 SK hynix America Inc. 등 당사의 종속기업들을 상대로 다수의 특허를 침해하였다는 소송을 2016년 8월 31일 및 2017년 6월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 9월 1일 및 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에, 2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원 및 중국 베이징 지식재산법원에 각각 제기하였습니다. 당분기말 현재 미국 등 각 지역에서 진행 중인 Netlist, Inc.의 특허 침해 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며, 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

한편, 2016년 9월 1일 미국국제무역위원회에 제기되었던 특허 침해 소송은 2018년 1월 16일 당사 및 당사의 종속기업들이 Netlist, Inc.의 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정되었습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2018년 3월 26일에 항소를 제기하였습니다.

또한, 2017년 7월 11일 중국 베이징 지식재산법원에 제기되었던 특허 침해 소송에 대하여 중국 특허심판원은 2018년 5월 30일 소송 특허가 무효임을 결정하였으며, 본결정에 따라 특허 침해 소송은 2018년 6월 26일에 기각되었습니다.

#### ② Hagens Berman의 가격 담합 집단소송

Hagens Berman(소송대리인)은 당사 및 당사의 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 가격 담합에 대한 집단소송을 2018년 4월 27일 미국 캘리포니아 북부지방법원에 제기하였습니다. 당분기말 현재 제기된 본 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

#### ③ 중국 반독점법 위반 조사

2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였습니다. 당분기말 현재 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

④ 소송 및 특허 클레임 등

당분기말 현재 당사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며 향후 자원의 유출가능성이 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

(2) 특허라이선스 계약

당사는 당분기말 현재 제품생산과 관련한 다수의 특허라이선스 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의한 Royalty는 Lump-sum royalty 및 Running royalty의 형식으로 지급되며, Lump-sum royalty 지급액은 특허라이선스 계약기간에 따라 정액으로 안분된 금액을 비용으로 처리하고 있습니다.

(3) 공업용수공급계약

당사는 베올리아워터산업개발(주) ("Veolia")와 공업용수를 공급받는 계약을 체결하고 있습니다. 기존 계약은 2018년 5월 만료되었으며, 2018년 6월부터 2023년 5월까지 5년간의 신규 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 의하면 당사는 계약기간 동안 Base Service Charge ("BSC")와 공업용수 사용량에 일정액을 적용하여 계산된 Additional Service Charge ("ASC")를 Veolia에 지급해야 합니다.

(4) HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.와 후공정서비스계약

당사는 HITECH와 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등입니다. 당사는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 금액을 지급하고 있습니다.

(5) 당분기말 현재 담보제공자산 등의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
구 분(*)	장부금액	담보설정액	비 고
기계장치	656,710	933,810	시설자금대출 관련

(\*) 상기 담보제공자산 이외에 당사의 금융리스자산은 해당 금융리스계약에 의하여 관련 금융리스부채의 담보로 제공되어 있습니다.

(6) 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)			
금융기관	약정사항	한도금액	
		통 화	금 액
KEB하나은행 등	Usance 등 수입금융약정	USD	225
	매입외환 등 수출금융약정	USD	50
	수입·수출 포괄한도약정	USD	960
	상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정	KRW	140,000

(7) 당분기말 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	금 액	비 고
종업원	5	우리사주관련 금융기관 차입금 지급보증

(8) 당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정액은 1,876,886백만원(전기말: 557,400백만원)입니다.

(9) 원재료 장기매입 약정

당사는 Wafer 공급 안정성 확보를 위하여 SK실트론(주)와 2019년부터 2023년까지 Wafer 구매계약을 체결하였으며, 전기 중 구매대금 150,000백만원을 선급하였습니다. 한편, SK실트론(주)는 당사가 선급한 150,000백만원을 보증하기 위하여 투자자산 일부를 양도담보로 제공하기로 약정하였습니다.

(10) 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)와의 약정

당사는 종속기업인 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)와 Foundry 공급계약을 체결하여 관련 서비스를 제공받고 있으며 또한, 동 회사와 업무위탁계약 및 Shared Service 계약을 체결하고, 제품 생산, 장비 운영, 개발 및 경영지원 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

31. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
분기순이익	12,011,626	7,248,436
조정항목:		
법인세비용	4,415,542	1,820,049
이자비용	62,940	92,994
이자수익	(45,034)	(31,421)
유형자산상각비	3,618,895	2,756,754
투자부동산상각비	68	79
무형자산상각비	377,393	264,164
유형자산처분손실	67,202	15,012
무형자산처분손실	4,374	3,901
무형자산손상차손	3,463	47
퇴직급여	121,534	118,649
주식보상비용	866	548
외화환산손실	162,714	24,607
파생상품관련손익	-	11
유형자산처분이익	(31,395)	(36,132)
외화환산이익	(44,325)	(180,786)
장기투자자산처분이익	(248)	(30,945)
종속기업및관계기업투자처분이익	(11,983)	(5,987)
단기투자자산평가이익	(6,160)	(1,794)
단기투자자산처분이익	(6,960)	(3,148)
배당금수익	(48,858)	(17,619)
기타	6,671	956
운전자본의 변동:		
매출채권의 감소(증가)	(2,528,261)	(1,984,671)
기타수취채권의 감소(증가)	924	8,721
재고자산의 감소(증가)	(928,834)	(499,296)
기타자산의 감소(증가)	13,574	(98,692)
매입채무의 증가(감소)	151,485	(81,638)
미지급금의 증가(감소)	72,278	(9,882)
기타지급채무의 증가(감소)	(189,990)	266,187
충당부채의 증가(감소)	(52,685)	35,238
기타부채의 증가(감소)	115,543	(11,495)
퇴직금의 지급	(8,276)	(13,556)

영업으로부터 창출된 현금	17,304,083	9,649,291
---------------	------------	-----------

(2) 당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입·유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)에 대한 영업양도	-	132,841
SK China Company Limited에 대한 현물출자	-	143,208

(3) 당분기와 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초	4,029,356	4,215,787
재무적 현금으로 인한 변동		
- 차입금의 차입	2,402,196	685,084
- 차입금의 상환	(1,535,341)	(633,531)
환율변동효과	50,062	(91,519)
상각(이자비용)	1,192	1,312
기말	4,947,465	4,177,133

### 32. 주식기준보상

(1) 당사는 당분기 중 당사의 주요 경영진에게 주식결제형 주식선택권을 부여하였으며, 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)								
구 분	총부여수량	소멸수량	행사수량	미행사수량	부여일	약정유효제공기간	행사가능기간	행사가격
1차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2019.03.24	2019.03.25 ~ 2022.03.24	48,400원
2차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2020.03.24	2020.03.25 ~ 2023.03.24	52,280원
3차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2021.03.24	2021.03.25 ~ 2024.03.24	56,460원
4차	7,747	-	-	7,747	2018.01.01	2018.01.01 ~ 2019.12.31	2020.01.01 ~ 2022.12.31	77,440원
5차	7,223	-	-	7,223	2018.03.28	2018.03.28 ~ 2020.03.28	2020.03.29 ~ 2023.03.28	83,060원
합 계	313,770	-	-	313,770				

### (2) 공정가치 측정

이항모형을 적용하여 공정가액 접근법에 의한 보상원가를 산정하였으며, 주식결제형주식기준보상제도의 부여일 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분	기대주가변동성	부여일 공정가치	배당수익률	무위험이자율 (국공채 수익률)
1차	23.23%	10,026원	1.20%	1.86%
2차	23.23%	9,613원	1.20%	1.95%
3차	23.23%	9,296원	1.20%	2.07%
4차	22.50%	16,687원	0.78%	2.38%
5차	25.30%	18,362원	1.23%	2.46%

(3) 당사가 당분기 중 인식한 주식보상비용은 866백만원(전분기: 548백만원)입니다.

## 6. 기타 재무에 관한 사항

### 가. 부문별 연결재무정보

#### (1) 사업부문별 연결재무정보

당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하여 지배적 단일사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 지역별 재무 정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 71기 3분기	제 70기	제 69기
본국(대한민국)			
1. 매출액			
외부매출액	717,143	1,207,464	1,099,426
지역간내부매출액	30,474,949	29,311,067	16,061,704
계	31,192,092	30,518,531	17,161,131
2. 영업이익	16,298,432	13,366,065	3,020,730
3. 자산	57,075,975	44,910,780	31,527,834
중국			
1. 매출액			
외부매출액	11,904,846	10,074,686	5,960,235
지역간내부매출액	2,165,072	2,555,178	2,482,175
계	14,069,918	12,629,864	8,442,411
2. 영업이익	213,433	146,098	129,972
3. 자산	8,235,082	6,338,929	5,242,887
아시아			
1. 매출액			
외부매출액	5,841,087	6,201,365	3,897,774
지역간내부매출액	7,588	21,078	23,131
계	5,848,675	6,222,443	3,920,906
2. 영업이익	770	14,239	9,771
3. 자산	2,431,570	1,847,516	911,664
미국			
1. 매출액			
외부매출액	10,608,980	11,063,504	5,397,943
지역간내부매출액	92,279	158,153	124,781
계	10,701,259	11,221,657	5,522,725
2. 영업이익	(38,431)	52,994	38,260
3. 자산	3,493,950	2,619,480	1,656,389
유럽			
1. 매출액			
외부매출액	1,434,930	1,562,416	842,595
지역간내부매출액	53,306	19,660	26,101
계	1,488,236	1,582,076	868,697
2. 영업이익	(20)	5,393	2,213

3. 자산	623,891	442,627	237,834
합계			
1. 매출액			
외부매출액	30,506,985	30,109,434	17,197,975
지역간내부매출액	32,793,194	32,065,137	18,717,894
계	63,300,180	62,174,571	35,915,868
2. 영업이익			
연결조정	(60,508)	136,537	75,799
계	16,413,676	13,721,326	3,276,746
3. 자산			
연결조정	(14,483,217)	(10,740,868)	(7,360,582)
계	57,377,252	45,418,464	32,216,026

## 나. 대손충당금 설정현황

### (1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정비율
제71기 3분기	매출채권	7,711,394	47	0.00%
	장·단기 대여금	30,127	0	0.00%
	장·단기 미수금	8,952	1,324	14.79%
	장·단기 미수수익	2,758	0	0.00%
	장·단기 보증금	44,420	102	0.23%
	장기성 외상매출금	0	0	
	장단기성 예치금	219	0	0.00%
	<b>계</b>	<b>7,797,870</b>	<b>1,472</b>	<b>0.02%</b>
제70기 연간	매출채권	5,552,841	46	0.00%
	장·단기 대여금	13,984	0	0.00%
	장·단기 미수금	12,199	1,327	10.88%
	장·단기 미수수익	22,308	0	0.00%
	장·단기 보증금	32,814	102	0.31%
	장기성 외상매출금	0	0	
	장단기성 예치금	1,132	985	87.00%
	<b>계</b>	<b>5,635,278</b>	<b>2,460</b>	<b>0.04%</b>
제69기 연간	매출채권	3,253,489	1,837	0.06%
	장·단기 대여금	9,163	10	0.11%
	장·단기 미수금	13,003	1,371	10.55%

	장·단기 미수수익	9,732	0	0.00%
	장·단기 보증금	34,812	389	1.12%
	장기성 외상매출금	0	0	-
	장단기성 예치금	1,238	1,077	86.96%
	<b>계</b>	<b>3,321,437</b>	<b>4,684</b>	<b>0.14%</b>

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제71기 3분기	제70기	제69기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	2,460	4,684	10,550
2. 순대손처리액(① - ② ± ③)	0	0	306
① 대손처리액(상각채권액)		0	306
② 상각채권회수액	0	0	0
③ 기타증감액		0	0
3. 대손상각비 계상(환입)액	(988)	(2,224)	(5,560)
4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,472	2,460	4,684

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

- 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정

구분	설정 기준	
매출채권	1)정상채권	-.과거 경험률을 바탕으로 설정
	2)장기채권	-.거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정 -.담보 설정금액 有 => 회수가능성이 불확실한 경우 담보 미설정 부분 100% 설정 -.담보 설정금액 無 => 회수가능성이 불확실한 경우 100% 설정

\* 연결대상회사 매출채권 충당금 설정 제외

(4) 당 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	일반	7,645,679	0	0	4	7,645,684
	특수관계자	65,711			0	65,711
	계	7,711,390	0	0	4	7,711,394

구성비율	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
------	--------	------	------	------	------

## 다. 재고자산 현황 등

### (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제71기 3분기	제70기	제69기	비고
반도체	제품	876,788	433,405	391,503	-
	재공품	1,968,666	1,616,889	1,130,494	-
	원재료	398,856	296,252	260,677	-
	저장품	401,602	270,804	194,678	-
	미착품	40,828	23,089	48,847	-
	합 계	3,686,740	2,640,439	2,026,198	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]		6.4%	5.8%	6.3%	-
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		4.6회	5.4회	5.5회	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

### (2) 재고자산의 실사내역

실사내역	실사 일자	입회자	비고
제품	2018-01-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2017-01-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2016-01-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-

### (3) 장기체화재고 등 내역

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2018년 3분기말 현재 재고자산에 대한 평가 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가총당금	당기말잔액	비고
제 품	980,231	980,231	103,443	876,788	-
재공품	1,996,716	1,996,716	28,050	1,968,666	-
원재료	409,889	409,889	11,033	398,856	-
저장품	418,230	418,230	16,629	401,602	-
미착품	40,828	40,828		40,828	-
합 계	3,845,895	3,845,895	159,155	3,686,740	-

## 라. 공정가치

### (1) 공정가치 평가방법

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

### (2) 공정가치 평가내역

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

#### ① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	2,946,807	-	2,946,807	-	2,946,807
장기투자자산	4,005,499	-	-	4,005,499	4,005,499
소 계	6,952,306	-	2,946,807	4,005,499	6,952,306
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*)	2,340,357	-	-	-	-
단기금융상품(*)	388,229	-	-	-	-
매출채권(*)	7,711,347	-	-	-	-
기타수취채권(*)	85,051	-	-	-	-
기타금융자산(*)	173	-	-	-	-
소 계	10,525,157	-	-	-	-
금융자산 합계	17,477,463	-	2,946,807	4,005,499	6,952,306
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*)	795,675	-	-	-	-

미지급금(*)	3,204,547	-	-	-	-
기타지급채무(*)	1,133,619	-	-	-	-
차입금	4,977,378	-	4,979,915	-	4,979,915
금융부채 합계	10,111,219	-	4,979,915	-	4,979,915

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기투자자산	929,801	-	929,801	-	929,801
장기투자자산	43,226	-	-	43,226	43,226
소 계	973,027	-	929,801	43,226	973,027
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*)	2,949,991	-	-	-	-
단기금융상품(*)	4,674,862	-	-	-	-
매출채권(*)	5,552,795	-	-	-	-
기타수취채권(*)	80,023	-	-	-	-
기타금융자산(*)	273	-	-	-	-
소 계	13,257,944	-	-	-	-
금융자산 합계	14,230,971	-	929,801	43,226	973,027
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*)	758,578	-	-	-	-
미지급금(*)	2,724,547	-	-	-	-
기타지급채무(*)	1,343,637	-	-	-	-
차입금	4,171,270	-	4,178,598	-	4,178,598
금융부채 합계	8,998,032	-	4,178,598	-	4,178,598

(\*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

③ 가치평가기법

수준 2 및 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3 간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)					
구 분	기 초(*)	취 득	처 분	환율변동	당분기말
장기투자자산	43,226	4,002,669	(953)	(39,443)	4,005,499

(\*) 전기말 동일한 상품(즉, 수준 1의 투입변수)에 대한 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 지분상품에 해당하여 다른 방법으로 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로, 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 원가로 측정 한 매도가능금융자산 29,700백만원이 포함되어 있습니다.

마. 채무증권 발행실적 등

[연결 기준이며, 별도 기준은 연결 기준과 동일]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면 총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
SK하이닉스(주)	회사채	사모	2012년 05월 30일	550,000	5.35	A (한신평)	2019년 05월 30일	일부상환	삼성증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 08월 26일	210,000	2.27	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2020년 08월 26일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 08월 26일	140,000	2.63	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2022년 08월 26일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	70,000	2.26	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2018년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	100,000	2.56	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2020년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	10,000	2.75	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2022년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	180,000	2.22	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2021년 02월 19일	미상환	엔에이치투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	80,000	2.53	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 02월 19일	미상환	엔에이치투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 05월 27일	150,000	2.30	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2021년 05월 27일	미상환	엔에이치투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2018년 03월 14일	300,000	3.01	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 03월 14일	미상환	엔에이치투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2018년 08월 27일	250,000	2.48	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 08월 27일	미상환	케이비증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2018년 08월 27일	90,000	2.67	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 08월 27일	미상환	케이비증권
합 계	-	-	-	2,130,000	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제214-1회 무보증원화 공모사채	2015년 08월 26일	2020년 08월 26일	210,000	2015년 08월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제214-2회 무보증원화 공모사채	2015년 08월 26일	2022년 08월 26일	140,000	2015년 08월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행(31.67%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

	이행현황	이행(1.95%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.1조원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	-
	이행현황	-
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018. 9월 제출

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사 및 검토의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제215-1회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2018년 11월 25일	70,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제215-2회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2020년 11월 25일	100,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제215-3회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2022년 11월 25일	10,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행(31.67%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행(1.95%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.1조원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	-
	이행현황	-
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018. 9월 제출

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사 및 검토의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리	사채관리회사
-----	-----	-----	-----	------	--------

				계약체결일	
제216-2회 무보증원화 공모사 채	2016년 02월 19일	2021년 02월 19일	180,000	2016년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리 팀 (02-3770-8556)
제216-3회 무보증원화 공모사 채	2016년 02월 19일	2023년 02월 19일	80,000	2016년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리 팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행(31.67%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행(1.95%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.1조원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	-
	이행현황	-
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018. 9월 제출

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사 및 검토의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

#### 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제217-2회 무보증원화 공모사 채	2016년 05월 27일	2021년 05월 27일	150,000	2016년 05월 17일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리 팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지
	이행현황	이행(31.67%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행(1.95%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.1조원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	-
	이행현황	-
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018. 9월 제출

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사 및 검토의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제218회 무보증원화 공모사 채	2018년 03월 14일	2023년 03월 14일	300,000	2018년 02월 28일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지
	이행현황	이행(31.67%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하
	이행현황	이행(1.95%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 70% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.2%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	-
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018. 9월 제출

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사 및 검토의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제219-1회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2023년 08월 27일	250,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)
제219-2회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2025년 08월 27일	90,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행(31.67%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행(1.95%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.2%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	보고기한 미 도래
--------------	------	-----------

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사 및 검토의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

### 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

### 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	70,000	210,000	430,000	140,000	640,000	90,000	-	1,580,000
	사모	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000
	합계	520,000	210,000	430,000	140,000	640,000	90,000	-	2,030,000

### 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

### 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## IV. 감사인의 감사의견 등

### 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제71기 3분기(당기)	삼정회계법인	-	-
제70기(전기)	삼정회계법인	적정	-
제69기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

### 2. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간
제71기(당기)	삼정회계법인	- 분반기 검토(연결, 별도) - 재무제표감사(연결, 별도)	950	6,522 (주)
제70기(전기)	삼정회계법인	- 분반기 검토(연결, 별도) - 재무제표감사(연결, 별도)	950	10,644
제69기(전전기)	삼정회계법인	- 분반기 검토(연결, 별도) - 재무제표감사(연결, 별도)	705	10,256

(주) 표기의 시간은 제71기 3분기(18.01.01~18.09.30)에 해당하는 소요 시간임

### 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제71기 3분기(당기)	2018.05.24	이전가격 문서화 용역	2018.05~2018.12	145	-
	2018.02.27	지속경영 프로그램 자문 용역	2018.02~2018.07	300	-
제70기(전기)	2017.08.03	이전가격 문서화 용역	2017.08~2018.12	150	-
	2017.07.19	지속경영 프로그램 자문 용역	2017.07~2017.08	100	-
제69기(전전기)	2016.04.25	세무 자문 용역	2016.04~2017.03	170	-
	2016.03.31	이전가격 문서화 용역	2016.03~2017.03	60	-
	2016.02.02	세무 자문 용역	2016.02~2016.12	20	-

## V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시 작성기준에 따라 분/반기보고서에 본 항목은 기재하지 않습니다.

# VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 1. 이사회에 관한 사항

### 가. 이사회구성의 개요

본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 5인의 사외이사 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 지속경영위원회 3개의 소위원회가 있습니다.

#### (1) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회는 법령과 회사 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 또한 이사 및 경영진의 직무집행을 감독할 수 있는 권한이 있습니다.

##### 1. 상법상의 결의사항

- (1) 주주총회의 소집
- (2) 영업보고서의 승인
- (3) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인
- (4) 대표이사의 선임 및 해임
- (5) 공동대표의 결정
- (6) 지점의 설치, 이전 또는 폐지
- (7) 신주의 발행
- (8) 사채의 모집
- (9) 준비금의 자본전입
- (10) 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행
- (11) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
- (12) 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임
- (13) 주식매수선택권의 부여 및 취소
- (14) 감사위원회를 제외한 위원회의 결의에 대한 수정 결의
- (15) 소규모 주식교환
- (16) 소규모합병 및 소규모분할합병
- (17) 회사 자산 및 매출액의 10분의 1 이하 규모의 영업양도의 결정
- (18) 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
- (19) 지배인의 선임 및 해임

##### 2. 회사 경영에 관한 중요사항

- (1) 주주총회에 부의할 의안
- (2) 사업의 계획과 운영에 관한 사항
- (3) 회사의 예산·결산
- (4) 회사 자기자본 1.5%에 해당하는 금액 또는 1,000억원 중 많은 금액 이상의 신 규투자

계획, 차입(1년 이내의 단기 차입 제외), 채무의 보증, 출자, 자산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 (단, 자기 자본이라 함은 유가증권시장 공시규정상 자기자본을 의미함)

- (5)<삭제 2012.3.5>
- (6) 해외증권의 발행
- (7) <삭제1999.4.9>
- (8) 각 위원회 규정 및 대표이사 위임사항의 제정, 개정 및 폐지
- (9)<삭제 2012.3.5>
- (10) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인사항으로 정한 자본금 또는 자본총계 중 큰 금액의 5% 이상이거나 50억원 이상에 해당하는 다음의 행위
  - 단, 감사위원회에 3인 이상의 사외이사가 포함되고 사외이사 수가 위원 총수의 3분의 2 이상인 경우 감사위원회에 그 의결을 위임함
  - 가. 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래
  - 나. 분기 거래 합계액을 기준으로 동일인 및 동일인 친족이 20% 이상을 출자한 회사 또는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동 회사를 위하여 상품·용역을 제공 또는 거래
- (11) 회사 경영기본이념의 실행을 위한 회사 경영관리 체계의 정립 및 수정
- (12) 10억원 이상의 기부. 단, 지속경영 및 사회적 가치 창출 등에 대해 전문적으로 심의하는 위원회가 있는 경우 해당 위원회에서 사전 심의함. 그러나, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급구호와 “사회복지공동모금회법”에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있음

3. 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

(2) 사외이사 현황

(성명, 학력 및 경력, 최대주주등과의 이해관계, 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 등)

[기준일 : 2018년 9월 30일]

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고
최종원	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기재부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수(現)	해당사항 없음		2017. 3. 24 재선임
신창환	고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 근무 Xilinx 근무 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수(現)	해당사항 없음		2017. 3. 24 선임

송 호 근	서울대 사회학 미국 하버드대 대학원 사회학 박사 한림대 부교수 서울대 사회발전연구소 소장 감사원 자문위원 서울대 대외협력본부장 사회통합위원회 위원 헌법재판소 정책자문위원 중앙일보 칼럼니스트 서울대 사회과학대 교수 서울대 석좌교수 중앙일보 기명칼럼니스트 (現) 포스코청암재단 감사위원 (現) 포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수 / 학부장 (現)	해당사항 없음	2018년 신임 이사 오리엔테이션	2018. 3. 28 선임
조 현 재	한국외국어대 서반어학 매일경제신문 편집국장 매경닷컴 대표이사 겸 뉴미디어담당 매일경제TV 대표이사 MBN 보도본부 본부장 MBN 대표이사 한국법무보호복지공단 비상임이사 (現) 광주대 초빙교수 (現)	해당사항 없음	2018년 신임 이사 오리엔테이션	2018. 3. 28 선임
윤 대 화	연세대 경영학 연세대 대학원 경영학 박사 안권 회계법인 공인회계사 한국금융연수원 교수 한국세무학회 제24대 회장 한국회계정보학회 제25대 회장 국무총리 조세심판원 비상임심판관 (現) 한국고용정보원 비상임감사 (現) 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원 (現) 가천대 경영학과 교수 (現)	해당사항 없음	2018년 신임 이사 오리엔테이션	2018. 3. 28 선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 이사회사무국 (담당자 : 노형구 수석 031-8093-4315)

### (3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함	
개최시기	정기 이사회	매분기 종료 후 45일 내에 개최함
	임시 이사회	필요에 따라 수시로 개최함
소집권자	이사회 의장	
소집절차	회의일 2일전까지 각 이사에게 개최 시기, 장소 및 안건을 통지함. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있다	
결의방법	이사 과반수의 출석과 과반수의 찬성으로 함. 그러나, 법령 또는 정관으로 그 비율을 높게 정한 경우에는 법령 또는 정관의 규정을 따름	
부의사항	상법, 정관 및 이사회 규정에서 정하는 회사에 관한 중요사항	

위 임	<p>다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 이사회내 위원회에 위임할 수 있음</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 주주총회 승인을 요하는 사항의 제안</li> <li>2. 대표이사의 선임 및 해임</li> <li>3. 위원회 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임</li> <li>4. 정관에서 위원회에 위임할 수 없음을 명시한 사항</li> </ol> <p>전항에 의하여 이사회가 이사회내 위원회에 위임할 사항은 해당 위원회 규정에서 정한다.</p>
의 사 록	<p>이사회 의사에 관하여 의사록을 작성함 (의사록에는 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명함)</p>

## 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 참석									
				김두경 (출석률 :100%)	박영준 (출석률 :100%)	김대일 (출석률 :100%)	이창양 (출석률 :100%)	최종현 (출석률 :100%)	신창환 (출석률 :100%)	송호근 (출석률 :100%)	조현재 (출석률 :100%)	윤태화 (출석률 :100%)	
1	'18.01.24	1. 제70기(2017년) 재무제표(안)	가결	찬성	-	-	-						
		2. 제70기(2017년) 영업보고서(안)	가결	찬성	-	-	-						
		3. 2018년 경영계획(안)	가결	찬성	-	-	-						
2	'18.02.28	1. 제70기 정기주주총회 소집(안)	가결	찬성	-	-	-						
		2. 2018년 상반기 원화 사채 발행 위임(안)	가결	찬성	-	-	-						
		3. 외화 자금 차입(안)	가결	찬성	-	-	-						
3	'18.03.28	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 대표이사 선임의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 이사회규정 개정(안)	수정가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 선임사외이사 선임의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		5. 지속경영위원회 설치(안) 및 각 위원회 위원 선임의 건	수정가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	'18.04.25	1. 한국고등교육재단 등에 대한 기부금 출연(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. SK건설과의 거래(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. SK에어가스와의 거래(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	'18.05.23	1. SK텔레콤과의 거래(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. SHE분야 재단 신설 및 출연(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	'18.07.25	1. 2018년 하반기 원화 사채 발행 위임(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. SK텔레콤 등과의 거래(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 2018년 수정경영계획(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	'18.07.27	1. 신규FAB 건설 계획(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. SK건설과의 거래(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 자기주식 취득(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	'18.09.19	1. 대중소형투자재단에 대한 기부금 출연(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. SK건설과의 거래(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	'18.10.24	1. 최종현학술원에 대한 기부금 출연(안)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 김두경, 박영준, 김대일, 이창양 사외이사의 경우, 제70기 정기 주주총회(18.03.28) 일자로 임기 만료됨.

※ 송호근, 조현재, 윤태화 사외이사의 경우, 제70기 정기 주주총회(18.03.28)에서 신규 선임됨.

이사의 자기거래에 해당하는 이사회 승인사항은 하기와 같습니다.

대상회사	이사	결의일자	거래 내역
SK텔레콤 등	박정호	2018년 5월 23일	그룹 업무용 항공기 이용에 따른 공동관리 비용 분담
		2018년 7월 25일	그룹 공동 R&D 과제 추진 관련 비용 분담, 청년희망나눔 프로그램 운영, 기업전화 서비스

### 다. 이사회내 위원회

#### (1) 이사회내의 위원회 구성현황

[2018년 9월 30일 현재]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 3명	최종원 윤대화 신창환	"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조	-
사외이사후보 추천위원회	사외이사 2명 사내이사 1명	최종원 조현재 박성욱	"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조	-
지속경영위원회	사외이사 2명 사내이사 1명	송호근 조현재 이석희	[권한] 1. 10억원 이상의 기부 심의. 단, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급 구호와 "사회복지공동모금회법"에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있음 2. 회사의 지속가능경영과 관련한 다음 사항들에 대한 심의 (1) 지속경영 및 사회적 가치 창출 전략 및 성과 (2) 주요 CSR(Corporate Social Responsibility) 활동 (3) 주요 ESG(Environmental, Social, Governance) 현황 및 대응 (4) 기타 위원회에서 지속경영과 관련하여 심의할 필요가 있다고 판단하여 위원회에 부의한 사항	-

#### (2) 이사회내의 위원회 활동내역

##### (가) 감사위원회

"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조

##### (나) 사외이사후보추천위원회

"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조

##### (다) 지속경영위원회

개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명	
			송호근	조현재

			(출석률: 100%)	(출석률: 100%)
			찬 반 여부	
'18.04.23	1. 지속경영위원회 역할 및 연간 일정	보고	-	-
	2. 그룹 사회적가치 추진 방향	보고	-	-
	3. 그룹 사회공헌 기부금 출연(안)	보고	-	-
	4. 핸드볼 발전재단 기부금 출연(안)	보고	-	-
	5. SHE분야 재단 설립(안)	보고	-	-
	6. 실버홀 프로젝트 추진(안)	보고	-	-
	7. 위원장 선임의 건	의결	찬성	찬성
'18.06.25	1. SHE재단('숲과나눔') 설립 경과	보고	-	-
	2. 사회공헌 기여 현황	보고	-	-
	3. 2018년 지속경영보고서 발간	보고	-	-
	4. ESG 진단 결과 및 추진 과제	보고	-	-
'18.10.05	1. 최종현학술원에 대한 기부금 출연(안)	보고	-	-
	2. Infra공유를 통한 국내 반도체 생태계 경쟁력 강화	보고	-	-
	3. SK하이닉스 지속경영전략체계 수립(안)	보고	-	-

## 라. 이사의 독립성

당사의 이사는 총 8인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 5명입니다. 사외이사 선임에 있어 상법 및 관계법상의 자격 기준과 이사직무수행 적합성을 위한 전문성 및 독립성 등에 기반하여 투명하고 공정한 사외이사 후보추천위원회의 엄격한 심사와 추천을 통해 주주총회에서 선임하고 있습니다.

또한, 사외이사 회의를 주재하고 사외이사들의 의견을 집약하기 위하여 선임사외이사를 선임하였습니다.

### (1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 경영참고사항 비치·공시 시(2018. 02. 28) 이사 후보에 대한 인적사항 공시  
[2018년 9월 30일 현재]

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래내역	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고
박성욱 (1958.01.08)	하이닉스반도체 메모리 연구소장/전무 SK하이닉스 부사장 SK하이닉스 사장 SK하이닉스 대표이사 부회장(現)	이사회	전사 경영전반 총괄	없음	해당사항 없음	이사회 의장/ 사외이사후보 추천위원회 위원
이석희 (1965.06.23)	Intel 근무 KAIST 교수 SK하이닉스 미래기술연구원장 SK하이닉스 DRAM개발부문장/부사장 SK하이닉스 사업총괄 사장 (現)	이사회	전사 경영전반 총괄	없음	해당사항 없음	지속경영위원회 위원

박정호 (1963.05.17)	SK텔레콤(주) 사업개발부문장 SK C&C(주) 대표이사/사장 SK(주) 대표이사/사장 SK텔레콤(주) 대표이사/사장 (現)	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	최대주주의 임원 (SK텔레콤)	-
최종원 (1958.10.28)	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기재부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수 (現)	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당사항 없음	감사위원회 위원/ 사외이사후보 추천위원회 위원/ 선임사외이사
신창환 (1979.11.23)	고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 근무 Xilinx 근무 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 (現)	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당사항 없음	감사위원회 위원
송호근 (1956.01.04)	서울대 사회학 미국 하버드대 대학원 사회학 박사 한림대 부교수 서울대 사회발전연구소 소장 감사원 자문위원 서울대 대외협력본부장 사회통합위원회 위원 헌법재판소 정책자문위원 중앙일보 칼럼니스트 서울대 사회과학대 교수 서울대 석좌교수 중앙일보 기명칼럼니스트 (現) 포스코청암재단 감사위원 (現) 포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수 / 학부장 (現)	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당사항 없음	지속경영위원회 위원
조현재 (1958.01.21)	한국외국어대 서반어학 매일경제신문 편집국장 매경닷컴 대표이사 겸 뉴미디어담당 매일경제TV 대표이사 MBN 보도본부 본부장 MBN 대표이사 한국법무보호복지공단 비상임이사 (現) 광주대 초빙교수 (現)	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당사항 없음	지속경영위원회 위원 사외이사후보 추천위원회 위원

윤태화 (1960.10.27)	연세대 경영학 연세대 대학원 경영학 박사 안권 회계법인 공인회계사 한국금융연수원 교수 한국세무학회 제24대 회장 한국회계정보학회 제25대 회장 국무총리 조세심판원 비상임심판관 (現) 한국고용정보원 비상임감사 (現) 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원 (現) 가천대 경영학과 교수 (現)	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당사항 없음	감사위원회 위원
---------------------	--	-----------------	-------------------	----	---------	----------

성명	선임 배경
최종원	서울대학교 행정대학원 교수로서 동 대학 행정대학원장과 KDI 연구위원, 공정거래위원회 비상임위원 및 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 등을 역임한 경제 분야에 대한 전문가로, 회사 경영 및 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단
신창환	서울시립대학교 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수로 나노스케일 반도체 소자 및 회로, 실리콘 이후의 차세대기술에 관련된 연구를 해온 반도체 및 전자산업 분야의 전문가로서 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단
송호근	서울대학교 사회과학대 교수 및 동 대학 석좌교수로서 헌법재판소 정책자문위원과 감사원 자문위원을 역임한 사회학 분야 최고 권위자로, 사회정책 다방면의 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에게 제공하여 향후 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단
조현재	매일경제신문 편집국장, 매일경제TV 대표이사과 MBN 대표이사를 역임한 경제 및 산업전문가로, 오랜 기간 언론계 활동을 통해 정치, 경제, 산업, 국제정세 등 여러 현안에 폭넓은 식견을 보유하고 있어 향후 회사 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단
윤태화	현재 가천대학교 경영대학 학장 및 교수로서, 공인회계사 자격을 보유하고 안권 회계법인에 재직 및 한국세무학회 회장을 역임한 회계전문가이며, 한국고용정보원 비상임감사 및 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원 등으로 활동하면서 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영의사결정이 보다 투명하게 이루어지는데 기여할 수 있을 것으로 판단

## (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

### (가) 사외이사후보추천위원회 설치목적 및 권한사항

[설치목적]

관계법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하고 심사함.

[권한]

① 사외이사 후보의 추천, 심사, 선정

### (나) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

[2018년 9월 30일 현재]

성명	사외이사 여부	비고
최종원	○	- 사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8항 충족)
조현재	○	
박성욱	X	

(다) 사외이사후보추천위원회 활동내역

개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명	
			박영준 (출석률:100%)	최종원 (출석률:100%)
			찬 반 여 부	
'18.02.26	1. 제70기 정기주주총회에 대한 사외이사후보추천(안)	가결	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직의 현황

지원조직	구성	주요담당업무
이사회사무국	구성원 3명 (팀장 1명 포함)	- 이사회 및 소위원회 지원 - 이사직무활동 지원

(2) 사외이사 교육실적

교육일시	교육내용	교육주체
2018.04.13.	2018년 신임 이사 오리엔테이션	SK하이닉스

2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있으며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사위원이 되는 사외이사 3인(최종원, 신창환, 윤태화)으로 구성되어 있습니다.

가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

- 설치 여부 : 감사에 갈음하는 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치(정관 제48조)
- 권한과 책임 : 회계 및 업무에 대한 감사, 외부감사인의 선임 등
- 구성 방법 : 3인 이상의 이사로 구성(단 위원 총수의 2/3 이상을 사외이사로 구성)  
위원장은 호선에 의하여 선임
- 회의 : 정기 위원회(매 분기 종료 후 45일 이내) 및 임시 위원회(필요에 따라 수시로)

나. 감사위원회의 인적사항

[2018년 9월 30일 현재]

성명	주요경력	결격요건 여부	비고
최종원	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기재부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수 (現)	해당사항 없음	
신창환	고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 근무 Xilinx 근무 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 (現)	해당사항 없음	
윤태화	연세대 경영학 연세대 대학원 경영학 박사 안권 회계법인 공인회계사 한국금융연수원 교수 한국세무학회 제24대 회장 한국회계정보학회 제25대 회장 국무총리 조세심판원 비상임심판관 (現) 한국고용정보원 비상임감사 (現) 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원 (現) 가천대 경영학과 교수 (現)	해당사항 없음	

#### 다. 감사위원회의 위원의 독립성

당사는 감사위원회 3인 전원을 사외이사로 구성하고 있으며, 3인 중 최소 1인 이상의 회계 또는 재무전문가를 선임하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 아래와 같이 마련하고 있습니다.

- 감사위원회 규정 제3조

③ 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제12조(부의사항)

3. 감사에 관한 사항

- (1) 업무·재산 조사
- (2) 자회사의 조사
- (3) 이사의 보고 수령

(7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

(8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

- 감사위원회 규정 제13조 (관계인의 출석)

- ① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 경영진, 재무담당임원, 내부감사부서의 장 및 외부감사인 등을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다.
- ② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제14조의7 (의견교환)

위원회는 감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 감사인과 회사의 내부통제제도 및 회사 재무제표의 정확성 등에 관하여 의견을 교환할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제16조 (내부감사부서의 설치)

- ① 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 위원회를 보조하는 전담 지원부서를 설치 운영하거나 회사의 내부감사부서를 활용할 수 있다.
- ② 전담 지원부서 또는 내부감사부서의 장은 위원회의 명을 받아 회사 또는 자회사의 업무 또는 재산상태 등을 조사할 수 있다.

**라. 감사위원회의 주요활동내역**

회사	일자	의 안	가결여부	사외이사의 성명					
				김두경 (출석률 :100%)	김대일 (출석률 :100%)	이창양 (출석률 :100%)	최종원 (출석률 :100%)	신창환 (출석률 :100%)	윤대화 (출석률 :100%)
				찬반여부					
1	'18.01.22	1. '17년 내부회계관리제도 운영 실태	보고	-	-	-	-	-	-
		2. '17년 내부감사실적 및 '18년 업무 계획	보고	-	-	-	-	-	-
		3. 내부감사부서책임자 임명에 대한 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2	'18.02.26	1. 2017년 회계연도 회계감사 결과	보고	-	-	-	-	-	-
		2. 계열금융회사(SK증권)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		3. SK네트웍스와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		4. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
3	'18.03.19	1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		2. 제7기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		3. 감사보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		4. 내부감사장치에 대한 의견서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		5. SK(주)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
4	'18.04.23	1. 2018년 1분기 윤리경영 및 경영진단 실적	보고	-	-	-	-	-	-
		2. 위원장 선임의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성
		3. SK이노베이션과의 거래(안)	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성
5	'18.06.25	1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안)	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성
		2. SK(주)와의 거래(안)	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성
6	'18.07.23	1. 2018년 상반기 재무결산 실적	보고	-	-	-	-	-	-
		2. 2018년 상반기 내부감사 실적 및 하반기 업무 계획	보고	-	-	-	-	-	-
		3. 외부회계감사 업무 수행 계획	보고	-	-	-	-	-	-
7	'18.09.17	1. SK(주)와의 거래(안)	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성
8	'18.10.22	1. 내부감사 실적 및 향후 계획	보고	-	-	-	-	-	-

※ 김두경, 김대일, 이창양 사외이사의 경우, 제70기 정기 주주총회(18.03.28) 일자로 임기 만료됨.

※ 윤태화 사외이사의 경우, 제70기 정기 주주총회(18.03.28)에서 신규 선임됨.

#### 마. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

구 분	상 세
성 명	신승국 (전무)
생 년 월 일	1962년 11월 3일
학 력 사 항	- 연세대학교 대학원 상법학 석사 (1985년~1987년) - 미국 밴더빌트대 법과대학원 법학박사 (J.D.)
주 요 경 력	- 2017년 1월 ~ : SK하이닉스 지속경영본부장(現) - 2014년 1월 ~ : SK하이닉스 대외협력본부장 - 2006년 2월 ~ : SK에너지 법무실장 / CR전략실장 - 2000년 8월 ~ : SK텔레콤 법무팀장 / 법무실장 - 1988년 7월 ~ : SK(舊유공) 법제부 입사
주 요 자 격	- 미국 뉴욕주 변호사

### 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있으며, 집중투표제나 서면투표제, 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다. 또한 본 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

## VII. 주주에 관한 사항

### 1. 최대주주 등에 관한 사항

#### 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
에스케이텔레콤(주)	최대주주	보통주	146,100,000	20.07	146,100,000	20.07	유상증자 참여/구주지분 인수
박성욱	특별관계자	보통주	1,502	0.00	1,502	0.00	-
박정호	특별관계자	보통주	1,090	0.00	1,090	0.00	-
이석희	특별관계자	보통주	42	0.00	42	0.00	-
계		보통주	146,102,634	20.07	146,102,634	20.07	-
		우선주	-	-	-	-	-

#### 나. 최대주주 상세

##### (1) 최대주주 및 지분율

당사 최대주주는 SK텔레콤주식회사 (영문명 : SK Telecom Co., Ltd.)이며, 그 소유주식수는 146,100,000주(20.07%)입니다.

##### (2) 최대주주의 기본 정보

###### (가) 대표자

(2018년 9월 30일 기준)

성명	직위	상근여부	출생년도
박정호	대표이사/사장	상근	1963년

###### (나) 기본정보

(기준일 : 2018년 9월 30일)

명칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
SK텔레콤 주식회사	65,815	박정호	0.00	-	-	SK(주)	25.22
		-	-	-	-	-	-

##### (3) 최대주주(법인)의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사	업무집행자	최대주주
-----	------	-------	------

	(대표조합원)		(업무집행조합원)		(최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2017.03.24	박정호	-	-	-	-	-
2017.03.28	박정호	0.00	-	-	-	-
2017.03.30	박정호	0.00	-	-	-	-

※ 박정호 대표이사는 '17년 3월 24일 주주총회 및 이사회를 통해 대표이사로 선임되었으며, '17년 3월 28일과 30일 각각 500주의 주식을 취득함

(4) 최대주주(법인)의 최근 결산기 재무현황  
(기준일 : 2018년 9월 30일)

(단위 : 백만원)

구 분	
자산총계	38,186,496
부채총계	16,015,666
자본총계	22,170,830
매출액	12,522,253
영업이익	976,478
당기순이익	2,657,496

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 에스케이텔레콤 주식회사는 1984년 3월 19일에 한국이동통신서비스주식회사로 설립되었으며, 1989년 10월 유가증권시장에 최초 상장되었습니다. 이후 1997년 1월 선경그룹 계열사로 편입되었으며, 이후 3월에 SK텔레콤(주)로 사명이 변경되었습니다.

보고서 작성 기준일 현재, 영위하고 있는 주요 사업은 (가) 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, (나) 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업과 (다) 커머스사업, 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업입니다.

(6) 최대주주(법인)의 최대주주(법인) 기본 정보

(가) 대표자

[기준일 : 2018년 9월 30일]

성명	직위	상근여부	출생년도
최태원	대표이사/회장	상근	1960년
장동현	대표이사/사장	상근	1963년

(나) 기본 정보

[기준일 : 2018년 9월 30일]

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
SK(주)	23,790	최태원*	23.40	-	-	최태원*	23.40
		장동현	-	-	-	-	-

※ 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음.

※ 출자자수는 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018.6.30) 기준 전체 주주수임.

[기준일 : 2018년 11월 14일]

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
SK(주)	23,790	최태원*	23.12	-	-	최태원*	23.12
		장동현	-	-	-	-	-

※ 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음.

※ 출자자수는 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018.6.30) 기준 전체 주주수임.

※ 공시기준일 이후 최대주주의 보유 지분 일부(200,000주) 증여에 따라 최대주주의 지분율이 변동됨

(7) 최대주주(법인)의 최대주주(법인) 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

[기준일 : 2018년 9월 30일]

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2017.03.24	장동현	-	-	-	-	-

※ 박정호 전 대표이사는 '17년 3월 23일부로 대표이사 및 사내이사직 사임

※ 조대식 전 대표이사는 '17년 3월 24일부로 대표이사직 사임 (사내이사직 유지)

[기준일 : 2018년 11월 14일]

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2017.03.24	장동현	-	-	-	-	-
2018.10.24	-	-	-	-	최태원	23.12

- ※ 박정호 전 대표이사는 '17년 3월 23일 부로 대표이사 및 사내이사직 사임
- ※ 조대식 전 대표이사는 '17년 3월 24일 부로 대표이사직 사임 (사내이사직 유지)
- ※ 공시기준일 이후 최대주주의 보유 지분 일부(200,000주) 증여에 따라 최대주주의 지분율이 변동됨

(8) 최대주주(법인)의 최대주주(법인) 최근 결산기 재무현황

[기준일 : 2018년 9월 30일]

(단위 : 백만원)

구 분	
자산총계	118,860,677
부채총계	68,567,486
자본총계	50,293,191
매출액	76,623,493
영업이익	4,681,439
반기순이익	4,765,103

다. 최대주주 변동내역

최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고
-	(주)한국외환은행	37,742,000	8.2	-
2009년 01월 17일	(주)한국외환은행	37,742,000	7.3	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.
2009년 05월 19일	(주)한국외환은행	37,742,000	6.4	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.
2010년 03월 16일	한국정책금융공사	32,412,935	5.5	변경 전 최대주주의 지분매각
2010년 03월 19일	미래에셋자산운용투자자문(주)	35,362,056	6.0	장내 매수/매도
2010년 05월 04일	미래에셋자산운용투자자문(주)	44,041,030	7.46	장내 매수/매도
2010년 08월 03일	한국정책금융공사	32,412,935	5.50	변경 전 최대주주의 지분매각
2010년 10월 11일	국민연금공단	35,894,454	6.08	장내 매수/매도
2011년 01월 10일	국민연금공단	47,786,668	8.10	장내 매수/매도
2011년 04월 11일	국민연금공단	53,774,325	9.11	장내 매수/매도
2011년 07월 08일	국민연금공단	47,838,426	8.08	장내 매수/매도
2011년 10월 07일	국민연금공단	54,202,391	9.15	장내 매수/매도
2012년 02월 15일	에스케이텔레콤(주)	146,100,000	21.05	유상증자 참여 및 구주 지분 인수
2012년 02월 23일	에스케이텔레콤(주)	146,105,000	21.05	특별관계자 추가
2012년 04월 02일	에스케이텔레콤(주)	146,119,894	21.05	계열편입에 따른 특별관계자추가
2012년 06월 22일	에스케이텔레콤(주)	146,127,934	21.05	특별관계자 추가
2013년 05월 09일	에스케이텔레콤(주)	146,115,374	20.57	특별관계자 제외 및 추가
2014년 01월 06일	에스케이텔레콤(주)	146,119,374	20.57	장내 매수
2014년 03월 27일	에스케이텔레콤(주)	146,124,334	20.57	특별관계자 제외 및 추가

2015년 02월 24일	에스케이텔레콤(주)	146,126,442	20.07	장내 매수
2016년 03월 28일	에스케이텔레콤(주)	146,127,532	20.07	특별관계자 추가
2017년 03월 24일	에스케이텔레콤(주)	146,122,574	20.07	특별관계자 제외 및 추가
2017년 07월 05일	에스케이텔레콤(주)	146,111,574	20.07	특별관계자 제외
2017년 08월 30일	에스케이텔레콤(주)	146,102,634	20.07	특별관계자 제외

## 2. 주식의 분포

### 가. 5% 이상 주주의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	에스케이텔레콤(주)	146,102,634	20.07	(주1)
	국민연금공단	66,234,613	9.10	-
	블랙록 펀드 어드바이저스	37,011,690	5.08	-
	더 캐피탈 그룹 컴퍼니스, 인크.	36,768,637	5.05	-
	우리사주조합	-	-	-

(주1) 상기 에스케이텔레콤(주)의 보유내역은 주식관리협회의 구주지분 44,250,000주 인수 및 제3자배정 유상증자 참여 주식 101,850,000주와 특별관계자의 보유주식 2,634주를 합산한 것임. (최대주주인 에스케이텔레콤(주)이 별도 공시한 의결권 귀속 지분과는 상이함.)

(주2) 국민연금공단 보유지분은 2018년 10월 04일 공시한 2018년 09월 27일 기준의 '주식등의대량보유상황 보고서(약식)'을, 블랙록 펀드 어드바이저스는 2018년 05월 14일 공시한 '주식등의대량보유상황보고서(약식)', 더 캐피탈 그룹 컴퍼니스, 인크.는 2018년 09월 05일 공시한 '주식등의대량보유상황보고서(약식)'을 참고 하였음.

※더 캐피탈 그룹 컴퍼니스, 인크. 는 2018년 11월 06일 공시한 '주식등의대량보유상황보고서(약식)'을 통해 2018년 10월 08일 기준 44,172,689주를 보유 중이라고 밝힘

### 나. 소액주주 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 )

(단위 : 주)

구분	주주		보유주식		비고
	주주수	비율	주식수	비율	
소액주주	312,929	99.99	458,742,455	63.01	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

※ 소액주주 현황은 2017년말 기준 주주명부의 개별 주주번호 기준으로 1% 미만의 주주를 모두 포함하여 기재함

## 3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	<p>제10조 (주식의 발행 및 배정) &lt; 개정 2017.3.24 &gt;</p> <p>① 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.</p> <p>1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의</p>
------------------	--

	<p>청약을 할 기회를 부여하는 방식</p> <p>2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식. 본 제 2호에 의한 신주 발행은 아래 각 목의 경우를 포함하되 이에 한정되지 아니함.</p> <p>가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우</p> <p>나. 자금조달, 기술도입 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관(여기서 '금융기관'이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항의 전문투자자를 의미하되, 동항 제4호의 주권상장법인, 동법 시행령 제10조 제3항 제16호 및 제17호의 법인, 단체 또는 개인은 포함하지 아니한다), 제휴법인, 전략적 투자자 또는 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>다. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>라. 회사가 "경영상 필요로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 제1항 제2호 가목 내지 다목의 자 "에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>마. 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우</p> <p>3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식</p> <p>② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.</p> <p>1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식</p> <p>2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식</p> <p>3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식</p> <p>4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식</p> <p>③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.</p> <p>④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권</p>
--	---

	증서를 발행하여야 한다.		
결산일	12월 31일	정기주주총회	3월 중
주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 31일 까지		
주권의 종류	일,오,일십,오십,일백,오백,일천,일만주권 (8종)		
명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 여의도동 43-2)		
주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	홈페이지게재<개정 2012.03.23>

## 4. 주가 및 주식 거래실적

### 가. 국내증권시장

(단위 : 원, 천주)

종류		'18년 9월	'18년 8월	'18년 7월	'18년 6월	'18년 5월	'18년 4월
보통주	최고주가	81,200	85,600	90,300	91,400	95,300	87,900
	최저주가	73,100	74,500	80,500	83,500	82,900	80,300
	평균주가	77,341	79,809	86,136	87,358	88,565	83,229
거래량	최고일거래량	8,388	6,786	7,076	5,519	10,379	7,552
	최저일거래량	1,904	1,929	1,570	1,876	1,959	1,489
	월간거래량	4,087	3,704	3,178	3,641	3,475	4,022

※ 주가는 일별 종가 기준임.

### 나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 룩셈부르크]

(단위 : USD, DR)

종류			'18년 9월	'18년 8월	'18년 7월	'18년 6월	'18년 5월	'18년 4월
주가 (종가 기준)	최고	USD	74.50	76.50	79.00	85.00	88.50	82.50
		원화환산	82,896	84,823	88,219	95,345	95,695	88,787
	최저	USD	66.00	66.50	70.00	74.50	77.00	75.00
		원화환산	73,438	73,735	78,169	83,567	83,260	80,715
거래량	최고(일)		-	-	500	-	-	1,092
	최저(일)		-	-	-	-	-	-
	월간평균		-	-	24	-	-	109
환율			1,112.70	1,108.80	1,116.70	1,121.70	1,081.30	1,076.20

※ 환율의 경우 매월 말 고시기준율을 기준으로 하였음.

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

### 1. 임원 및 직원의 현황

#### 가. 임원의 현황

##### (1) 등기임원의 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식		
박성욱	남	1958년 01월	부회장	등기임원	상근	대표이사 사외이사후보 추천위원회 위원	한국과학기술원(KAIST) 재료공학 박사 하이닉스반도체 메모리 연구소장/전무 SK하이닉스 부사장 SK하이닉스 사장 SK하이닉스 대표이사 부회장(現)	1,502	-	선임 (09.03.26) 중임(12.02.14, 15.03.20, 18.03.28)	-
이석희	남	1965년 06월	사장	등기임원	상근	사내이사 사업총괄 지속경영위원회 위 원	스탠퍼드대 재료공학 박사 Intel 근무 KAIST 교수 SK하이닉스 미래기술연구원장 SK하이닉스 DRAM개발부문장 SK하이닉스 사업총괄(現)	42	-	선임 (17.03.24)	-
박정호	남	1963년 05월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	조지워싱턴대 경영학 석사 SK텔레콤(주) 사업개발부문장 SK C&C(주) 대표이사/사장 SK(주) 대표이사/사장 SK텔레콤(주) 대표이사/사장(現)	1,090	-	선임 (17.03.24)	-
최종원	남	1958년 10월	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원 사외이사후보추천 위원회 위원	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI 연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수(現)	-	-	선임 (14.03.21) 중임 (17.03.24)	-
신창환	남	1979년 11월	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원	고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 근무 Xilinx 근무 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 (現)	-	-	선임 (17.03.24)	-

송호근	남	1956년 1월	이사	등기임원	비상근	사외이사 지속경영위원회위원	서울대 사회학 미국 하버드대 대학원 사회학 박사 한림대 부교수 서울대 사회발전연구소 소장 감사원 자문위원 서울대 대외협력본부장 사회통합위원회 위원 한법재판소 정책자문위원 중앙일보 칼럼니스트 서울대 사회과학대 교수 서울대 석좌교수 중앙일보 기명칼럼니스트(現) 포스코청암재단 감사위원(現) 포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수/학부장(現)	-	-	선임 (18.03.28)	-
조현재	남	1958년 1월	이사	등기임원	비상근	사외이사 지속경영위원회위원 사외이사후보추천위원회 위원	한국외국어대 서반어학 매일경제신문 편집국장 매경닷컴 대표이사 겸 뉴미디어담당 매일경제TV 대표이사 MBN 보도본부 본부장 MBN 대표이사 한국법무보호복지공단 비상임이사(現) 광주대 초빙교수(現)	-	-	선임 (18.03.28)	-
윤태화	남	1960년 10월	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원	연세대 경영학 연세대 대학원 경영학 박사 안권 회계법인 공인회계사 한국금융연수원 교수 한국세무학회 제24대 회장 한국회계정보학회 제25대 회장 국무총리 조세심판원 비상임심판관(現) 한국고용정보원 비상임감사(現) 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원(現) 가천대 경영학과 교수(現)	-	-	선임 (18.03.28)	-

\* 임기 만료일은 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회 종료시임.

## (2) 등기임원의 겸직 현황

[기준일: 2018년 9월 30일]

겸직임원		겸직회사		비고
성명	직위	회사명	직위	
박성욱	대표이사	SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	대표이사	-
		SK hynix memory solutions America Inc.	이사	-
		SK China Company Ltd.	이사	-
		SK SE ASIA INVESTMENT PTE., LTD.	이사	-

박 정 호	기타비상무이사	SK 텔레콤	대표이사	-
		SK SE ASIA INVESTMENT PTE., LTD.	이 사	-
최 종 원	사외이사	두산건설(주)	사외이사	-

### (3) 미등기 임원 현황

[기준일: 2018년 9월 30일]

직위 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	생년월일	담당업무	약력	학력	소유주식수		비고
								보통주	우선주	
회장 (상근)	미등기임원	최태권	남	1960.12	회장	회장	Univ. of Chicago	0		
사장 (상근)	미등기임원	정대성	남	1960.11	NAND사업총괄	NAND개발사업부문장	Univ. of Wisconsin - Madison	0		
부사장 (상근)	미등기임원	Tony Yoon	남	1963.04	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	UC Berkeley	0		
부사장 (상근)	미등기임원	김동섭	남	1963.01	대외협력총괄	대외협력총괄	서울대	0		
부사장 (상근)	미등기임원	김진국	남	1964.07	미래기술연구원 담당	DRAM개발사업부문장	연세대	2000		
부사장 (상근)	미등기임원	송현중	남	1965.11	마케팅/영업 담당	마케팅부문장	Massachusetts Institute of Technology	3000		
부사장 (상근)	미등기임원	이명영	남	1962.02	경영지원 담당	경영지원총괄 담당임원	연세대	0		
부사장 (상근)	미등기임원	이상선	남	1961.09	제조/기술 담당	제조/기술부문장	고려대	4000		
부사장 (상근)	미등기임원	진교권	남	1962.09	품질보증 담당	품질보증본부장	서울대	112		
부사장 (상근)	미등기임원	현순엽	남	1963.10	기업문화 담당	경영지원총괄 담당임원	서울대	3520		
부사장 (상근)	미등기임원	홍성주	남	1962.11	CIS Business 담당	미래기술연구원장	한국과학기술원	6842		
전무 (상근)	미등기임원	AndrewChong	남	1965.09	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	UC Berkeley	0		
전무 (상근)	미등기임원	곽노정	남	1965.11	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	고려대	1103		
전무 (상근)	미등기임원	길병송	남	1963.06	기업문화 담당임원	경영지원총괄 담당임원	경찰대	0		
전무 (상근)	미등기임원	김광욱	남	1962.08	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	경북대	0		
전무 (상근)	미등기임원	김남석	남	1967.02	P&T 담당임원	P&T담당임원	서울대	0		
전무 (상근)	미등기임원	박성계	남	1967.06	NAND개발사업총괄 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원	0		
전무 (상근)	미등기임원	박정식	남	1963.12	P&T 담당	P&T본부장	충익대	112		
전무 (상근)	미등기임원	송창록	남	1969.01	사업총괄 담당임원	정보화본부장	서울대	0		

전무 (상근)	미등기임원	신승국	남	1962.11	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	Vanderbilt University	0		
전무 (상근)	미등기임원	안근욱	남	1959.08	NAND개발사업총괄 담당임원	제조/기술부문 담당임원	단국대	0		
전무 (상근)	미등기임원	안현	남	1967.06	NAND개발사업총괄 담당임원	경영지원총괄 담당임원	서울대	0		
전무 (상근)	미등기임원	오기영	남	1960.05	사업총괄 담당임원	Tech혁신센터 담당임원	SOPHIA UNIVERSITY	0		
전무 (상근)	미등기임원	오종훈	남	1964.08	DRAM개발사업 담당	DRAM개발사업부문 담당임원	서울대	0		
전무 (상근)	미등기임원	이상래	남	1965.07	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	Boston University	2		
전무 (상근)	미등기임원	이재성	남	1966.09	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	연세대	0		
전무 (상근)	미등기임원	이재형	남	1965.09	마케팅/영업 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	서강대	0		
전무 (상근)	미등기임원	임동규	남	1964.04	사업총괄 담당임원	미래기술연구원 담당임원	서울대	0		
전무 (상근)	미등기임원	임종필	남	1960.11	기업문화 담당임원	경영지원총괄 담당임원	고려대	0		
전무 (상근)	미등기임원	임종혁	남	1964.08	윤리경영 담당	윤리경영 담당	서울대	0		
전무 (상근)	미등기임원	전춘현	남	1966.05	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	경북대	0		
전무 (상근)	미등기임원	최근민	남	1960.09	SHE 담당	Tech혁신센터장	Tohoku University	0		
전무 (상근)	미등기임원	최정달	남	1964.07	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	경북대	0		
전무 (상근)	미등기임원	피승호	남	1966.04	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원	569		
전무 (상근)	미등기임원	한우종	남	1959.01	NAND개발사업총괄 담당임원	메모리시스템연구소장	고려대	400		
상무 (상근)	미등기임원	강상원	남	1968.10	P&T 담당임원	P&T 담당임원	한양대	0		
상무 (상근)	미등기임원	강선국	남	1969.02	마케팅/영업 담당임원	마케팅부문 담당임원	인하대	0		
상무 (상근)	미등기임원	강유종	남	1970.12	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	Vanderbilt University	0		
상무 (상근)	미등기임원	강진수	남	1967.07	마케팅/영업 담당임원	마케팅/영업 담당임원	한국과학기술원	0		
상무 (상근)	미등기임원	권원택	남	1962.10	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	광운대	0		
상무 (상근)	미등기임원	권재순	남	1969.12	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	충북대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김기현	남	1968.10	마케팅/영업 담당임원	마케팅/영업 담당임원	University of Phoenix	0		
상무 (상근)	미등기임원	김대영	남	1962.09	기업문화 담당임원	경영지원총괄 담당임원	부산대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김도근	남	1964.03	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	한국과학기술원	0		

상무 (상근)	미등기임원	김상근	남	1962.01	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	동아대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김상덕	남	1968.02	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	서울대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김석	남	1970.11	마케팅/영업 담당임원	마케팅부문 담당임원	연세대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김선경	남	1969.04	경영지원 담당임원	경영지원 담당임원	Purdue University West Lafayette	20		
상무 (상근)	미등기임원	김선순	남	1970.06	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업 담당임원	연세대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김성한	남	1968.12	경영지원 담당임원	제조/기술부문 담당임원	서울대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김영식	남	1967.12	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	연세대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김영일	남	1965.10	현장경영 담당	윤리경영실장	Univ. of Denver	0		
상무 (상근)	미등기임원	김영희	남	1972.01	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업총괄 담당임원	University of Texas - Austin	0		
상무 (상근)	미등기임원	김용주	남	1968.10	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	한양대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김점수	남	1972.01	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	청주대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김정기	남	1964.01	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	서강대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김정태	남	1969.07	마케팅/영업 담당임원	마케팅/영업 담당임원	한국과학기술원	0		
상무 (상근)	미등기임원	김종호	남	1967.01	마케팅/영업 담당임원	마케팅부문 담당임원	고려대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김종환	남	1972.09	DRAM개발사업 담당임원	미래기술연구원 담당임원	서울대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김주선	남	1966.06	마케팅/영업 담당임원	마케팅부문 담당임원	성균관대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김춘환	남	1967.04	제조/기술 담당임원	제조/기술 담당임원	서울대	112		
상무 (상근)	미등기임원	김태찬	남	1963.06	CIS Business 담당임원	CIS사업부 담당임원	고려대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김태훈	남	1963.02	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	경북대	0		
상무 (상근)	미등기임원	김태훈	남	1970.02	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	Arizona State University	0		
상무 (상근)	미등기임원	김현근	남	1962.07	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	한국과학기술원	9		
상무 (상근)	미등기임원	김형수	남	1965.02	기업문화 담당임원	경영지원총괄 담당임원	한국과학기술원	1000		
상무 (상근)	미등기임원	김형환	남	1970.03	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	서울대	2550		
상무 (상근)	미등기임원	마금선	남	1968.11	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	Indiana State University	0		
상무 (상근)	미등기임원	문승훈	남	1969.08	제조/기술 담당임원	제조/기술 담당임원	서울시립대	0		

상무 (상근)	미등기임원	문유진	남	1967.05	기업문화 담당임원	경영지원총괄 담당임원	한양대	0		
상무 (상근)	미등기임원	민경현	남	1966.01	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	New York University	0		
상무 (상근)	미등기임원	박근우	남	1966.04	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	한국과학기술원	0		
상무 (상근)	미등기임원	박일	남	1971.01	DRAM개발사업 담당임원	메모리시스템연구소 담당임원	Purdue University	0		
상무 (상근)	미등기임원	박재광	남	1966.04	Global Networking 담당	Global Networking 담당	Harvard University	0		
상무 (상근)	미등기임원	박진규	남	1968.06	P&T 담당임원	P&T 담당임원	영남대	0		
상무 (상근)	미등기임원	박찬진	남	1970.05	사업총괄 담당임원	정보화본부 담당임원	서울대	0		
상무 (상근)	미등기임원	박찬하	남	1969.01	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	포항공대	0		
상무 (상근)	미등기임원	박철규	남	1966.06	DRAM개발사업 담당임원	품질보증본부 담당임원	경북대	0		
상무 (상근)	미등기임원	박현	남	1969.06	경영지원 담당임원	경영지원 담당임원	중앙대	0		
상무 (상근)	미등기임원	사택진	남	1961.11	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	고려대	0		
상무 (상근)	미등기임원	손석우	남	1968.01	제조/기술 담당임원	제조/기술 담당임원	영남대	0		
상무 (상근)	미등기임원	신동원	남	1967.11	CIS Business 담당임원	CIS Business 담당임원	고려대	0		
상무 (상근)	미등기임원	심대홍	남	1969.06	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	서울대	0		
상무 (상근)	미등기임원	안규옥	남	1962.09	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	중앙대	0		
상무 (상근)	미등기임원	안영규	남	1968.10	미래기술연구원 담당임원	제조/기술부문 담당임원	한국과학기술원	0		
상무 (상근)	미등기임원	양중섭	남	1964.12	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	한국과학기술원	0		
상무 (상근)	미등기임원	오종진	남	1965.02	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	경희대(국제캠퍼스)	0		
상무 (상근)	미등기임원	원국	남	1966.12	마케팅/영업 담당임원	마케팅부문 담당임원	Univ. of Helsinki	0		
상무 (상근)	미등기임원	위보령	남	1964.06	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	한국과학기술원	0		
상무 (상근)	미등기임원	윤석훈	남	1966.11	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	충남대	0		
상무 (상근)	미등기임원	이기정	남	1965.10	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	아주대	0		
상무 (상근)	미등기임원	이기화	남	1968.12	P&T 담당임원	P&T담당임원	충북대	119		
상무 (상근)	미등기임원	이동호	남	1968.06	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한양대	0		
상무 (상근)	미등기임원	이두희	남	1967.07	기업문화 담당임원	경영지원총괄 담당임원	연세대	0		

상무 (상근)	미등기임원	이민형	남	1968.10	제조/기술 담당임원	제조/기술 담당임원	명지대	0		
상무 (상근)	미등기임원	이병기	남	1972.02	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원	0		
상무 (상근)	미등기임원	이상철	남	1965.02	사업총괄 담당임원	정보화본부 담당임원	아주대	50		
상무 (상근)	미등기임원	이상화	남	1968.10	제조/기술 담당임원	제조/기술 담당임원	경북대	0		
상무 (상근)	미등기임원	이석규	남	1963.12	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	서울대	0		
상무 (상근)	미등기임원	이성동	남	1965.03	P&T 담당임원	P&T담당임원	서강대	0		
상무 (상근)	미등기임원	이성재	남	1969.07	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업 담당임원	연세대	8		
상무 (상근)	미등기임원	이승범	남	1964.07	CIS Business 담당임원	CIS사업부 담당임원	동국대	0		
상무 (상근)	미등기임원	이정훈	남	1964.06	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	연세대	0		
상무 (상근)	미등기임원	이창수	남	1967.02	품질보증 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	Tohoku University	0		
상무 (상근)	미등기임원	이한주	남	1965.11	사업총괄 담당임원	정보화본부 담당임원	성균관대	0		
상무 (상근)	미등기임원	이호석	남	1969.09	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업총괄 담당임원	성균관대	0		
상무 (상근)	미등기임원	이희기	남	1964.07	품질보증 담당임원	품질보증본부 담당임원	인하대	0		
상무 (상근)	미등기임원	임성빈	남	1963.06	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	울산대	0		
상무 (상근)	미등기임원	장승호	남	1970.11	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	서강대	0		
상무 (상근)	미등기임원	장종대	남	1964.10	기업문화 담당임원	경영지원총괄 담당임원	고려대	0		
상무 (상근)	미등기임원	장혁준	남	1967.06	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	Indiana University – Bloomington	0		
상무 (상근)	미등기임원	장희현	남	1963.01	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	연세대	0		
상무 (상근)	미등기임원	전영호	남	1961.04	NAND개발사업총괄 담당임원	미래기술연구원 담당임원	광운대	0		
상무 (상근)	미등기임원	전용주	남	1962.10	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	전북대	0		
상무 (상근)	미등기임원	전윤석	남	1964.12	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	University of Utah	0		
상무 (상근)	미등기임원	정상규	남	1967.12	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	연세대	0		
상무 (상근)	미등기임원	정성용	남	1972.12	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	Ohio State University	0		
상무 (상근)	미등기임원	정의상	남	1965.03	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	고려대	0		
상무 (상근)	미등기임원	정종호	남	1964.03	제조/기술 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	광운대	0		

상무 (상근)	미등기임원	정진수	남	1970.10	품질보증 담당임원	품질보증 담당임원	충남대	0		
상무 (상근)	미등기임원	정진욱	남	1970.04	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	경북대	0		
상무 (상근)	미등기임원	정철우	남	1965.04	경영지원 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	성균관대	0		
상무 (상근)	미등기임원	정태우	남	1965.05	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	연세대	0		
상무 (상근)	미등기임원	조영만	남	1968.09	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한양대	0		
상무 (상근)	미등기임원	조주환	남	1968.01	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	광운대	0		
상무 (상근)	미등기임원	조호진	남	1968.11	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업 담당임원	서울대	2387		
상무 (상근)	미등기임원	차상엽	남	1967.02	사업총괄 담당임원	사업총괄 담당임원	연세대	0		
상무 (상근)	미등기임원	차선용	남	1967.08	미래기술연구원 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	한국과학기술원	400		
상무 (상근)	미등기임원	천영일	남	1966.10	미래기술연구원 담당임원	제조/기술 담당임원	고려대	0		
상무 (상근)	미등기임원	최광문	남	1968.01	기업문화 담당임원	기업문화 담당임원	연세대	0		
상무 (상근)	미등기임원	최봉호	남	1962.09	DRAM개발사업 담당임원	미래기술연구원 담당임원	연세대	9		
상무 (상근)	미등기임원	최석문	남	1966.04	사업총괄 담당임원	정보화본부 담당임원	Univ. of MichiganAnn Arbor	0		
상무 (상근)	미등기임원	최용수	남	1969.02	품질보증 담당임원	품질보증 담당임원	인하대	0		
상무 (상근)	미등기임원	최정산	남	1967.01	품질보증 담당임원	품질보증본부 담당임원	연세대	0		
상무 (상근)	미등기임원	최준기	남	1968.02	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	숭실대	0		
상무 (상근)	미등기임원	최준배	남	1969.01	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	Fairleigh Dickinson University	0		
상무 (상근)	미등기임원	최홍석	남	1968.11	미래기술연구원 담당임원	NAND개발사업총괄 담당임원	한국과학기술원	0		
상무 (상근)	미등기임원	한영수	남	1969.11	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	아주대	0		
상무 (상근)	미등기임원	홍권	남	1965.11	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	고려대	0		
상무 (상근)	미등기임원	홍상후	남	1963.02	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	성균관대	0		
상무 (상근)	미등기임원	황신용	남	1969.12	경영지원 담당임원	경영지원총괄 담당임원	고려대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	김성동	남	1967.03	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	서울대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	김세연	남	1973.01	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	University of Illinois at Urbana Champaign	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	김창한	남	1971.04	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	University of Wisconsin - Madison	0		

연구위원 (상근)	미등기임원	김태현	남	1970.03	CIS Business 담당임원	CIS Business 담당임원	Georgia Institute of Technology	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	나한주	남	1963.05	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	서강대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	문홍식	남	1970.11	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	University of California - Berkeley	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	박경	남	1968.07	NAND개발사업총괄 담당임원	메모리시스템연구소 담당임원	고려대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	박종민	남	1968.08	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	한국과학기술원	180		
연구위원 (상근)	미등기임원	설광수	남	1970.01	제조/기술 담당임원	제조/기술 담당임원	Waseda University	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	양지철	남	1973.07	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	성균관대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	오훈상	남	1969.07	CIS Business 담당임원	CIS Business 담당임원	서울대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	유승건	남	1963.06	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	성균관대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	이동준	남	1964.03	제조/기술 담당임원	제조/기술부문 담당임원	인하대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	이문환	남	1967.09	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	University of Washington	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	이병호	남	1970.05	미래기술연구원 담당임원	제조/기술부문 담당임원	한국과학기술원	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	이승철	남	1968.12	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	중앙대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	이영택	남	1964.02	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업총괄 담당임원	서울대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	이창렬	남	1967.02	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	임의철	남	1969.08	NAND개발사업총괄 담당임원	메모리시스템연구소 담당임원	성균관대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	임찬	남	1966.01	NAND개발사업총괄 담당임원	미래기술연구원 담당임원	연세대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	임창문	남	1966.06	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원	6000		
연구위원 (상근)	미등기임원	장경식	남	1967.07	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업부문 담당임원	포항공과대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	장세억	남	1966.03	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	포항공과대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	정성웅	남	1967.08	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	한국과학기술원	242		
연구위원 (상근)	미등기임원	정인철	남	1972.01	DRAM개발사업 담당임원	DRAM개발사업 담당임원	서울대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	조명관	남	1966.05	NAND개발사업총괄 담당임원	NAND개발사업부문 담당임원	포항공과대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	진세연	남	1973.01	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	University of Illinois at Urbana Champaign	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	진일섭	남	1971.05	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원 담당임원	University of California - Los Angeles	0		

연구위원 (상근)	미등기임원	채동혁	남	1973.10	NAND개발사업총괄 담당임원	미래기술연구원 담당임원	서울대	0		
연구위원 (상근)	미등기임원	현창석	남	1967.02	DRAM개발사업 담당임원	미래기술연구원 담당임원	연세대	0		

## 나. 직원의 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 천원)

사업부문	성별	직원 수				합 계	평 균 근속연수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자						
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)					
-	남	16,038	-	51	-	16,089	10.08	1,473,086,097	97,568	-
-	여	9,756	-	44	3	9,800	11.58	637,246,233	68,060	-
합 계		25,794	-	95	3	25,889	10.65	2,110,332,330	86,273	-

※ '직원수'는 기준일 현재 본사 재직자(휴직자 포함) 기준이며, 사내이사/사외이사/기타비상무이사 제외 기준임.

※ '연간급여총액'은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임.

※ '1인평균급여액'은 당기 평균인원(24,461명)을 기준으로 계산함.

## 다. 노동조합의 현황

[기준일: 2018년 9월 30일]

구 분	관 련 내 용	비 고
가입대상	이천 7,819명 / 청주 5,216명	-
가입인원	이천 7,497명 / 청주 5,158명	-
근로시간 면제자	이천 10명 / 청주 6명	-
소속된 연합단체	한국노총 금속노련	-
기 타	-	-

## 2. 임원의 보수 등

### 가. 이사·감사 전체의 보수현황

#### (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기임원	8	12,000	-

(2) 이사·감사 전체 지급금액

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
8	5,207	626	-

※ 인원수는 3분기 말 기준임

※ 보수총액은 대상기간내 지급된 총액이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 기간 평균 인원수로 나누어 산출함.

※ 보수총액 및 1인당 평균보수액은 급여 등 공시대상기간에 지급 또는 실현된 보수 총 금액을 기재하였음.

단, 퇴직금의 경우 제66기 정기주주총회에서 임원퇴직금지급규정을 별도 승인받았으므로 상기 보수지급금액에는 포함하지 아니함.

(개인별 보수지급 내역은 퇴직소득을 포함하여 세법상 인정되는 모든 급부를 대상으로 함)

(3) 유형별 지급금액

(단위 : 백만원)

구분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	4,878	1,626	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	2	105	63	-
감사위원회 위원	3	225	62	-
감사	-	-	-	-

※ 인원수는 3분기 말 기준임

※ 보수총액은 대상기간내 지급된 총액이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 기간 평균 인원수로 나누어 산출함.

※ 보수총액 및 1인당 평균보수액은 급여 등 공시대상기간에 지급 또는 실현된 보수 총 금액을 기재하였음.

단, 퇴직금의 경우 제66기 정기주주총회에서 임원퇴직금지급규정을 별도 승인받았으므로 상기 보수지급금액에는 포함하지 아니함.

(개인별 보수지급 내역은 퇴직소득을 포함하여 세법상 인정되는 모든 급부를 대상으로 함)

나. 이사·감사의 개인별 보수현황

※ 자본시장법 개정으로 인해 임원등의 보수 기재 회수가 연 2회로 축소함에 따라, 분기보고서에는 관련 내용을 기재하지 않는 것으로 함. (제159조 제2항 및 제160조)

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

<표1>

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	2	818	-
사외이사	-	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-
계	2	-	-

※ 주식매수선택권의 공정가치는 당해 사업연도(분·반기) 손익계산서(포괄손익 계산서)에 주식매수선택권과 관련하여 비용으로 계상된 부분을 기재하였으며, 공정가치 산출 방법 등 자세한 사항은 연결 감사보고서 주석 '33. 주식기준보상' 항목을 참조

<표2>

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 원, 주)

부여 받은자	관계	부여일	부여방법	주식의 종류	변동수량			미행사 수량	행사기간	행사 가격
					부여	행사	취소			
박성욱	등기임원	2017년 03월 24일	자기주식교부	보통주	99,600	-	-	99,600	2019년 3월 25일부터 2022년 3월 24일 까지	48,400
박성욱	등기임원	2017년 03월 24일	자기주식교부	보통주	99,600	-	-	99,600	2020년 3월 25일부터 2023년 3월 24일 까지	52,280
박성욱	등기임원	2017년 03월 24일	자기주식교부	보통주	99,600	-	-	99,600	2021년 3월 25일부터 2024년 3월 24일 까지	56,460
정태성	미등기임원	2018년 01월 01일	자기주식교부	보통주	7,747	-	-	7,747	2020년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지	77,440
이석희	등기임원	2018년 03월 28일	자기주식교부	보통주	7,223	-	-	7,223	2020년 3월 29일부터 2023년 3월 28일 까지	83,060

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

### 1. 계열회사의 현황

#### 가. 기업집단의 개요

- 명 칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)

#### 나. 관련법령상의 규제내용 등

- "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단 ○
- 지정시기 : 1987년
- 규제내용 요약
  - 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등
  - 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시
  - 기업집단 현황 등에 관한 공시
  - 비상장사의 중요사항 공시

#### 다. 기업집단에 소속된 회사 (2018. 9. 30 기준 계열사 : 100개사)

상장 여부	회사명	법인등록번호
상장사 (17)	SKC솔믹스(주)	134711-0014631
	SKC(주)	130111-0001585
	SK가스(주)	110111-0413247
	SK네트웍스(주)	130111-0005199
	SK디스커버리(주)	130111-0005727
	SK디앤디(주)	110111-3001685
	SK머티리얼즈(주)	190111-0006971
	SK바이오랜드(주)	110111-1192981
	SK이노베이션(주)	110111-3710385
	SK(주)	110111-0769583
	SK케미칼(주)	131111-0501021
	SK텔레콤(주)	110111-0371346
	SK하이닉스(주)	134411-0001387
	(주)나노엔텍	110111-0550502
	(주)부산도시가스	180111-0039495
	(주)아이리버	110111-1637383
	(주)에스엠코어	110111-0128680
비상장사 (83)	SK E&S(주)	110111-1632979
	SKC인프라서비스(주)	134111-0414065
	SKC하이테크앤마케팅(주)	161511-0225312
	SK건설(주)	110111-0038805

SK네트웍스서비스(주)	135811-0141788
SK더블유(주)	154311-0026200
SK렌터카서비스(주)	160111-0306525
SK루브리컨츠(주)	110111-4191815
SK매직서비스(주)	134811-0039752
SK매직(주)	110111-5125962
SK모바일에너지(주)	161511-0076070
SK바이오사이언스(주)	131111-0523736
SK바이오텍(주)	160111-0395453
SK바이오팜(주)	110111-4570720
SK배터리시스템즈(주)	160111-0337801
SK브로드밴드(주)	110111-1466659
SK쇼와덴코(주)	175611-0018553
SK스토아(주)	110111-6585884
SK신택(주)	131411-0232597
SK실트론(주)	175311-0001348
SK어드밴스드(주)	230111-0227982
SK에너지(주)	110111-4505967
SK에어가스(주)	230111-0134111
SK엠앤서비스(주)	110111-1873432
SK와이번스(주)	120111-0217366
SK인천석유화학(주)	120111-0666464
SK인포섹(주)	110111-2007858
SK임업(주)	134811-0174045
SK종합화학(주)	110111-4505975
SK커뮤니케이션즈(주)	110111-1322885
SK테크엑스(주)	110111-5990547
SK텔레시스(주)	110111-1405897
SK텔링크(주)	110111-1533599
SK트레이딩인터내셔널(주)	110111-5171064
SK트리캠(주)	164711-0060753
SK티엔에스(주)	110111-5833250
SK플라즈마(주)	131111-0401875
SK플래닛(주)	110111-4699794
SK핀크스(주)	224111-0003760
SK하이닉스시스템IC(주)	150111-0235586
SK하이스택(주)	134411-0037746
SK하이이엔지(주)	134411-0017540
SK해운(주)	110111-6364212

강원도시가스(주)	140111-0002010
금호미쓰이화학(주)	110111-0612980
나래에너지서비스(주)	135711-0092181
내트럭(주)	110111-3222570
네트웍오앤에스(주)	110111-4370708
당진에코파워(주)	165011-0035072
대전맑은물(주)	110111-4273960
디앤디인베스트먼트(주)	110111-6618263
목감휴게소서비스(주)	110111-6257954
미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주)	230111-0233880
보령LNG터미널(주)	164511-0021527
비앤엠개발(주)	110111-5848712
서비스에이스(주)	110111-4368688
서비스탑(주)	160111-0281090
에프앤유신용정보(주)	135311-0003300
에프에스케이엘앤에스(주)	131111-0462520
엔티스(주)	130111-0021658
영남에너지서비스(주)	175311-0001570
울산아로마틱스(주)	110111-4499954
원스토어(주)	131111-0439131
위례에너지서비스(주)	110111-4926006
유베이스매뉴팩처링아시아(주)	230111-0168673
이니츠(주)	230111-0212074
전남도시가스(주)	201311-0000503
전북에너지서비스(주)	214911-0004699
제주유나이티드FC(주)	224111-0015012
(주)대한송유관공사	110111-0671522
(주)에이앤티에스	110111-3066861
(주)엔에스오케이	110111-3913187
(주)제이에스아이	124611-0261880
(주)포인트코드	110111-1888548
지허브(주)	230111-0205996
충청에너지서비스(주)	150111-0006200
코원에너지서비스(주)	110111-0235617
파주에너지서비스(주)	110111-4629501
피에스앤마케팅(주)	110111-4072338
한국벅슬렌(유)	230114-0003328
행복나래(주)	110111-2016940
행복모아(주)	150111-0226204

	홈앤서비스(주)	110111-6420460
--	----------	----------------

주1) SK테크엑스(주)는 '18.10.17일자로 계열 제외

주2) '18.10.1일자로 유빈홀딩스(주), 유빈스(주), 에이오티(주), 피아이유엔(주) 계열 편입

(\*) 사명 변경 : SK(주) (舊 SK C&C(주)), 엔티스(주) (舊 SK사이텍(주)), SK인포섹(주) (舊 인포섹(주)), SK배터리시스템즈(주) (舊 SK컨티넨탈이모션코리아(주)), 나래에너지서비스(주) (舊 하남에너지서비스(주)), 비앤엠개발(주) (舊 엠케이에스개런티(유)), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주) (舊 에스엠피씨(주)), SK에어가스(주) (舊 SKC에어가스(주)), SK바이오랜드(주) (舊 (주)바이오랜드), 파주에너지서비스(주) (舊 피엠피(주)), SK엠앤서비스(주) (舊 엠앤서비스(주)), SK매직서비스(주) (舊 매직서비스(주)), (주)엔에스오케이 (舊 (주)네오에스네트웍스), SK디스커버리(주) (舊 SK케미칼(주)), SKC하이테크앤마케팅(주) (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스(주) (舊 카라이프서비스(주))

## 라. 관계회사간 출자현황

[2018년 9월 30일 기준]

(보통주 기준)

피투자회사 \ 투자회사	SK이노베이션	대한송유관공사	SK모바일에너지	행복나래	SK배터리 시스템즈	SK에너지	내트릭	제주 유나이티드FC	SK종합화학	울산아로마틱스
SK(주)	33.4%									
SK이노베이션		41.0%	100.0%	45.0%	100.0%	100.0%			100.0%	
SK에너지							100.0%	100.0%		
SK종합화학										50.0%
SK루브리컨츠										
SK텔레콤				45.0%						
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신타										
SK가스				5.0%						
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	33.4%	41.0%	100.0%	95.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%

피투자회사 \ 투자회사	SK루브리컨츠	유베이스 매뉴팩처링아시아	SK인천 석유화학	SK트레이딩 인터내셔널	SK텔레콤	SK커뮤니케이션즈	SK와이브스	에프앤유 신용정보	PS&마케팅	네트웍 오앤에스
SK(주)					25.2%					
SK이노베이션	100.0%		100.0%	100.0%						
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠		70.0%								
SK텔레콤						100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	70.0%	100.0%	100.0%	25.2%	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%

피투자회사 \ 투자회사	서비스에이스	서비스탑	아이리버	SK테크엑스	원스토어	나노엔텍	FSK L&S	SK브로드밴드	홈서비스	SK스토아
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤	100.0%	100.0%	52.6%	100.0%	65.5%	27.1%	60.0%	100.0%		
SK브로드밴드									100.0%	100.0%
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	100.0%	52.6%	100.0%	65.5%	27.1%	60.0%	100.0%	100.0%	100.0%

피투자회사 \ 투자회사	SK텔링크	엔에스오케이	SK플래닛	SK엠앤서비스	SK하이닉스	SK하이 스택	SK하이이엔지	행복모아	SK하이닉스 시스템IC	SK E&S
SK(주)										90.0%
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤	100.0%		98.1%		20.1%					
SK브로드밴드										
SK텔링크		100.0%								
SK플래닛				100.0%						
SK하이닉스						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	100.0%	98.1%	100.0%	20.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	90.0%

피투자회사 \ 투자회사	부산 도시가스	충청에너지 서비스	영남에너지 서비스	전남 도시가스	전북에너지 서비스	강원 도시가스	위례에너지 서비스	파주에너지 서비스	보령 LNG터미널	코원에너지 서비스
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S	67.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.2%	100.0%	50.0%	100.0%
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	67.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.2%	100.0%	50.0%	100.0%

피투자회사 \ 투자회사	나래에너지 서비스	SKC	SKC솔믹스	SK더블유	SK바이오랜드	SKC하이테크앤 마케팅	SK텔레시스	SKC 인프라서비스	미쓰이케미칼앤드 SKC폴리우레탄	SK네트웍스
SK(주)		41.0%								39.1%
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S	100.0%									
SKC			57.7%	100.0%	27.9%	100.0%	79.4%		50.0%	
SK텔레시스								100.0%		
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										0.02%
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	41.0%	57.7%	100.0%	27.9%	100.0%	79.4%	100.0%	50.0%	39.1%

피투자회사 \ 투자회사	SK네트웍스 서비스	SK핀크스	SK랜터카 서비스	목감휴게소 서비스	SK매직	SK매직서비스	SK건설	대전왕은물	SK티엔에스	SK해운
SK(주)							44.5%			57.2%
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스	86.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
SK매직						100.0%				
SK건설								2.6%	100.0%	
SK디스커버리							28.3%			
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케이칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	86.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	72.8%	2.6%	100.0%	57.2%

피투자회사 \ 투자회사	SK플라즈마	SK신택	SK가스	SK디앤디	비엔엠개발	디앤디 인베스트먼트	지허브	SK어드밴스드	당진에코파워	SK케미칼
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리	100.0%	100.0%	45.6%							33.9%
SK신택			10.0%							
SK가스				31.0%			100.0%	45.0%	51.0%	
SK디앤디					100.0%	100.0%				
SK케미칼										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	100.0%	55.6%	31.0%	100.0%	100.0%	100.0%	45.0%	51.0%	33.9%

피투자회사 \ 투자회사	SK바이오 사이언스	엔티스	이니츠	제이에스아이	SK바이오팜	SK바이오텍	SK임업	SK실트론	SK인포섹	SK머티리얼즈
SK(주)					100.0%	100.0%	100.0%	51.0%	100.0%	49.1%
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK디스커버리										
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK케미칼	100.0%	50.0%	66.0%	56.0%						
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	50.0%	66.0%	56.0%	100.0%	100.0%	100.0%	51.0%	100.0%	49.1%

피투자회사 \ 투자회사	SK에어가스	SK트리켄	SK쇼와덴코	에스엠코어	포인트코드
SK(주)				26.7%	
SK이노베이션					
SK에너지					
SK종합화학					
SK루브리컨츠					
SK텔레콤					
SK브로드밴드					
SK텔링크					
SK플래닛					
SK하이닉스					
SK E&S					
SKC					
SK텔레시스					
SK네트웍스					
SK매직					
SK건설					
SK디스커버리					
SK신텍					
SK가스					
SK디앤디					
SK케미칼					
SK머티리얼즈	100.0%	65.0%	51.0%		
에스엠코어					68.9%
계열사 계	100.0%	65.0%	51.0%	26.7%	68.9%

마. 해외계열사 현황

[2018년 9월 30일 기준]

No.	해외계열사명
1	SK Gas International Pte. Ltd.
2	SK Gas USA Inc.
3	SK Gas Trading LLC
4	Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.
5	SK Holdco PTE. LTD.
6	BT RE Investments, LLC
7	Hi Vico Construction Company Limited
8	Irunex Construction and Management Co., Ltd.
9	Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
10	Mesa Verde RE Ventures, LLC
11	SBC General Trading & Contracting Co. W.L.L.
12	SK E&C BETEK Corp.
13	SK E&C Consultores Ecuador S.A.
14	SK E&C India Private Ltd.
15	SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.
16	SK E&C Saudi Company Limited
17	SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.
18	SK International Investment Singapore Pte. Ltd.
19	SKEC Anadolu LLC
20	SKEC(Thai) Limited
21	Sunlake Co., Ltd.
22	Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd
23	Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI.
24	Dandong Lijiang Estate Management co.,LTD
25	Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd.
26	P.T. SK Networks Indonesia
27	POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.
28	Shenyang SK Bus Terminal Co., Ltd.
29	Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.
30	SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.
31	SK (GZ Freezone) Co.,Ltd.
32	SK BRASIL LTDA
33	SK Networks (China) Holdings Co.,Ltd.
34	SK Networks (Dandong) Energy Co.,Ltd.
35	SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd

36	SK Networks (Shanghai) Co.,Ltd.
37	SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd.
38	SK Networks Deutschland GmbH
39	SK Networks HongKong Ltd.
40	SK Networks Japan Co., Ltd.
41	SK Networks Middle East FZE
42	SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.
43	SK Networks Resources Australia Pty Ltd.
44	SK Networks Resources Pty Ltd.
45	SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd
46	Springvale SK Kores Pty Ltd.
47	SK NETWORKS AMERICA, Inc.
48	SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.
49	Networks Tejarat Pars
50	SK NETWORKS RETAILS MALAYSIA SDN. BHD
51	IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.
52	PT. Patra SK
53	SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
54	SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.
55	SK Lubricants Americas, Inc.
56	SK Lubricants Europe B.V.
57	SK Lubricants Japan Co., Ltd.
58	SK Lubricants Rus Limited Liability Company
59	SK Life Science, Inc.
60	SK Bio-pharm Tech(Shanghai) Co., Ltd
61	Solmics Shanghai International Trading Co., Ltd.
62	Solmics Taiwan Co., Ltd.
63	SKC (Jiangsu) High Tech Plastics
64	SKC Europe GmbH
65	SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.
66	SKC, Inc.
67	SKC PU Specialty Co., Ltd.
68	SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
69	SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
70	SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
71	SKC Hi-Tech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd.
72	SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd.
73	SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z O.O.
74	SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC

75	Asia Bitumen Trading Pte., Ltd.
76	Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.
77	Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.
78	Netruck Franz Co., Ltd.
79	Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd.
80	Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.
81	SK Shanghai Asphalt Co., Ltd.
82	SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
83	SK Energy Road Investment Co., Ltd.
84	SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.
85	SK E&P America, Inc.
86	SK E&P Company
87	SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
88	SK Permian, LLC
89	SK Plymouth, LLC
90	SK USA, Inc.
91	SK Battery Hungary Kft.
92	Blue Dragon Energy Co., Limited
93	SK E&P Operations America, LLC
94	SK Nemaha, LLC
95	CAILIP Gas Marketing, LLC
96	China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.
97	DewBlaine Energy, LLC
98	PT SK E&S Nusantara
99	SK E&S Americas, Inc.
100	SK E&S Australia Pty Ltd.
101	SK E&S Hong Kong Co., Ltd
102	SK E&S LNG, LLC
103	Fajar Energy International Pte., Ltd
104	Prism Energy International Pte., Ltd.
105	Prism Energy International Hong Kong Limited
106	SK E&S Dominicana S.R.L.
107	Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
108	SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.
109	Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd.
110	SK GC Americas, Inc.
111	SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
112	SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
113	SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.

114	SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
115	SK Global Chemical China Ltd.
116	SK Global Chemical Japan Co., Ltd.
117	SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd.
118	SK Golden Tide Plastics (Yantai) Co., Ltd.
119	SK Hualun Specialty Chemical Co., Ltd.
120	SK-SVW (Chongqing) Chemical Co., Ltd.
121	Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.
122	Huizhou SK TCL Taidong Chemical Co.,Ltd.
123	SK Primacor Americas LLC
124	SK Primacor Europe, S.L.U.
125	SK Saran Americas LLC
126	SK S.E. Asia Pte. Ltd.
127	ESSENCORE Limited
128	Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited
129	SK C&C India Pvt., Ltd.
130	SK C&C Beijing Co., Ltd.
131	SK C&C Chengdu Co., Ltd
132	ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd.
133	S&G Technology
134	SK computer and communication L.L.C.
135	SK GI Management
136	Saturn Agriculture Investment Co., Limited
137	SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD.
138	Plutus Capital NY, Inc.
139	Hudson Energy NY, LLC
140	Gemini Partners Pte. Ltd
141	Solaris Partners Pte. Ltd
142	Beijing SK Magellan Capital Advisors Co., Ltd.
143	CFC-SK El Dorado Latam Capital Partners, Ltd.
144	CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd.
145	CFC-SK El Dorado Latam Fund, L.P.
146	Dogus SK Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S.
147	Prostar Capital Ltd.
148	Prostar Capital Management Ltd.
149	Solaris GEIF Investment
150	Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.
151	Hermed Capital
152	Hermed Capital Health Care GP Ltd

153	Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited
154	Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
155	Hermed Capital Health Care Fund L.P.
156	Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise
157	Hermeda Industrial Co.
158	Plutus Fashion NY, Inc
159	Wonderland NY, LLC
160	Alchemy Acquisition Corp.
161	Abrasax Investment Inc.
162	CFC-SK Covipaci Colombia SAS
163	CFC-SK Capital S.A.S.
164	CFC-SK Malta Covipacifico Ltd.
165	CFC-SK Spain Covipacifico S.L.
166	EM Holdings (Cayman) L.P.
167	EM Holdings (US) LLC
168	Hermeda Alpha Industrial Co. Ltd
169	Hudson Energy NY II, LLC
170	Prostar APEIF GP Ltd.
171	Prostar APEIF Management Ltd.
172	Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd.
173	SK Investment Management Co., Limited.
174	SK Semiconductor Investments Co., Ltd.
175	SK China Company, Ltd.
176	SK China(Beijing) Co.,Ltd.
177	SK BeiJing Investment Management Limited
178	Sky Yunjian Investment Management Limited
179	SKY Property Mgmt(Beijing) Co.Ltd.
180	SK Auto Service Hong Kong Ltd.
181	SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd
182	SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd
183	SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd
184	SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd
185	SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd
186	SK (Shenzhen) Auto Rental Co.,Ltd
187	SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd
188	Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.
189	SK Financial Leasing Co, Ltd.
190	SK Bio Energy HongKong Co.,Limited
191	SK China Investment Management Company Limited

192	SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.
193	SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.
194	SK Property Investment Management Company Limited
195	SK Industrial Development China Co., Ltd.
196	Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.
197	SKY Property Mgmt. Ltd.
198	SK China Real Estate Co., Limited
199	SK China Creative Industry Development Co., Ltd
200	SKY Investment Co., Ltd
201	FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd.
202	PT Sinar Timur Green Energi
203	SK Chemicals America, Inc.
204	SK Chemicals GmbH
205	SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd
206	SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd.
207	ST Green Energy Pte, Ltd
208	SK Telesys Corp.
209	SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD
210	TechDream Co. Limited
211	Atlas Investment Ltd.
212	Axess II Holdings
213	CYWORLD China Holdings
214	Global Opportunities Breakaway Fund
215	Global opportunities Fund, L.P
216	Immersive Capital, L.P.
217	Magic Tech Network Co., Ltd.
218	SK Global Healthcare Business Group Ltd.
219	SK Healthcare China Holding Co.
220	SK Healthcare Co.,Ltd.
221	SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited
222	SK Latin America Investment S.A.
223	SK MENA Investment B.V.
224	SK Technology Innovation Company
225	SK Telecom Americas, Inc.
226	SK Telecom China Fund 1 L.P.
227	SK Telecom Innovation Fund, L.P.
228	SK Telecom Smart City Management Co., Ltd
229	SK Telecom Venture Capital, LLC
230	SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd.

231	SKCREGC(Sichuan)Smart City Management Co.
232	SKTA Innopartners, LLC
233	ULand Company Limited
234	Westly Capital Partners Fund II
235	YTK Investment Ltd.
236	SK telecom Japan Inc.
237	AI ALLIANCE, LLC
238	ID Quantique S.A.
239	Fitech Global Opportunities Limited
240	Celcom Planet Sdn Bhd
241	Dogus Planet Inc.
242	Shopkick GmbH
243	Shopkick Inc.
244	Shopkick Management Company, Inc.
245	SK Planet Global Holdings Pte. Ltd.
246	SK Planet Inc.
247	SK Planet Japan K.K.
248	SKP America LLC
249	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
250	SK APTECH Ltd.
251	SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
252	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
253	SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.
254	SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd
255	SK hynix America Inc.
256	SK hynix Asia Pte. Ltd.
257	SK hynix Deutschland GmbH
258	SK hynix Flash Solution Taiwan Ltd.
259	SK hynix Italy S.r.l
260	SK hynix Japan Inc.
261	SK hynix Memory Solutions America Inc.
262	SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
263	SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
264	SK hynix Semiconductor India Private Ltd.
265	SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
266	SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
267	SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
268	SK hynix U.K Ltd.
269	SK hynix Ventures Hong Kong Limited

270	SK hynix Memory Solutions Eastern Europe LLC.
271	Great Shale LNG Transport S.A.
272	MILESTONE LNG TRANSPORT S.A.
273	OCEAN MARITIME HONGKONG LIMITED
274	S&Y Shipping S.A.
275	SK B&T PTE. LTD.
276	SK shipping Europe Plc.
277	SK shipping Hongkong Ltd.
278	SK shipping Japan Co., Ltd.
279	SK shipping Singapore Pte. Ltd.
280	Dalian Sea Oil Petroleum Chemicals Co.,Ltd
281	HBNG Logitics Co., Ltd.
282	SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.
283	Chongqing Happynarae Co., Ltd.
284	SK Energy International Pte, Ltd.
285	SK Energy Americas Inc.
286	SK Energy Europe, Ltd.
287	SK Terminal B.V.
288	Iriver Enterprise Ltd.
289	Iriver China Co., Ltd.
290	Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd.
291	Iriver Inc.
292	groovers Japan Co., Ltd.
293	LIFE DESIGN COMPANY JAPAN INC.
294	Bioland Biotec Co.,Ltd
295	SK Bioland Haimen Co.,Ltd
296	Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.
297	Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.
298	MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o.
299	MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd.
300	MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd
301	MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V
302	MCNS Polyurethanes USA Inc.
303	Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.
304	PT. MCNS Polyurethanes Indonesia
305	SMART Technology Polyurethanes P.J.S. Co.
306	Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.
307	Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd.
308	SK Materials (Jiangsu) Co., Ltd.

309	SK Materials (Xian) Co., Ltd.
310	SK Materials Japan Co., Ltd.
311	SK Materials Taiwan Co., Ltd.
312	SMC US, INC
313	SK TNS Myanmar Co.,Ltd
314	SK BIOTEK IRELAND LIMITED
315	SK Biotek USA, Inc.
316	NanoenTek America Inc.
317	NanoEntek Bio-Technology (Beijing) Ltd.
318	SK Siltron America, Inc.
319	SK Siltron Japan, Inc.
320	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd
321	SK Telink Vietnam Co., Ltd.

#### 바. 계열회사 등 관리조직 현황

[SK하이이엔지, SK하이텍, SK하이닉스시스템아이씨, 행복모아]

당사는 상기 계열회사들과 특별약정을 체결하고 있으며, 경영기획실에서 당사를 대표하여 대주주로서의 역할을 담당하고 있습니다. 각 계열회사의 경영상 의사결정은 자체적인 이사회 의결을 원칙으로 하되, 경영계획, 이사 및 경영진 임면 등 주요 경영 사항과 관련해서는 특별약정에 의거하여 당사와 사전 협의하도록 하고 있습니다. 당사의 경영기획실은 회사를 대표하여 이들 계열회사들에 상기 특별약정에 의거한 대주주로서의 의사표시를 하고 있습니다. 한편, 당사와 동 계열회사간의 용역 서비스 계약 및 도급 계약은 다른 일반 계약과 상이하지 않게 진행하고 있습니다.

[SKHYA(미주), SKHYCS(상해), SKHYT(대만), SKHYD(독일), SKHYU(영국), SKHYJ(일본), SKHYS(싱가폴), SKHYIS(인도), SKHYH(홍콩), SKHYCW(우시)]

당사의 상기 판매법인들은 "Distribution Agreement"에 의해 당사의 해외 법인으로서 판매행위를 대행하며, 이에 법인 운영에 필요한 운영전반에 대해 본사의 지원을 보장 받습니다. 판매법인은 본사 조직으로 구성, 운영되며 각 기능상의 소속본부에서 각 업무를 관장합니다.

#### 사. 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

[기준일: 2018년 9월 30일]

겸직임원		겸직 계열회사		비고
성명	직위	회사명	상근여부	
박성욱	대표이사	SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	비상근	-
		SK hynix memory solutions America, Inc.	비상근	-
		SK China Company Ltd.	비상근	-
		SK SE ASIA INVESTMENT PTE., LTD.	비상근	-
박정호	기타비상무이사	SK 텔레콤	상근	-
		SK SE ASIA INVESTMENT PTE., LTD.	비상근	-

## 2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 )

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
							수량	금액						
에스케이하이이엔지 주식회사	2001년 07월 05일	경영참가	7,399	500,689	100.00	7,521	-	-	-	500,689	100.00	7,521	128,339	25,139
에스케이하이텍 주식회사	2008년 03월 15일	경영참가	5,840	277,203	100.00	6,760	-	-	-	277,203	100.00	6,760	59,534	6,343
(주)실리콘화일	2008년 08월 12일	경영참가	76,904	8,444,276	100.00	30,756	-8,444,276	-30,756	-	-	-	-	33,322	-1,270
행복모아 주식회사	2016년 10월 12일	경영참가	7,400	1,480,000	100.00	7,400	-	-	-	1,480,000	100.00	7,400	16,486	-816
에스케이하이닉스 시스템아이씨	2017년 05월 11일	경영참가	343,295	20,000,000	100.00	290,172	4,823,982	114,756	-	24,823,982	100.00	404,928	360,254	-7,716
SK hynix Semiconductor America Inc.	1983년 03월 15일	경영참가	1,231,196	6,285,587	97.74	31	-	-	-	6,285,587	97.74	31	2,522,348	-7,243
SK hynix Semiconductor Deutschland GmbH	1989년 03월 01일	경영참가	80,956	-	100.00	22,011	-	-	-	-	100.00	22,011	108,470	-120
SK hynix UK Ltd.	2013년 11월 05일	경영참가	1,775	186,240,200	100.00	1,775	-	-	-	186,240,200	100.00	1,775	325,434	953
SK hynix Semiconductor Asia Pte.Ltd.	1991년 09월 12일	경영참가	137,532	196,303,500	100.00	52,380	-	-	-	196,303,500	100.00	52,380	636,286	2,872
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.	1995년 04월 27일	경영참가	223,233	170,693,661	100.00	32,623	-	-	-	170,693,661	100.00	32,623	1,043,889	19,456
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.	2006년 06월 29일	경영참가	6,357	-	100.00	4,938	-	-	-	-	100.00	4,938	414,850	8,230
SK hynix Semiconductor Japan Inc.	1996년 09월 16일	경영참가	81,587	20,000	100.00	42,905	-	-	-	20,000	100.00	42,905	632,590	1,761
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	1996년 09월 16일	경영참가	13,330	35,725,000	100.00	37,562	-	-	-	35,725,000	100.00	37,562	566,155	12,446
SK hynix Semiconductor Indian Subcontinent Private Ltd.	2007년 03월 29일	경영참가	5	270	1.00	5	-	-	-	270	1.00	5	903	7
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	2005년 06월 30일	경영참가	1,966,060	-	91.50	2,847,911	-	685,311	-	-	100.00	3,533,222	4,043,100	338,969
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.	2006년 04월 17일	경영참가	47,384	-	100.00	238,271	-	-238,271	-	-	-	-	269,183	-706
Hitech Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	2009년 11월 17일	경영참가	90,150	-	45.00	92,608	-	-	-	-	45.00	92,608	534,020	32
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	2010년 07월 29일	경영참가	237	-	100.00	237	-	-	-	-	100.00	237	13,347	92
SK hynix Italy S.r.l.	2012년 05월 11일	경영참가	18	-	100.00	18	-	-	-	-	100.00	18	3,462	254

SK hynix memory solutions America, Inc.	2012년 08월 20일	경영참가	311,284	128	100.00	311,284	-	-	-	128	100.00	311,284	97,132	28,484
SK hynix memory solutions Taiwan, Inc.	2013년 08월 29일	경영참가	7,819	-	100.00	7,819	-	-	-	-	100.00	7,819	8,626	247
SK APTEch	2013년 09월 02일	경영참가	166,299	157,000,000	100.00	166,299	190,000,000	207,001	-	347,000,000	100.00	373,300	166,528	-9
SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.	2014년 06월 03일	경영참가	14,579	-	99.93	14,579	-	-	-	-	99.93	14,579	5,261	975
STRATIO, INC.	2015년 02월 12일	투자	2,194	1,136,013	9.12	2,194	-	-	-	1,136,013	9.12	2,194	1,267	1,194
SK SE ASIA INVESTMENT PTE.. LTD.	2018년 08월 30일	경영참가	110,880	-	-	-	-	110,880	-	-	20.00	110,880	-	-
SK CHINA	2017년 08월 18일	경영참가	257,169	4,754,868	11.87	257,169	-	-	-	4,754,868	11.87	257,169	2,083,035	6,013
Keyssa, Inc.	2016년 02월 25일	투자	6,174	1,521,838	2.29	832	-	-	-	1,521,838	2.26	832	19,074	-18,145
Exnodes, Inc.	2016년 03월 17일	투자	716	-	-	716	-	-	-	-	-	716	365	-960
SK hynix Ventures Hong Kong Limited	2016년 03월 09일	투자	2,512	2,600,000	100.00	3,053	50,700,000	56,210	-	53,300,000	100.00	59,263	2,957	-13
NetSpeed Systems, Inc.	2016년 05월 26일	투자	3,083	2,893,071	6.07	558	-	-	-	2,893,071	5.56	558	9,627	-1,018
MEMS DRIVE, INC.	2016년 10월 20일	투자	2,246	188,451	2.94	844	-	-	-	188,451	2.86	844	4,528	-5,776
RENO SUB-SYSTEM, INC.	2017년 09월 01일	투자	2,246	1,190,476	2.68	204	-	-	-	1,190,476	2.68	204	12,328	-6,661
특정금전신탁(ProMOS)	2008년 11월 17일	투자	21,847	201,600,000	7.93	0	-	-	-	396,311	0.88	0	1,405,327	-470,296
TidalScale, Inc.	2018년 09월 21일	투자	3,360	-	-	-	3,247,561	3,360	-	3,247,561	4.26	3,360	1,276	-6,502
Gigalo Networks, Inc.	2018년 08월 03일	투자	1,678	-	-	-	850,629	1,678	-	850,629	6.00	1,678	1,067	-926
인텔렉추얼디스커버리	2011년 05월 13일	투자	4,000	800,000	7.05	1,699	-	-	-	800,000	7.05	1,699	37,234	-1,416
BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP	2018년 05월 30일	투자	2,637,097	-	-	-	-	2,637,097	62,244	-	-	2,699,341	-	-
BCPE Pangea Cayman2 Limited	2018년 05월 30일	투자	1,278,893	-	-	-	-	1,278,893	30,186	-	-	1,309,079	-	-
합 계			-	-	-	4,483,132	-	4,524,193	-	-	-	9,007,325	-	-

\* 최근 사업년도 재무현황은 2017년말 실적이며 특정금전신탁은 가장 최근 자료인 2012년 9월말 기준 재무제표상 금액을 반영함

\* '출자증서' 및 '전환사채'의 형태로 출자된 타법인의 경우 수량을 '-'으로 표기함

\* 당사는 사업역량 강화 및 경영효율성 제고를 목적으로 2018년 1분기 중 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)의 (주)실리콘화일 흡수합병 및 2분기 중 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.의 SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd. 흡수합병을 완료함.

\* ProMOS 회생절차에 따른 감자로 2018년 1분기 중 보유주식수 감소함.

## X. 이해관계자와의 거래내용

### 1. 대주주등에 대한 신용공여 등

#### 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역				미수 이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
행복모아(주)	자회사	단기 대여금	4,920	-	4,920	-	- 거래기간: 2017.09.28 ~ 2018.09.28 - 이자율: 4.6%	

주1) 전기 중 자회사형 장애인표준사업장인 행복모아(주)의 원활한 사업장 건설 및 사업 안정화를 위해 당사가 단기 대여금 4,920백만원 제공을 결정하였으며, 계약 체결일은 2017년 9월 27일, 대여금 지급은 9월 28일 및 10월 30일, 11월 29일에 각기 2,920백만원, 1,000백만원, 1,000백만원을 집행하였습니다. 동 대여금은 2018년 9월 27일 자로 상환 완료되었습니다.

주2) 해당 자금거래에 따른 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하고 본사의 자산건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하며, 공정거래법 상 대규모 내부거래 관련 규정(법 제11조의2) 적용 대상이나, 거래금액이 동 규정에서 이사회 의결 대상으로 정하고 있는 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상에 해당하지 않으므로, 내부 승인규정에 따라 집행하였습니다.

### 2. 대주주와의 자산양수도 등

#### 가. 자산양수도 내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	거래일자	거래일자 기준	거래대상물	거래금액	거래손익	거래내용	비고
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 1월	매각일자	중고장비	1,154	841	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 4월	매각일자	중고장비	1,801	-186	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 5월	매각일자	중고장비	548	-321	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 6월	매각일자	중고장비	1,996	-2,247	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 7월	매각일자	중고장비	64	-928	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 8월	매각일자	중고장비	2,978	2,296	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 9월	매각일자	중고장비	1,518	-1,758	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2018년 1월	매각일자	중고장비	1,630	-1,553	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2018년 2월	매각일자	중고장비	1,101	-1,390	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2018년 3월	매각일자	중고장비	1,751	-9	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2018년 4월	매각일자	중고장비	899	899	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2018년 5월	매각일자	중고장비	716	-1,940	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2018년 7월	매각일자	중고장비	4,207	1,638	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2018년 8월	매각일자	중고장비	687	687	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2018년 9월	매각일자	중고장비	871	-417	매각	생산 효율화 목적
HITECH SEMICONDUCTOR(WUXI) CO., LTD	공동회사	2018년 4월	매각일자	중고장비	88	-56	매각	생산 효율화 목적
HITECH SEMICONDUCTOR(WUXI) CO., LTD	공동회사	2018년 5월	매각일자	중고장비	6	-106	매각	생산 효율화 목적
SK hynix America Inc.	해외법인	2018년 5월	매각일자	중고장비	37	13	매각	생산 효율화 목적

SK hynix America Inc.	해외법인	2018년 8월	매각일자	중고장비	23	23	매각	생산 효율화 목적
SK hynix America Inc.	해외법인	2018년 9월	매각일자	중고장비	0	0	매각	생산 효율화 목적
SK hynix System IC Inc	국내법인	2018년 7월	매각일자	중고장비	144	58	매각	생산 효율화 목적
ESSENCORE Limited	특수관계자	2018년 8월	매각일자	중고장비	800	-1,387	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 1월	매입일자	중고장비	39,399	37,370	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 2월	매입일자	중고장비	2,972	-231	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 3월	매입일자	중고장비	36,334	36,570	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 4월	매입일자	중고장비	4,675	4,674	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 5월	매입일자	중고장비	1,186	1,184	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 6월	매입일자	중고장비	88	88	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 7월	매입일자	중고장비	2,143	1,996	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 8월	매입일자	중고장비	79	78	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2018년 9월	매입일자	중고장비	765	566	매입	생산 효율화 목적
SK Hynix Italy S.R.L	해외법인	2018년 3월	매입일자	중고장비	117	114	매입	생산 효율화 목적
에스케이네트웍스(주)	계열회사	2018년 3월	매입일자	항공기 지분	10,600	-	매입	글로벌 비즈니스 효율성 제고
재단법인 행복나눔재단	비영리법인	2018년 4월	증여일자	금전	7,100	-	증여	사회공헌

※ SK hynix Semiconductor(China) Ltd. 처분손익은 분기말 환율 적용 : 1분기 169.68, 2분기 169.41, 3분기 161.78

※ 법인가 장비 매매금액 산정 기준

- FMV (공정거래가격) : 구매부서에서 중고장비거래 업체에 시장가 문의

- 부대비용 / 운송비 / 보험료 등은 당사 구매조직에서 산정

※ 해외법인 및 공동회사와의 대부분의 중고장비 매매 거래는 공정거래법 상 대규모 내부거래 관련 규정(법 제11조의2) 적용 대상이었으나, 거래금액이 동 규정에서 이사회 의결 및 공시 대상으로 정하고 있는 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상에 해당하지 않으므로, 내부 승인규정에 따라 집행하였습니다

(이후, 해외계열사와의 거래는 대규모 내부거래 관련 규정 적용 대상이 아닌 것으로 공정거래위원회에서 입장 표명)

※ SK hynix Semiconductor(China) Ltd.와의 중고장비 매매거래는 상법 제398조 이상의 자기거래 규정 적용 대상으로 이사회 승인을 거쳐 집행하였으며 ('18년 1 ~ 12월 거래 건에 대해 '17년 12월 20일 이사회 승인을 통해 집행), 이 중 '18년 1월과 3월에 매입한 중고장비의 경우 그 각각의 거래금액이 공정거래법상 대규모내부거래 규정에서 이사회 의결 및 공시 대상으로 정하고 있는 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상에 해당하여 이사회 의결 및 공시를 거쳐 집행하였습니다 ('17년 12월 20일 이사회 승인)

※ 에스케이네트웍스(주)와의 항공기 지분 매입 거래 및 재단법인 행복나눔재단 증여는 공정거래법 상 대규모 내부거래 관련 규정(법 제11조의2) 적용 대상으로, 각기 2월 26일 및 4월 25일 이사회 승인을 거쳐 집행하였습니다.

## 나. 출자 및 출자지분 처분 내역

(단위 : 백만원)

계약 상대방	관계	거래일자	출자 및 출자지분 처분 내역					비고
			출자지분의 종류	거래내역				
				기초	증가	감소	기말	
SK APTech	해외계열사	2018.01.23 2018.06.21	보통주식	166,299	207,001	-	373,300	유상증자 \$190M 진행
에스케이하이닉스 시스템아씨(주)	국내계열사	2018.02.12	보통주식	290,172	114,756	-	404,928	유상증자 84십억 및 실리온화일 흡수합병에 따른 장부가 31십억 증가
(주)실리온화일	국내계열사	2018.03.01	보통주식	30,756	-	-30,756	-	에스케이하이닉스시스템아씨(주)로 합병
SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.	해외계열사	2018.05.24 2018.08.22 2018.09.04	보통주식	3,053	56,210	-	59,263	유상증자 \$50.7M 진행
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외계열사	2018.06.29 2018.09.04	보통주식	2,847,911	685,311	-	3,533,222	유상증자 \$400M 및 SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd. 합병에 따른 장부가 증가

SK SE ASIA INVESTMENT PTE., LTD.	해외계열사	2018.08.30	보통주식	-	110,880	-	110,880	\$100M 출자를 통한 자본 취득
-------------------------------------	-------	------------	------	---	---------	---	---------	---------------------

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

### 1. 공시내용의 진행 · 변경사항 및 주주총회 현황

#### 가. 공시사항의 진행 · 변경사항

신고일자	제 목	신고 내용 / 신고사항의 진행사항
2015.08.25	장래사업 경영계획 (공정공시)	2014년 이후 10년간 금일 준공하는 이천 M14를 포함하여 신규 공장 세 개 건설함. 이천 M14 건설 및 장비투자에 총 15조원 투자할 계획임. 향후 이천/청주에 각각 1개씩 신규공장건설 및 장비투자에 추가로 31조원 투자할 계획이며, 상당기간이 소요되는 부지조성 및 인프라 확보에 우선 착수하고 fab 건설 및 장비투자 시기는 향후 시장 및 수요상황을 고려하여 결정할 예정임.
2016.12.22	신규 시설투자 등 (자율공시)	공정 미세화에 따른 공정수 증가 및 장비 대형화에 따라 공정 전환을 위해 지속적인 공간 확보 필요성이 대두되어, 우시FAB의 중장기 경쟁력 유지를 위한 클린룸 확장 투자를 2017년 7월부터 2019년 4월까지 약 9,500억 원을 집행할 계획임.
2018.07.27	신규 시설투자 등	공정 미세화에 따른 공정수 증가 및 장비 대형화에 따라 회사의 중장기 경쟁력 강화를 위해 2018년 12월부터 2020년 10월까지 이천에 신규 클린룸 건설을 위해 약 3.5조원을 투자할 계획임.

#### 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제 70기 정기주주총회 (2018.03.28)	제70기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건(후보:박성욱)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:송호근)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:조현재)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:윤태화)	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:윤태화)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	
	주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	
	주식매수선택권 부여분 승인의 건	원안대로 승인	
제 69기 정기주주총회 (2017.03.24)	제69기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	정관 변경의 건	원안대로 승인	
	사내이사 선임의 건(후보:이석희)	원안대로 승인	
	기타비상무이사 선임의 건(후보:박정호)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:최종원)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:신창환)	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:최종원)	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:신창환)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	
	주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	

제 68기 정기주주총회 (2016.03.18)	제68기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건 (후보: 김준호)	원안대로 승인	
	사내이사 선임의 건 (후보: 박정호)	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	
제 67기 정기주주총회 (2015.03.20)	제67기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
제 66기 정기주주총회 (2014.03.21)	제66기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건(후보: 임형규)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보: 최종원)	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 최종원)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 120억원)	
	임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건	원안대로 승인	

## 2. 우발채무 등

### 가. 중요한 소송사건

#### (1) Netlist, Inc.("Netlist") 특허권 침해 소송

Netlist, Inc.는 지배기업과 SK hynix America Inc. 등 지배기업의 종속기업들을 상대로 다수의 특허를 침해하였다는 소송을 2016년 8월 31일 및 2017년 6월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 9월 1일 및 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에, 2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원 및 중국 베이징 지식재산법원에 각각 제기하였습니다. 당분기 말 현재 미국 등 각 지역에서 진행 중인 Netlist, Inc.의 특허 침해 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며, 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

한편, 2016년 9월 1일 미국국제무역위원회에 제기되었던 특허 침해 소송은 2018년 1월 16일 지배기업 및 지배기업의 종속기업들이 Netlist, Inc.의 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정되었습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2018년 3월 26일에 항소를 제기하였습니다.

또한, 2017년 7월 11일 중국 베이징 지식재산법원에 제기되었던 특허 침해 소송에 대하여 중국 특허심판원은 2018년 5월 30일 소송 특허가 무효임을 결정하였으며, 본결정에 따라 특허 침해 소송은 2018년 6월 26일에 기각되었습니다.

#### (2) Hagens Berman의 가격 담합 집단소송

Hagens Berman(소송대리인)은 지배기업 및 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 가격 담합에 대한 집단소송을 2018년 4월 27일 미국 캘리포니아 북부지방법원에 제기하였

습니다. 당분기말 현재 제기된 본 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

(3) 중국 반독점법 위반 조사

2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였습니다. 당분기말 현재 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

(4) 소송 및 특허 클레임 등

당분기말 현재 연결실체는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며 향후 자원의 유출가능성이 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

나. 채무보증 현황

당분기말 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	금액	비고
종업원	5	우리사주 관련 금융기관 차입금 지급보증

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황

제재조치일		조치기관	조치대상자	조치내용		사유 및 근거 법령		조치에 대한 이행현황	제발방지를 위한대책
연도	날짜			내용	금액(만원)	사유	근거법령		
2015	5/18~29	고용노동부	사업주	벌금	1,000	M10 경찰합동단속 실시	산안법 제23조, 24조 등	안전 및 보건상의 조치에 따른 시설 및 체계 개선 완료	타시설 횡전개 실시
	6/12	고용노동부	사업주	과태료	240	M10 경찰합동단속 실시 (공정안전보고서 작성 미이행)	산안법 제49조의2	공정안전보고서 작성 관련 업무 개선	교육 강화
	6/13	고용노동부/안전보건공단	사업주	과태료	18,133	M14 특별감독 실시	산안법 제13조, 14조, 30조, 48조	안전 및 보건상의 조치에 따른 시설 및 체계 개선 완료	타시설 횡전개 실시
	6/15	검찰총청	사업주	과태료	55,638	M10 경찰합동단속 실시	산안법 제23조, 24조 등	안전 및 보건상의 조치에 따른 시설 및 체계 개선 완료	타시설 횡전개 실시
	6/23	한강유역환경청	사업주	과태료	480	신규지정 유독물 수입세부 실적 미보고	화학물질관리법 제49조	수입실적보고 완료	수입신고 청구일원화(이전), 사업장별 Cross Check 실시
	7/22	한강유역환경청	사업주	과태료	32,280	화학물질 수입확인	화학물질관리법 제9조	국제배송차단, 수입시스템	시스템2차 개선추진, 구성원교육,홍

						증명서 미신고 (x 193건)		1차 개선.구성원교육 및 홍보	보
	7/27	한강유역환경청	사업주	과태료	9,600	유해화학물질 시설공사 및 관리 용역 발주 도급신고 미이행 (x 16건)	화학물질관리법 제31조	도급신고 완료	신규 계약 사전알람시스템을 통한 도급신고 대상여부 사전 파악
2016	3/30	고용노동부	사업주	과태료	320	관리책임자 업무수행(위험성평가 ) 총괄관리 미실시	산안법 제13조	안전보건관리책임자 직무 (경기위험성평가 보고/결재) 자료 제출	위험성평가 결재/보고 실시
	7/6	고용노동부	사업주	과태료	16	15년도 관리감독자 4명 교육 미실시	산안법 제31조 제1항	관리감독자 교육 미이수자 대상 교육 이수 완료	교육 미이수자 대상 교육 재실시
	9/19	고용노동부	사업주	과태료	400	PSM 이행상태 점검 (공정안전보고서 내용 미이행 7건)	산안법 제49조의 2 제7항	미이행 7개 항목 개선완료 후 자료 제출	PSM 자체감사 강화
	11/15	고용노동부	사업주	과태료	800	M14 Phase2 공사 발주 시 안전관리비 미계상	산안법 제30조의 제1항	발주서에 안전관리비 포함 및 과태료 납부	발주서에 안전관리비 포함
2017	3/8	수원지방법원	사업주	벌금	500	산업안전보건법 위반	산안법 제29조	벌금 납부	법령에 따른 안전관리 강화
	6/13	중대산업사고 예방센터 (총청권)	사업주	과태료	96	공정안전보고서 내용 (규칙/지침)이행 불일치	산안법 제49조	시정지시 조치결과서 제출 및 과태료 납부	법규/지침 이행여부 관리 강화
	11/13	충청북도청	사업주	과태료	80	대기배출원정보 입력 미실시 ('13.1.17 방지 시설 운영정보)	대기환경보전법 제31조 제2항	과태료 납부	대기배출원정보 입력/검증 강화

당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영 중에 있습니다. 또한 당사는 환경안전 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에게 대한 교육을 시행하고 있습니다.

#### 나. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항

##### (1) 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)의 출자

지배기업의 연결대상 종속기업인 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)는 중국 내 파운드리 사업 운영법인 SK Hynix System ic (Wuxi) Ltd.에 2018년 11월 중 USD 10,000,000을 출자하였습니다.

## 4. 녹색경영 현황

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 (환경부 고시 제 2014-162호)에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되었으며, 매년 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 배출권거래제 TF를 조직하여 이에 체계적으로 대응하고 있습니다.

「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2017년 온실가스 배출량은 최종 3,077,306톤 CO<sub>2</sub>e (tCO<sub>2</sub>e)입니다.

## 5. 합병 등의 사후 정보

### 가. 에스케이하이닉스시스템아이씨(주)의 (주)실리콘화일 흡수합병

(1) 거래내역 : 에스케이하이닉스시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 흡수합병

(2) 합병 비율 : 에스케이하이닉스시스템아이씨 주식회사 : (주)실리콘화일 = 1.0000000 : 0.0000000

- 신주발행 및 합병교부금 지급이 없으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000 으로 산출

(3) 목적 : 사업역량 강화 및 경영효율성 제고 에스케이하이닉스시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 흡수합병

(4) 진행 내역 :

- 합병기일 : 2018년 3월 1일

(5) 최근 사업연도 재무내용

[에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)]

(단위 : 백만원)

자산총계	360,254	자본금	100,000
부채총계	77,958	매출액	231,537
자본총계	282,296	당기순이익	-7,716

[(주)실리콘화일]

(단위 : 백만원)

자산총계	34,438	자본금	4,222
부채총계	1,243	매출액	982
자본총계	33,195	당기순이익	1,710

※ 에스케이하이닉스시스템아이씨(주)와 (주)실리콘화일은 에스케이하이닉스 주식회사의 100% 출자 자회사임.

\* 상세한 내용은 2018년 1월 12일에 공시된 회사합병결정에 대한 공시를 참고하시기 바랍니다.

## 【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계